

股票代號：6239



中華民國 106 年度年報
2017 ANNUAL REPORT

Powertech
TECHNOLOGY

刊印日期：中華民國 107 年 5 月 18 日
本年報查詢網址：
公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>
本公司網站：<http://www.pti.com.tw>

一、公司發言人及代理發言人

發 言 人

姓 名：曾炫章
職 稱：財務長暨副總經理
電 話：(03) 5980300
電子郵件信箱：evant@pti.com.tw

代理發言人

姓 名：林宥翰
職 稱：法務暨人資處資深處長
電 話：(03) 5980300
電子郵件信箱：yohan@pti.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司 地 址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10 號
第一廠區地址：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 879 號
第二廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路 7 號、7-1 號
第三廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10、15、26 號
第九廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 4 號
電 話：(03) 5980300
竹科分公司一廠地址：新竹市新竹科學園區力行三路 15 號
電 話：(03) 5779980
竹科分公司二廠地址：新竹市新竹科學園區力行四路 9 號
電 話：(03) 5795111

三、股票過戶機構

名 稱：康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1
網 址：<http://www.concords.com.tw>
電 話：(02) 8787-1888

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：黃裕峰、方蘇立會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：(02) 2545-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：盧森堡證券交易所

查詢海外有價證券資訊之網址：<http://www.bourse.lu>
ISIN NO. US7393681082

六、公司網址：<http://www.pti.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
營業報告書	2
貳、公司簡介	5
參、公司治理報告	8
一、組織系統.....	8
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	9
三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	15
四、公司治理運作情形.....	20
五、會計師公費資訊.....	48
六、更換會計師資訊.....	49
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊.....	49
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	50
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊.....	51
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數資訊.....	52
肆、募資情形	53
一、資本及股份.....	53
二、公司債辦理情形.....	57
三、特別股辦理情形.....	57
四、海外存託憑證辦理情形.....	58
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	59
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	59
七、資金運用計畫執行情形.....	59
伍、營運概況	60
一、業務內容.....	60

二、市場及產銷概況.....	69
三、從業員工資訊.....	76
四、環保支出資訊.....	76
五、勞資關係.....	78
六、重要契約.....	79
陸、財務概況	80
一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、會計師及其查核意見.....	80
二、最近五年度財務分析.....	83
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告.....	86
四、最近年度財務報告.....	87
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告.....	88
六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，其對本公司財務狀況之影響.....	89
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	90
一、財務狀況.....	90
二、財務績效.....	91
三、現金流量.....	92
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	93
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	93
七、其他重要事項.....	97
捌、特別記載事項	98
一、關係企業相關資料：.....	98
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	102
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	102
四、其他必要補充說明.....	102
五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	102

壹、致股東報告書

於民國 107 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

民國 106 年是力成科技成立第二十週年，也是豐收且榮耀的一年，在全體同仁的齊心協力下，我們不負所望地維持持續成長，同時更擴大進軍日本封測市場的布局，切入日本物聯網、車用晶片產品市場，提供現有及新客戶優質的封裝及測試服務，輔以靈活的市場開發策略，使得整體營收及獲利表現都相當亮眼。

除了在財務績效上繳出亮麗的成績單外，我們更積極強化公司治理及企業社會責任，用具體行動積極履行對各個利害關係人的責任，致力於企業的永續發展，並向聯合國「永續發展目標 (SDGs)」邁進。透過我們不斷的精益求精，成果已開始顯現；民國 106 年我們榮獲《天下雜誌》「2017 天下企業公民獎 TOP100」大型企業第 47 名及台灣企業永續學院「2017 年第十屆台灣企業永續獎」報告類金獎，民國 107 年初更榮登湯森路透 (Thomson Reuters) 所公布「全球百大科技領袖」(Top 100 Global Technology Leaders) 優秀企業名單之列。

未來我們仍將秉持「策略聯盟、穩健成長、永續經營」的經營理念，「承諾、技術、整合」的核心價值，在總經理卓越的領導，經營團隊及全體員工努力不懈下，不斷地尋求突破，再接再勵的朝向更高的目標邁進，我們自我期許能竭力恪盡世界公民的責任與義務，並為全體股東創造最大的利潤。

期望各位股東能繼續給予我們支持，力成全體員工將更團結努力再努力，持續創造力成下一個輝煌的二十年。

再次感謝各位股東女士、先生的支持與愛護！

祝 大家身體健康，萬事如意

董事長：_____

蔡篤恭

力成科技股份有限公司

一〇六年度營業報告書

一、106 年度營業報告書

106 年國際政治與經濟情勢雖經歷了美中在國際地位的暗中較勁、美國與北韓的緊張關係升溫、歐洲德法荷等國總統選舉、西班牙加泰隆尼亞獨立公投、美國聯準會(Fed)三次升息、川普採取貿易保護主義政策及退出巴黎氣候協定、英國脫離歐盟效應等各項因素影響，但在全球經濟復甦、新興經濟體進行結構性改革，以及貨幣與財政刺激措施，支撐了新興市場經濟及企業強勁的獲利表現。根據國際貨幣基金組織(IMF) 107 年 1 月「世界經濟展望」報告指出，106 年全球經濟成長率為 3.7%，比 105 年提高了 0.5 個百分點，其中已開發國家成長 2.3%，新興市場和開發中國家增長 4.7%，又以中國大陸的 6.8% 及印度的 6.7% 為最佳。

在全球半導體的整體表現方面，隨著各種技術持續發展，再加上新型電子產品不斷推出，全球半導體市場需求不斷揚升並呈現全面性的成長，而主要成長的力量為記憶體，包括 DRAM 與 Flash 在 106 年都出現價量齊揚的榮景。根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)於 107 年 1 月發布的研究資料指出，106 年全球半導體市場全年總銷售值達 4,122 億美元(約新台幣 12.12 兆元)，較 105 年成長 21.6%。而反觀台灣半導體產業，在 DRAM 產業已經逐漸淡出，不再扮演積極的參與者，華亞科歸屬美光旗下，產能及產值貢獻不計入台灣半導體產業；而近年來中國大陸 IC 設計產業的表現不俗，過去五年的產值年複合成長率高達 27.5%，部分公司規模已較台灣許多 IC 設計公司大，在技術與產品都已是直接的競爭對手；加上台灣半導體產業過去幾年表現優於全球，導致基期較高等，多項不利因素使得表現明顯落後於全球。工研院 IEK 於 107 年 2 月發布統計資料，106 年台灣 IC 產業產值達新台幣 24,623 億元(810 億美元)，較 105 年僅成長 0.5%，其中 IC 封裝業為新台幣 3,330 億元，較 105 年成長 2.8%，IC 測試業為新台幣 1,440 億元，較 105 年成長 2.9%。

本公司受惠高效能運算應用與大量資料存儲記憶體需求的大幅提升，在主要客戶所處產業榮景的帶動下，表現優於全球 IC 封測市場及台灣半導體產業，106 年全年度營收及獲利表現仍延續過去幾年出現顯著的成長，並達成我們的預期目標。未來我們仍將持續深耕技術、提供優良品質與服務、擴充產能以滿足客戶需求等方式來獲取客戶的信賴，透過集團資源整合等方式提高經營效率、降低成本並積極研發新技術、開發新產品線、投資新設備以及強化策略聯盟夥伴等方式，來增加本公司的競爭力。

茲將 106 年度的營運成果報告如下：

(一)106 年度營業實施情形

本公司 106 年度合併營收為 596 億 3 仟 2 佰萬元，較 105 年度的 483 億 4 仟 4 佰萬元成長了 23.4%；在盈餘方面，106 年度合併稅後純益歸屬於母公司股東的金額為新台幣 58 億 4 仟 9 佰萬元，相較 105 年度淨利新台幣 48 億 3 仟 5 佰萬元，成長了 21%。

(二)財務收支情形

106 年度合併現金流量狀況：

a.營業活動之現金淨流入	17,677,440 仟元
b.投資活動之現金淨流出	18,840,391 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	3,448,709 仟元
主要係配發股東現金股利及舉借銀行借款	

(三)獲利能力分析

分析項目		106 年度	105 年度
獲 利 能 力	營業利益 / 實收資本比率	116.46%	97.96%
	稅前純益 / 實收資本比率	114.06%	93.22%
	資產報酬率	8.34%	8.06%
	股東權益報酬率	15.51%	13.93%
	純益 (損) 率	9.81%	10.00%
	每股純益 (損)	7.51 元	6.20 元

(四)研究發展狀況

本公司自成立以來即持續不斷的研發新技術及新製程以因應產業的發展及客戶的需求，除了持續致力於 DRAM 及 NAND Flash 記憶體產品的研發外，亦積極擴大邏輯 IC 及先進封裝產品與技術，在 Lead-Free Bump、Copper Pillar Bump、Flip Chip、low cost molded substrate FCCSP、SiP、WLCSP、RDL 及 Advanced Packages & Test technology 上建立了良好的技術，提供了我們開發高端邏輯產品客戶的基礎。106 年度研究發展費用約為新台幣 17.2 億元，約占全年合併營收的 2.9%。未來仍將持續積極投資在 TMV PoP、CIS CSP (TSV)、3D IC (TSV)、Panel Level Fan-Out 及尖端先進封裝測試技術的研究發展及製造，戮力成為物聯網(IoT)、mobile devices、automotive、networking、HPC、AI 及 VR/AR 相關產品封測服務的主要提供者。

二、107 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)、提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體專業封裝及測試領域，與客戶、協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發、適時的導入新產品，提高公司成長動能。
- 4.以穩定的品質、精湛的技术提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源、強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才、重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

根據顧能公司(Gartner)最新預估，107 年全球半導體市場銷售值將達 4,274 億美元，與 106 年相比，成長 4%。WSTS 預估 107 年台灣半導體產業產值成長 7.1%，而封裝測試產業有 4.4% 的成長。成長力道將來自於智慧手機、固態硬碟(SSD)、車用電子、超輕薄筆電、產業應用、穿戴裝置、人工智慧應用以及 IoT 等相關應用。

Gartner 上修 106 年全球半導體市場總銷售值達 4,111 億美元，較 105 年成長 19.7%，主要由 Memory 市場(1,262 億美元)成長 57.3% 所貢獻，其中 DRAM 市場因平均單價(ASP)上漲因素，DRAM 市場(約 690 億美元)成長了 67.2%；另外，NAND Flash 市場(約 530 億美元)也成長了 51.1%；若不含 Memory，其他半導體市場則僅有 8.2% 的個位數成長。Memory 市場產值以應用別區分，仍以資訊應用為主(伺服器、PC 與平板電腦等)，通訊應用(智慧手機)次之。

預期 107 年半導體在全球手機出貨部分之出貨量將成長 5.9%；PC 部份，在歷經 106 年庫存調整，預估銷售相對回穩，出貨將小幅下跌 2.8%；液晶電視部分，預估將成長 1.8%。3C 產品中除智慧手機出貨仍持續成長外，其餘 3C 產品均面臨出貨持平、成長趨緩甚至衰退的局面。

預期 107 年需求狀況，AI 智慧系統與 IoT 物聯網科技時代來臨，將引領數據處理應用比重高度成長。中國是半導體最大市場，積極在地化發展為半導體工廠，109 年之前中國的在地化產值就會超過 3 兆元新台幣；而被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

本公司在 DRAM、NAND Flash、Logic 及先進產品元件將會有顯著的成長。

訂定 107 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 115 億顆
測試	約 75 億顆
凸塊(Bumping)	約 90 萬片
晶圓測試	約 245 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 6,100 萬個

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)及直接出貨(Drop-shipment)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.提升標準型 DRAM、Mobile DRAM、NAND Flash、Logic 等產品的比重。
- 3.持續 Logic 業務之拓展，並積極加速 Flip-Chip、SSD、Wafer level Packaging、晶圓級測試(CP)以及 Panel Level Fan-Out 的開發成長。
- 4.除了維持與現有客戶之長期合作關係外，並積極拓展新客源、新市場及新產品。
- 5.持續致力於成本控制，充分利用並整合資源，以提升公司競爭優勢。

董事長：

經理人：

會計主管：

貳、公司簡介

一、設立日期：86年5月15日

二、公司沿革

- 86年** 05月-- 力成科技股份有限公司成立，實收資本額6億元整。
08月-- 取得力晶半導體 DRAM、旺宏電子 FLASH 測試訂單，開始記憶體積體電路測試服務。
- 87年** 02月-- 經財政部證券暨期貨管理委員會核准公開發行。
05月-- 通過 ISO 9002 品質管理系統驗證(測試)。
- 88年** 01月-- 金士頓集團(Kingston Group)蔡篤恭先生接任董事長。
- 89年** 10月-- 購入力晶半導體竹北分公司後段設備，增加封裝業務，開始提供客戶封裝測試一元化服務。
- 90年** 01月-- 取得掛牌為保稅工廠。
05月-- 通過 ISO 9002：1994 品質管理系統驗證(封裝、測試)。
- 91年** 03月-- 通過 TOSHIBA 封裝及測試品質認證，取得 TOSHIBA FLASH 封裝測試訂單，提供 TOSHIBA 封裝測試一元化服務(TurnKey Service)。
10月-- 股票於興櫃市場掛牌交易。
- 92年** 01月-- 榮獲 ISO 14001：1996 環境管理系統驗證合格。
04月-- 股票於櫃檯買賣中心掛牌交易。
08月-- 通過 ISO 9001：2000 品質管理系統驗證。
- 93年** 09月-- 通過 OHSAS 18001：1999 安全與衛生管理系統驗證。
11月-- 公司股票於台灣證券交易所掛牌交易。
-- 晶圓級測試正式進入量產。
- 94年** 02月-- 導入綠色產品(GP)管理系統。
05月-- 通過 Sony Green Partner 驗證。
12月-- 以「購買法」簡易合併 100%轉投資之力嘉投資有限公司。
-- 開始生產 microSD Card。
-- 通過 ISO 14001：2004 環境管理系統驗證。
- 95年** 01月-- 研發技術中心成立。
-- 首次發行權全球存託憑證(現股)於盧森堡證券交易所掛牌交易。
08月-- 通過 ISO/TS 16949：2002 驗證。
12月-- 榮獲經濟部技術處「95年產業創新成果表揚」。

96年 03月-- 發行第一次私募國內無擔保可轉換公司債，發行金額新台幣 34 億 1 仟 2 百萬元。

08月-- 獲得經濟部國際貿易局「95年度金貿獎」出進口實績第十名。

11月-- 榮獲經濟部工業局「第八屆工業精銳獎」。

97年 03月-- 開始提供邏輯 IC 封裝服務。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「96年度金貿獎」出進口實績第九名。

98年 08月-- 榮獲經濟部國際貿易局「97年度金貿獎」出進口實績第五名。

09月-- 透過海外子公司 Powertech Holding (B.V.I.) Inc.併購 Spansion Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(更名為 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.)並間接取得 Spansion 中國蘇州 MCP 封測廠，後更名為力成科技(蘇州)有限公司，正式跨足大陸地區的封裝測試領域。

99年 03月-- 於新竹科學園區成立子公司-聚成科技股份有限公司。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「98年度金貿獎」出進口實績第五名。

-- 榮獲經濟部技術處第 18 屆產業科技發展獎之「傑出創新企業獎」。

100年 08月-- 榮獲行政院頒發「創造就業貢獻獎」。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「99年度金貿獎」出進口實績第六名。

101年 02月-- 透過公開收購取得超豐電子股份有限公司股權 44%。

04月-- 經超豐電子股東臨時會改選，力成正式入主超豐電子。

102年 07月-- 主要客戶爾必達公司被美光科技收購，業務對象變更為美光科技。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「101年度金貿獎」出進口實績第十名。

11月-- 湖口 3C 新廠落成啟用，並將總公司遷址於此。

103年 02月-- 與美商 TESSERA 達成技術授權合約之訴訟和解，並同意提前終止授權合約，有助於本公司未來代工業務成本的降低。

07月-- 取得新加坡 Nepes Pte. Ltd. 100% 股權，並更名為 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.。

12月-- 與美光科技簽訂半導體封裝投資合約，本公司未來將於中國大陸西安設立封裝廠，提供封裝服務。

-- 吸收合併子公司「聚成科技股份有限公司」，並於原址改設竹科分公司。

104年 04月-- 正式加入電子行業公民聯盟(EICC)(現更名為責任商業聯盟 RBA)。

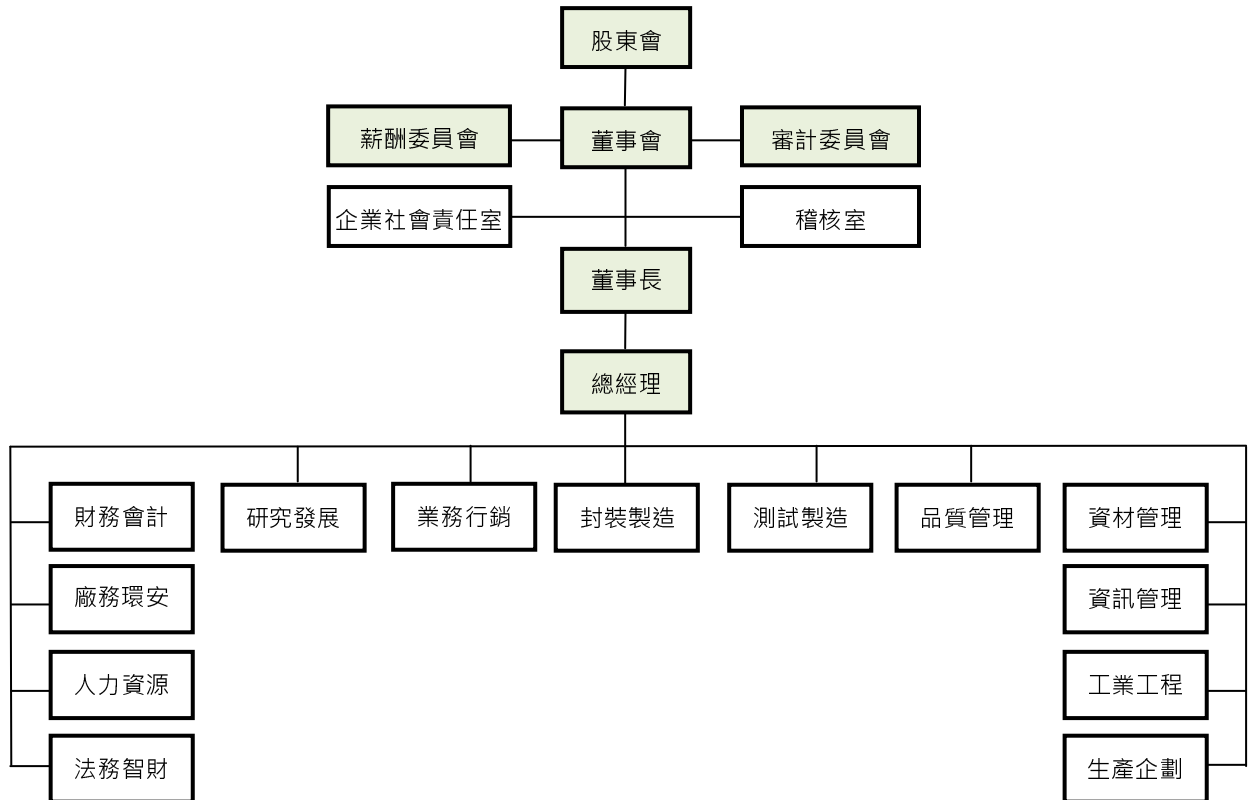
05月-- 設立子公司-力成半導體(西安)有限公司。

10月-- 與紫光集團簽訂策略聯盟合約，並計劃以私募發行普通股的方式，引進該策略性投資人。

- 105 年** 04 月-- 榮獲經濟部國際貿易局「104 年度金貿獎--最佳貿易貢獻獎」第四名。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會「2016 台灣 Top 50 企業永續報告獎—電子資訊製造業 金獎」。
- 取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。
- 12 月-- 取得社會責任管理系統(SA8000)認證。
- 106 年** 01 月-- 設立子公司--力成科技日本合同會社。
- 應募人紫光集團實質控制公司--西藏拓展創芯投資有限公司未能於規定期限內取得主管機關許可，致本公司與紫光集團有限公司、西藏拓展創芯投資有限公司合意終止私募普通股之認股協議。
- 加入「台灣永續供應協會 TASS」，將參與該協會協助經濟部工業局完成「台灣封測產業綠色環安雲端應用發展計畫」。
- 04 月-- 與 Micron Technology Inc.(美光科技)簽署合約，計畫以公開收購方式取得其日本子公司所持有日本上市公司 Tera Probe Inc. 39.6%之持股，暨併購其位於日本秋田的封裝測試廠 Micron Akita Inc.(美光秋田)之 100%股份。
- 06 月-- 完成公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc.之股權，綜合持股達 59.44%，正式成為子公司。
- 08 月-- 完成併購 Micron Akita Inc.(美光秋田)100%股份，並更名為 Powertech Technology Akita Inc.(力成科技秋田株式會社)。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會「2017 Top 50 企業永續報告 金獎」。
- 107 年** 01 月-- 榮獲英國媒體路透母公司湯森路透 (Thomson Reuters) 公布「全球百大科技領袖」 (Top 100 Global Technology Leaders) 優秀企業名單之列。

參、公司治理報告

一、組織系統



各主要部門所營業務：

主要單位	職 掌
董 事 長	綜理公司整體事業之規劃、執行，並對內部各項控制作業持續監督與改善
總 經 理	綜理公司整體策略目標、執行全盤業務
稽 核 室	負責檢核及評估公司內部控制制度實施之有效性
企業社會責任室	負責公司企業社會責任、誠信經營及從業道德、風險評估與危機處理政策之制定、規劃與執行
封裝製造	負責產品封裝生產與相關製程分析、設備維護
測試製造	負責產品測試生產與相關製程分析、設備維護
業務行銷	負責市場調查、開拓及與客戶聯絡協調
品質管理	負責品質政策及指標擬訂與執行、客訴處理、可靠度實驗及儀器校正
研究發展	負責新產品開發業務
資材管理	負責原物料管理與採購、倉儲運輸管理
資訊管理	負責資訊系統各項軟硬體之架設與維護
工業工程	負責工廠佈置及合理規劃、生產效率改善
生產企劃	負責產能需求規劃及生產排程
財務會計	負責財務會計及股務相關業務
廠務環安	負責廠務設施維護、安全衛生管理與行政庶務管理
人力資源	負責人事制度擬訂與執行、員工福利與勞資關係
法務智財	審核各項契約、處理法律訴訟及法令遵循事務、管理專利等智財權

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

董事資料(一)

107年4月10日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	蔡篤恭	男性	106.05.26	三年	88.6.23	4,010,000	0.51%	4,010,000	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專工業工程科畢業 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司執行長 超豐電子(股)公司董事長 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技(蘇州)有限公司董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc. 董事 Powertech Technology Akita Inc. 董事 緯創資通(股)公司獨立董事 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 群光電能科技(股)公司獨立董事	-	-	-
董事	中華民國	洪嘉鎰	男性	106.05.26	三年	106.05.26	211,000	0.03%	205,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學工業管理碩士 矽品精密工業(股)公司資深副總經理 力成科技(股)公司總經理 司邁克國際(股)公司董事長暨執行長	本公司總經理 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 (Shigeo Koguchi)	男性	106.05.26	三年	106.05.26	29,875,000 0	3.83% 0.00%	29,875,000 0	3.83% 0.00%	- 0	- 0.00%	- 0	- 0.00%	美國佛羅里達大學工程碩士 日本北海道大學工程碩士 Toshiba Corp. 資深執行副總經理 Toshiba Corp. 董事、資深顧問	無	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	女性	106.05.26	三年	106.05.26	29,875,000 0	3.83% 0.00%	29,875,000 0	3.83% 0.00%	- 0	- 0.00%	- 0	- 0.00%	政治大學會計系 遠東金士頓科技(股)公司財務長	遠東金士頓科技(股)公司財務長 金士頓電子(股)公司監察人 品安科技(股)公司監察人 華泰電子(股)公司法人監察人代表	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：呂肇祥	男性	106.05.26	三年	106.05.26	29,875,000 146,356	3.83% 0.02%	29,875,000 137,356	3.83% 0.02%	- 0	- 0.00%	- 0	- 0.00%	逢甲大學機械系 力晶半導體封裝生產副處長	力成科技(蘇州)有限公司董事長 力成半導體(西安)有限公司董事長 力成科技(股)公司封裝營運資深副總經理 超豐電子(股)公司法人董事代表	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：曾炫章	男性	106.05.26	三年	106.05.26	29,875,000 12,000	3.83% 0.00%	29,875,000 12,000	3.83% 0.00%	- 0	- 0.00%	- 0	- 0.00%	東吳大學會計研究所 精誠資訊(股)公司經營企劃資深協理	本公司財務長暨副總經理 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技(蘇州)有限公司監察人 力成半導體(西安)有限公司董事 Tera Probe, Inc. 董事 晶兆成科技(股)公司法人董事代表 Powertech Technology Akita Inc. 董事 財團法人蔡林不社會福利基金會董事	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透	男性	106.05.26	三年	94.6.14	3,655,309 0	0.47% 0.00%	3,655,309 0	0.47% 0.00%	- 0	- 0.00%	- 0	- 0.00%	日本上智大學大學院理工學研究科學士 Toshiba memory 事業部信賴性技術部參事	台灣東芝先進半導體(股)公司董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	鄭萬來	男性	106.05.26	三年	97.6.13	331,614	0.04%	331,614	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學企管系 永大電機(股)公司財務經理 永彰機電(股)公司財務副總經理、總經理	永彰機電(股)公司董事長 永鍊(股)公司董事長 波若威科技(股)公司董事 晟德大藥廠(股)公司董事 順天醫藥生技(股)公司法人董事代表 玉晟管理顧問(股)公司法人董事代表 玉晟生技投資(股)公司法人董事代表 友永(股)公司法人董事代表 創益生技(股)公司法人董事代表 豐華生物科技(股)公司法人董事代表 永大機電(股)公司監察人 北宸科技(股)公司監察人 金樺生物醫學(股)公司法人監察人代表 永昕生物醫藥(股)公司法人監察人代表	-	-	-
獨立董事	中華民國	林坤禧	男性	106.05.26	三年	91.6.20	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國肯塔基大學管理學院企管博士 國立交通大學電子工程學士、企管碩士 臺灣積體電路(股)公司資深副總經理 新日光能源科技(股)公司董事長	永旺能源(股)公司董事長 倍利科技(股)公司董事長 宏觀微電子(股)公司董事長 新日光能源科技(股)公司董事 致茂電子(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	魏幸雄	男性	106.05.26	三年	103.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學財政研究所碩士 成功大學交通管理系學士 中華航空(股)公司總經理、董事長	華經資訊企業(股)公司董事長 經貿聯網科技(股)公司董事 中國電子(股)公司法人董事代表 台新保代公益基金會監察人	-	-	-
獨立董事	中華民國	李培瑛	男性	106.05.26	三年	106.05.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國雪城大學化學工程博士 華亞科技(股)公司董事長	南亞科技(股)公司董事暨總經理	-	-	-

註：本公司於106年股東常會全面改選第八屆董事及獨立董事，改選後各新增一位董事及獨立董事。原董事KTC-TU Corporation及KTC-SUN Corporation於改選後卸任。

董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東(持有股權比例占前十名之股東)：

107年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	杜紀川 (50%)、孫大衛 (50%)
台灣東芝先進半導體(股)公司	日商東芝記憶體株式會社 (Toshiba Memory Corporation) (100%)

上表中法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

106年3月30日

法人名稱	法人之主要股東
日商東芝記憶體株式會社 (Toshiba Memory Corporation)	Toshiba Corporation(100%)

董事資料(二)

107年4月30日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)										兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數	
	商 務、法 務、財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上	法 官、檢 察 官、律 師、會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗	商 務、法 務、財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
蔡篤恭			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	緯創資通、仁寶電 腦工業及群光電 能科技等三家公 司之獨立董事
洪嘉鎰			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
美商金士頓科技股份有限公司 投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 (Shigeo Koguchi)			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
代表人：吳麗卿			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		
代表人：呂肇祥			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
代表人：曾炫章			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
鄭萬來			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
林坤禧			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	致茂電子獨立 董事	
魏幸雄			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
李培瑛			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

註1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第30條各款情事之一。
- (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2：本公司於106年股東常會全面改選第八屆董事及獨立董事，改選後各新增一位董事及獨立董事。原董事KTC-TU Corporation及KTC-SUN Corporation於改選後卸任。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

107年4月10日；股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
執行長	中華民國	蔡篤恭	男性	88.6.23	4,010,000	0.515%	-	-	-	-	台北工專工業工程科畢業 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司董事長 超豐電子(股)公司董事長 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技(蘇州)有限公司董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc. 董事 Powertech Technology Akita Inc. 董事 緯創資通(股)公司獨立董事 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 群光電能科技(股)公司獨立董事	-	-	-
總經理	中華民國	洪嘉鎰	男性	102.11.08	205,000	0.026%	-	-	-	-	成功大學工業管理碩士 矽品精密工業(股)公司資深副總經理 力成科技(股)公司總經理 司邁克國際(股)公司董事長兼執行長	本公司董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd 董事 力成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事	-	-	-
封裝營運 資深副總經理	中華民國	呂肇祥	男性	89.10.01	137,356	0.018%	-	-	-	-	逢甲大學機械系 力晶半導體封裝生產副處長	本公司法人董事代表 力成科技(蘇州)有限公司董事長 力成半導體(西安)有限公司董事長 超豐電子(股)公司法人董事代表	-	-	-
品質保證 資深副總經理	中華民國	王文忠	男性	91.12.12	66,056	0.008%	-	-	-	-	交通大學企管碩士 勝開科技 R&D 工程協理	無	-	-	-
測試營運 資深副總經理	中華民國	詹焜智	男性	92.08.01	5,435	0.001%	-	-	-	-	交通大學碩士 南茂科技(股)公司副總經理	超豐電子(股)公司法人董事代表	-	-	-
行銷暨策略業務 資深副總經理	中華民國	沈錫文	男性	103.09.01	25,000	0.003%	-	-	-	-	美國杜蘭大學企管碩士 AMKOR 副總經理暨林口廠廠長 力成科技(股)公司副總經理 詠業科技(股)公司總經理	無	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
資訊暨物料管理 資深副總經理	中華民國	張嘉行	男性	101.07.10	21,000	0.003%	-	-	-	-	美國德州大學阿靈頓分校機械工程碩士 交通大學管理科學研究所 建國工程(股)公司採購副總經理 茂德科技(股)公司採購副處長	無	-	-	-
業務行銷 資深副總經理	中華民國	賴宏洋	男性	102.01.02	35,000	0.004%	-	-	-	-	聯合工專工業工程科 矽品精密(股)公司副總經理	無	-	-	-
新加坡營運支援 資深副總經理	中華民國	鄭志明	男性	106.08.08	429	0.000%	-	-	-	-	中山大學電子工程系 京元電子(股)公司副總經理 力成科技(股)公司副總經理	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 總經理 超豐電子(股)公司業務副總經理	-	-	-
封裝製造 副總經理	中華民國	陳玉欽	男性	99.03.09	0	0.000%	-	-	-	-	中原大學工業工程系 力晶半導體(股)公司製造部經理	力成半導體(西安)有限公司總經理	-	-	-
測試製造 副總經理	中華民國	吳文維	男性	99.03.09	37,786	0.005%	-	-	-	-	中原大學工業工程研究所 力晶半導體(股)公司部經理	無	-	-	-
策略業務 副總經理	美國	李躬富	男性	100.04.01	0	0.000%	-	-	-	-	東京芝浦工業大機械工程系 Toshiba Microelectronics America Corp. --Assembly package Engineering Manager Payton Technology Corp.-- AP Operations Director Kingston Technology Corp.-- Sales Director	無	-	-	-
記憶體測試營運 副總經理	中華民國	紀有章	男性	101.05.10	40,000	0.005%	-	-	-	-	中央大學高階主管企管碩士班 力晶半導體測試工程部經理	無	-	-	-
封裝全球營運 企劃副總經理	中華民國	巫勤達	男性	99.03.09	0	0.000%	-	-	-	-	淡江大學機械系 美商艾克爾(上寶)處長	無	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
財務長暨副總經理	中華民國	曾炫章	男性	104.05.01	12,000	0.002%	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 精誠資訊(股)公司經營企劃資深協理	本公司法人董事代表 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd 董事 力成科技(蘇州)有限公司監察人 力成半導體(西安)有限公司董事 Tera Probe, Inc. 董事 晶兆成科技(股)公司法人董事代表 Powertech Technology Akita Inc. 董事 財團法人蔡林不社會福利基金會董事	-	-	-
封裝研發副總經理	中華民國	方立志	男性	104.05.01	3,000	0.000%	-	-	-	-	中原大學電子系 美商德州儀器 合泰半導體 力晶半導體副理	無	-	-	-
廠務工程協理	中華民國	林賢鳳	男性	101.05.10	166,715	0.021%	-	-	-	-	明新工專機械工程科 遠東金士頓科技經理	無	-	-	-
邏輯測試協理	中華民國	陳世恭	男性	101.05.10	87,000	0.011%	-	-	-	-	台灣科技大學電機研究所 新加坡商惠瑞捷科技協理 美商安捷倫科技協理	無	-	-	-
封裝製造協理	中華民國	張吉文	男性	103.08.01	0	0.000%	-	-	-	-	逢甲大學工業工程系 力晶半導體封裝生產部副理	無	-	-	-
晶圓級封裝協理	中華民國	董定鑫	男性	105.03.01	0	0.000%	-	-	-	-	元智大學工業工程研究所 美商艾克爾科技資深處長	無	-	-	-

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
1. 董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額 占稅後純益 之比例(% (註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F及G等 七項總額占 稅後純益 之比例(% (註 10)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資酬 金		
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 3)		業務執行 費用(D) (註 4)				薪資、獎金 及特支費等 (E) (註 5)		退職 退休金 (F)		員工酬勞 (G) (註 6)								
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司			
														現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額							
董事長	蔡篤恭(註 12)																							
董事	洪嘉鎰																							
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男、吳麗卿 呂肇祥、曾炫章	6,450	6,450	0	0	61,041	73,354	1,020	1,164	1.17	1.38	38,227	38,227	0	0	15,377	0	15,377	0	2.09	2.30			
董事	台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透																							
獨立董事	鄭萬來																							
獨立董事	林坤禧																							
獨立董事	魏幸雄																							
獨立董事	李培琪																							
董事	KTC-TU Corporation(註 11) 代表人：吳麗卿	0	0	0	0	4,481	4,481	50	50	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08			
董事	KTC-TU Corporation(註 11) 代表人：曾炫章	0	0	0	0	4,481	4,481	50	50	0.08	0.08	5,565	5,565	0	0	1,489	0	1,489	0	0.20	0.20			
董事	KTC-SUN Corporation(註 11) 代表人：洪嘉鎰	0	0	0	0	4,481	4,481	50	50	0.08	0.08	12,676	12,676	0	0	5,922	0	5,922	0	0.40	0.40			
董事	KTC-SUN Corporation(註 11) 代表人：古口榮男	0	0	0	0	4,481	4,481	50	50	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08			

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事 酬金級距	董 事 姓 名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9)	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9)
低於 2,000,000 元	鄭萬來、林坤禧、魏幸雄、李培瑛	鄭萬來、林坤禧、魏幸雄、李培瑛	鄭萬來、林坤禧、魏幸雄、李培瑛	鄭萬來、林坤禧、魏幸雄、李培瑛
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	KTC-TU Corporation(代表人：吳麗卿) KTC-TU Corporation(代表人：曾炫章) KTC-SUN Corporation(代表人：古口榮男) KTC-SUN Corporation(代表人：洪嘉鎰)	KTC-TU Corporation(代表人：吳麗卿) KTC-TU Corporation(代表人：曾炫章) KTC-SUN Corporation(代表人：古口榮男) KTC-SUN Corporation(代表人：洪嘉鎰)	KTC-TU Corporation(代表人：吳麗卿) KTC-SUN Corporation(代表人：古口榮男)	KTC-TU Corporation(代表人：吳麗卿) KTC-SUN Corporation(代表人：古口榮男)
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	洪嘉鎰 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿、呂肇祥、 曾炫章)	洪嘉鎰 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿、呂肇祥、 曾炫章)	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	台灣東芝先進半導體(股)公司	台灣東芝先進半導體(股)公司	台灣東芝先進半導體(股)公司 KTC-TU Corporation(代表人：曾炫章) 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：曾炫章)	台灣東芝先進半導體(股)公司 KTC-TU Corporation(代表人：曾炫章) 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：曾炫章)
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	蔡篤恭	—	洪嘉鎰 KTC-SUN Corporation(代表人：洪嘉鎰) 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：呂肇祥)	洪嘉鎰 KTC-SUN Corporation(代表人：洪嘉鎰) 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：呂肇祥)
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	蔡篤恭	蔡篤恭	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	蔡篤恭
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總 計	15 名	15 名	15 名	15 名

- 註 1：董事姓名係分別列示(法人股東將法人股東名稱及代表人分別列示)，因其中有董事或代表人有兼任執行長、總經理及副總經理之情形，另亦填列下表 3。
- 註 2：係指 106 年度董事之薪資報酬。依本公司最新章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。
- 註 3：係指 106 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註 4：係指 106 年度董事之相關業務執行費用，內容均為車馬費。
- 註 5：係指 106 年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、配車等實物提供等等。
- 註 6：係指 106 年度董事兼任員工取得員工酬勞者，並經董事會通過分派員工酬勞金額；因截至目前為止，分配各員工酬勞之金額尚未擬定，故按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列下表 3。
- 註 7：上列財務報告內所有公司之酬金資訊係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：稅後純益係指 106 年度本公司個體財務報告之稅後純益。
- 註 11：本公司於 106 年股東常會全面改選第八屆董事及獨立董事，改選後各新增一位董事及獨立董事。原董事 KTC-TU Corporation 及 KTC-SUN Corporation 於改選後卸任。
- 註 12：董事長配有司機，該司機為本公司之正職員工，106 年度給付其相關報酬包含薪資、各種獎金及員工福利等。

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比例(%)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			
執行長	蔡篤恭	48,684	52,994	0	0	49,272	51,518	30,899	0	30,899	0	2.20%	2.32%	無
總經理	洪嘉鎰													
封裝營運 資深副總經理	呂肇祥													
品質保證 資深副總經理	王文忠													
測試營運 資深副總經理	詹焜智													
行銷暨策略業務 資深副總經理	沈錫文													
資訊暨物料管理 資深副總經理	張嘉行													
業務行銷資深副總經理	賴宏洋													
新加坡營運支援 資深副總經理	鄭志明													
封裝製造副總經理	陳玉欽													
測試製造副總經理	吳文維													
策略業務副總經理	李躬富													
記憶體測試營運 副總經理	紀有章													
封裝全球營運 企劃副總經理	巫勤達													
財務長暨副總經理	曾炫章													
封裝研發副總經理	方立志													

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	鄭志明、陳玉欽	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	呂肇祥、詹焜智、王文忠 沈錫文、賴宏洋、張嘉行 吳文維、李躬富、紀有章 巫勤達、曾炫章、方立志	呂肇祥、詹焜智、王文忠 沈錫文、賴宏洋、張嘉行 鄭志明、陳玉欽、吳文維 李躬富、紀有章、巫勤達 曾炫章、方立志
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	蔡篤恭、洪嘉鎰	蔡篤恭、洪嘉鎰
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	16 名	16 名

註1：總經理及副總經理姓名係分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。董事兼任執行長、總經理及副總經理填列於本表及上表1。

註2：係填列106年度總經理及副總經理薪資、職務加給等。

註3：係填列106年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼等實物提供及其他報酬金額。

註4：係填列106年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（全部以現金發放），因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列表3。

註5：上列財務報告內所有公司之酬金資訊係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬各級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指106年度本公司個體財務報告之稅後純益。

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

106年12月31日

	職稱	姓名	股票金額 (仟元)	現金金額 (仟元)	總計 (仟元)	總額占稅後 純益之比例 (%)
經 理 人	執行長	蔡篤恭	0	34,712	34,712	0.59%
	總經理	洪嘉鎰				
	封裝營運資深副總經理	呂肇祥				
	品質保證資深副總經理	王文忠				
	測試營運資深副總經理	詹焜智				
	行銷暨策略業務 資深副總經理	沈錫文				
	資訊暨物料管理 資深副總經理	張嘉行				
	業務行銷資深副總經理	賴宏洋				
	新加坡營運支援 資深副總經理	鄭志明				
	封裝製造副總經理	陳玉欽				

測試製造副總經理	吳文維			
策略業務副總經理	李躬富			
記憶體測試營運副總經理	紀有章			
封裝全球營運企劃副總經理	巫勤達			
財務長暨副總經理	曾炫章			
封裝研發副總經理	方立志			
廠務工程協理	林賢鳳			
邏輯測試協理	陳世恭			
封裝製造協理	張吉文			
晶圓級封裝協理	董定鑫			

註1：係填列106年度經董事會通過分配經理人之員工酬勞金額（全部以現金發放），因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指106年度本公司個體財務報告之稅後純益。

註2：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 總經理及相當等級者 | (4) 財務部門主管 |
| (2) 副總經理及相當等級者 | (5) 會計部門主管 |
| (3) 協理及相當等級者 | (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人 |

註3：董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞者，除填前列相關附表外，另再填本表。

4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

職稱	106年度酬金總額 佔稅後純益之比例		105年度酬金總額 佔稅後純益之比例	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事(含獨立董事)	2.40%	2.61%	2.31%	2.54%
總經理及副總經理	2.20%	2.32%	2.66%	2.75%

- (1) 本公司支付董事之酬金係依本公司章程所訂定之比例分配之。自當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，提撥不高於1.5%為董事酬勞。獨立董事則為按月支領報酬，不參與董事酬勞之分配。
- (2) 總經理及副總經理之酬金則依公司薪資管理辦法及員工紅利分配辦法，考量個人年資、經歷、經營績效及貢獻度等，提報薪酬委員會審核並經董事會決議通過。
- (3) 本公司預估發放106年度之董事酬金佔當年度稅後純益之比例與105年度略高，係因增加一名董事代表人亦兼任員工，加計其員工酬勞所致。而106年度之經理人之酬金佔當年度稅後純益之比例略低於105年度，主要係因員工人數增加近千人，而經理人酬金未如稅後純益增加幅度同步增長所致。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

本公司於 106 年 5 月 26 日股東常會全面改選董事。而 106 年度董事會合計召開 7 次。

股東常會改選前，第 7 屆董事會於 106 年度共開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	蔡篤恭	4	0	100%	
董事	KTC-TU Corporation 代表人：吳麗卿	4	0	83%	
董事	KTC-TU Corporation 代表人：曾炫章	4	0	100%	
董事	KTC-SUN Corporation 代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi	4	0	100%	
董事	KTC-SUN Corporation 代表人：洪嘉鎰	4	0	100%	
董事	台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透	3	0	75%	
獨立董事	鄭萬來	4	0	100%	
獨立董事	林坤禧	4	0	100%	
獨立董事	魏幸雄	4	0	100%	

股東常會改選後，第 8 屆董事會於 106 年度共開會 3 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	蔡篤恭	3	0	100%	
董事	洪嘉鎰	3	0	100%	
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi	3	0	100%	
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	2	0	66.7%	
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：呂肇祥	2	0	66.7%	
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：曾炫章	3	0	100%	
董事	台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透	3	0	100%	
獨立董事	鄭萬來	2	0	66.7%	
獨立董事	林坤禧	3	0	100%	
獨立董事	魏幸雄	3	0	100%	
獨立董事	李培瑛	3	0	100%	

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第14條之3所列事項：

本公司業已設立審計委員會，證券交易法第14條之3所列事項皆經審計委員會全體成員同意後，提董事會決議。相關說明請詳下頁審計委員會運作情形之其他應記載事項1。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：

無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(1)106.8.8 第八屆第二次董事會

討論事項第二案：訂定本公司獨立董事報酬案

本案全體獨立董事因利害關係迴避未參與討論。經主席徵詢其餘出席董事無異議通過，並授權董事長全權處理。

討論事項第三案：本公司105年度經理人員工酬勞分配案

本案經理人董事(蔡篤恭、洪嘉瑜、呂肇祥、曾炫章)因利害關係迴避未參與討論，其餘出席董事無異議通過。

討論事項第五案：經理人競業禁止之解除案

本案董事蔡篤恭、曾炫章因利害關係迴避未參與討論，其餘出席董事無異議通過。

3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

依金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第10200531121號令規定，實收資本額新臺幣20億元以上未滿新臺幣100億元之非屬金融業之上市（櫃）公司，應自106年1月1日起設置審計委員會替代監察人。而本公司實收資本額位於上述規定區間，但本公司於103年3月14日第六屆第十六次董事會即決議通過修訂章程部分條文案，其中第十四條新修訂條文刪除監察人，改以設立審計委員會，並於103年股東常會通過修訂公司章程並選舉第七屆董事及獨立董事後，隨即設立審計委員會，本公司業已自願提前三年設置。

本公司又於104年10月30日第七屆第九次董事會決議通過修訂章程部分條文案，其中再次修訂第十四條條文，將董事席次由9席增加為11席，其中獨立董事則由3席增加為4席，且不得少於董事席次之規定，亦由五分之一增加為三分之一。此議案亦於105年1月15日之105年第一次股東臨時會投票表決通過。上列董事席次於106年5月26日召開之106年股東常會中選任完成。

另外，本公司秉持提昇資訊透明之原則，於各次董事會議後，當日即以中英文重大訊息之方式將重大決議事項之摘要公告於公開資訊觀測站。若依法令規定或實際需要，亦會依規定舉行重大訊息說明會或記者會，向投資人及記者詳細說明及回答疑問。

(二)審計委員會運作情形：

本公司於 106 年 5 月 26 日股東常會全面改選獨立董事後，即於 106 年 6 月 8 日第八屆第一次董事會委任四位新任獨立董事為第二屆審計委員會委員。而 106 年度審計委員會合計召開 7 次。

第一屆審計委員會於 106 年度開會 4 次，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	鄭萬來	4	0	100%	
獨立董事	林坤禧	4	0	100%	
獨立董事	魏幸雄	4	0	100%	

第二屆審計委員會於 106 年度開會 3 次，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	鄭萬來	2	1	66.7%	
獨立董事	林坤禧	3	0	100%	
獨立董事	魏幸雄	3	0	100%	
獨立董事	李培瑛	3	0	100%	

其他應記載事項：

- 1.審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證交法第 14 條之 5 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第 7 屆 第 17 次 (106.1.13)	1.擬不繼續辦理本公司 105 年度私募普通股案。	√	
	2.擬新設立海外子公司案。	√	
	3. 擬出售封裝設備予子公司案。	√	
	第 1 屆第 12 次(106.1.13)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 7 屆 第 18 次 (106.2.22)	1.審查 105 年度營業報告書及財務報表。	√	
	2.出具 105 年度內控聲明書案。	√	
	3.為規避匯率波動之風險，擬申請買賣遠期外匯額度美金 80,000 仟元，該筆為原額度到期之展期。	√	

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√	
	5.評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。	√	
	第1屆第13次(106.2.22)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第7屆 第19次 (106.4.14)	1.審查本公司105年度盈餘分配案。	√	
	2.增加對日本全資子公司「力成科技日本合同會社」之投資金額。擬提請董事會授權董事長在不超過日幣145.2億元(約折合美金1.32億元)之額度內，分次增加對力成科技日本合同會社之投資，以透過其取得日本上市公司Tera Probe Inc.至少39.6%股份及Micron Akita In.之全部股份。	√	
	3.本公司擬透過日本全資子公司「力成科技日本合同會社」公開收購取得Micron Memory Japan Inc.所持有之日本上市公司Tera Probe Inc. (Tera Probe) 之39.6% 持股及其他參與應賣股東之持股。	√	
	4.本公司擬透過日本全資子公司「力成科技日本合同會社」購買Micron Akita In.之全部股份案，投資總金額以不超過美金5,000萬元(約折合日幣55億元)為限。	√	
	第1屆第14次(106.4.14)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第7屆 第20次 (106.5.5)	1.審查本公司106年度第一季財務報表。	√	
	2.為規避匯率波動之風險，擬申請買賣遠期外匯額度美金6,000仟元，可交易金額為美金60,000仟元，該筆為原額度到期之展期。	√	
	3.提供子公司力成科技(蘇州)有限公司背書保證美金2,000萬元之額度內向銀行辦理借款。	√	
	第1屆第15次(106.5.5)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第 8 屆 第 1 次 106.6.8	1.擬增加國內股權投資案。本公司擬參與晶兆成現金增資案，如全由原股東依目前持股比例認購，本公司將認購本次新發行之普通股新股 6,615,000 股，預計需支付之認購價金為新台幣 1 億 9,845 萬元整。	√	
第 2 屆第 1 次(106.6.8)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第 8 屆 第 2 次 106.8.8	1.審查本公司 106 年度第二季財務報表。	√	
2.本公司提供背書保證新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.向中國信託商業銀行之借款美金 2,000 萬元，於 106 年 5 月 15 日再動支 350 萬美元之短期借款，截至目前為止已動支尚未還款之背書保證額度為 1,300 萬美金。			
3.為規避匯率波動之風險，擬申請買賣遠期外匯額度為新台幣 3 億元及美金 25,000 仟元，該筆為原額度到期之展期。			
第 2 屆第 2 次(106.8.8)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第 8 屆 第 3 次 (106.11.1)	1.審查本公司 106 年度第三季財務報表。	√	
2.訂定本公司 107 年度內部稽核計劃。			
3.為規避匯率波動之風險，擬申請買賣遠期外匯額度美金 100,000 仟元，該額度為原額度到期之展期。			
第 2 屆第 3 次(106.11.1)審計委員會決議結果：全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：

無此情形。

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

無此情形。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

- (1)內部稽核部門除每月將稽核報告以電子郵件方式送交各獨立董事審核外，稽核主管亦會針對稽核發現及建議事項，於審計委員會會議上向各獨立董事提出報告。
- (2)會計師依據審計準則公報第 39 號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局 93 年 3 月 11 日發布之台財證六字第 0930105373 號函規定，於規劃階段及完成階段，每季就本公司合併財務報告(年度另包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項，彙整資訊於審計委員會會議上向各獨立董事進行報告及溝通。
- (3)本公司每季至少召開一次審計委員會，106 年度起截至年報刊印日止，於審計委員會之歷次會議中，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形尚屬良好，溝通事項摘要如下：

日期	審計委員會會議	溝通重點
106/2/22	第 1 屆 第 13 次	<p>1.105 年第 4 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>2.討論 105 年度內部控制制度執行及自行評估結果，出具內部控制聲明書。</p> <p>3.會計師報告 105 年度個體及合併財務報表之查核內容及結果(包括會計師查核報告中關建查核事項段之說明)；並針對重大會計估計問題及近期稅務、證管相關更新之法令進行討論與溝通。另外，會計師亦報告 106 年度之核閱/查核規劃，並針對本公司已辨認之重大審計風險項目進行陳述與溝通。</p> <p>獨立董事建議：無建議事項。</p>
106/5/5	第 1 屆 第 15 次	<p>1.106 年第 1 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>2.會計師報告 106 年第 1 季合併財務報表之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及近期稅務、證管相關更新之法令進行討論與溝通。</p> <p>獨立董事建議：無建議事項。</p>
106/8/8	第 2 屆 第 2 次	<p>1.106 年第 2 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>李培瑛獨立董事：有關資訊安全的管理及營業秘密的保護對 DRAM 產業相形重要，建議先行評估公司面臨的風險程度，再採行必要的保護措施。</p> <p>稽核主管回覆：本公司去年取得 ISO27001 的驗證，同時導入營業秘密及個資保護的輔導，未來將針對海外子公司尤其中國大陸地區加強宣導，採行必要的保護措施。</p> <p>2.會計師報告 106 年第 2 季合併財務報表之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題進行討論與溝通。</p>

日期	審計委員會議	溝通重點
		<p>其他溝通事項及獨立董事建議：</p> <p>1.李培瑛獨立董事：希望未來能整理報告有關力成與關係人間之交易情形，使審計委員能更清楚公司的相關營運狀態。</p> <p>稽核主管回覆：未來將逐季報告與關係人交易情形並列為定期報告的項目。</p> <p>2.稽核主管報告：對於新取得之日本子公司將列入稽核查核的範圍，目前因 Tera Probe 為日本股票上市公司，除了國內相關內控規定等，尚須考量日本當地法令及日本會計處理原則的相關規定。</p> <p>鄭萬來獨立董事：可透過會計師事務所協助，比較台灣與日本內控相關規定及會計處理的差異，由事務所協助進行子公司內控查核。此外，由於近年來新增數家子公司，尤其是近期日本子公司的取得，稽核工作量相對明顯增加，除委請會計師事務所協助外，應考量稽核人力的適足性。</p> <p>李培瑛獨立董事：誠如鄭董事所言，可委請會計師事務所協助提供有關台日雙方會計科目之差異及對照，方便我們更容易了解財務資訊。</p> <p>稽核主管回覆：據了解過去 Tera Probe 針對其台灣子公司晶兆成科技之相關查核係委請國內會計師事務所協同，9月份我們將會同進行晶兆成子公司之內控審查。另外有關日本子公司之查核將諮詢勤業眾信會計師事務所，必要時初期先委外協助進行相關內控查核。</p>
106/11/1	第 2 屆 第 3 次	<p>1.106 年第 3 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>鄭萬來獨立董事：關於採購案貿易條件改變 FOB 改為 CIF，運輸險是否涵蓋。</p> <p>財務長回覆：本公司運輸險投保係採 Global Policy 不分海運、空運均為承保範圍。針對採購案貿易條件改變，將建議採購人員跟供應商協談由供應商依原條件承擔部分運費。</p> <p>魏幸雄獨立董事：空運費用價差很大尤其是併裝時，建議針對 Forward 的運費報價可多詢價其他 Forward，亦可派較了</p>

日期	審計委員會議	溝通重點
		<p>解實務的人不定期 Audit 提單上的價格是否異常。</p> <p>稽核主管回覆：謝謝您的指導。</p> <p>李培瑛獨立董事：關於工程保險、資產保險等，請問目前力成公司相關保險涵蓋的範圍如何？是否包括火險、地震險等等？稽核是否列為查核的範圍？</p> <p>財務長回覆：目前公司的保險涵蓋資產相關包括火險、地震險甚至營運中斷險等等，亦涵蓋員工差旅保險等。下次將整理公司各項的保險包括董監責任險等，跟各位董事報告。</p> <p>稽核主管回覆：有關資產投保、工程保險等亦列入稽核各相關循環之查核項目。</p> <p>2.訂定 106 年度內部稽核計畫。</p> <p>3.會計師報告 106 年第 3 季合併財務報表之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題進行討論與溝通。另外，會計師亦針對本公司之關鍵查核事項進行陳述與討論。</p> <p>獨立董事建議：除前述溝通與建議外，無其他建議事項。</p>
107/3/16	第 2 屆 第 4 次	<p>1.106 年第 4 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>2.討論 106 年度內部控制制度有效性考核及自行評估結果報告，並出具設計及執行均有效之聲明書。</p> <p>3.會計師報告 106 年度個體及合併財務報表之查核內容及結果(包括會計師查核報告中關鍵查核事項段之說明)；並針對重大會計估計問題及近期稅務、證管相關更新之法令進行討論與溝通。另外，會計師亦報告 107 年度之核閱/查核規劃，並針對本公司已辨認之重大審計風險項目進行陳述與溝通。</p> <p>獨立董事建議：無建議事項。</p>
107/5/4	第 2 屆 第 5 次	<p>1.107 年第 1 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>2.會計師報告 107 年第 1 季合併財務報表之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及近期稅務、證管相關更新之法令進行討論與溝通。</p> <p>其他溝通事項及獨立董事建議：</p> <p>1.法務長就本公司前員工涉有不誠信行為之案件的舉報、提告至法院偵查終結提請公訴之過程簡要報告。</p> <p>魏幸雄獨立董事：我們上次在報告本案時的有沒有列入會議紀錄？</p> <p>法務長回覆：有，有會議紀錄，但是沒有列員工姓名，列在誠信經營的報告裡。</p>

日期	審計委員會議	溝通重點
		<p>稽核主管回覆：有，本案在第八屆第三次的董事會報告誠信經營執行情形時，報告該期間我們有接獲舉報的案件並提報法院在偵察中。本公司在 107/4/12 收到法院偵查終結所開立之起訴書。當天我們與證交所管區聯繫，確認依規定是否需要發佈重大訊息，雖然本案檢察官係以違反特別背信罪起訴，然而本事件是發生在 105 年，以現階段來說，兩位被告已非本公司員工，所以如果用經理人的名義去發布重大訊息的話，怕會讓大眾誤以為是現任的經理人遭起訴，故當天並未針對此案發布重大訊息。</p> <p>李培瑛獨立董事：所以接下來，你們是否發佈重大訊息？以公司面來說你們已經在接獲舉報後做好公司應做的事，現階段從投資人的角度來講他們最關心的是第一，本事件對公司有沒有造成重大的財務影響，第二，從公司治理的角度來看，內部的管理是不是很扎實？建議公司可以考慮主動發布訊息說明本事件公司的處理態度以及並未造成財務的重大影響，這樣才能讓投資人對力成的公司治理更有信心。</p> <p>財務長回覆：我們會再評估公司主動發布重大訊息的必要性。</p> <p>魏幸雄獨立董事：這個案子對公司有沒有財務上的損害？若有股東在股東大會上提出來的話，我們要怎麼解釋？</p> <p>法務長回覆：的確是有的，不然檢察官不會做起訴，因為公司確實是有利益上的損害，譬如說原本我們可以向中國探針用更便宜的價格買到。</p> <p>會計師回覆：這個事情就財務報表並無影響，這類的損失是看不到的，並不是有什麼實質的金錢或資產流出。</p> <p>稽核主管回覆：我們這邊也有做了一些因應措施，例如要求採購儘量直接向原廠購買，避免向代理商購買。針對比較重大的案件應採公開招標的方式。</p> <p>鄭萬來獨立董事：這樣的話，我們的採購制度、採購</p>

日期	審計委員會議	溝通重點
		<p>辦法有沒有必要去修正？</p> <p>稽核主管回覆：相關的內控制度及內部規範都重新 review，目前仍在修訂中，修訂後將依規定提請審計委員會及董事會核准。</p> <p>李培瑛獨立董事：其實這個案件不是採購單位出了問題，是使用單位出了問題，如果議價的程序裡面，如果採購單位是可以去使用高單價的，這個就可能就採購單位有部份人員也涉入其中，如果沒有的話，其實重點還是在請購單位。譬如說請購單位是否指定用某一設備或廠商？針對此類問題去尋求解決方案。</p> <p>稽核主管回覆：採購人員反應其困難點常是涉及專業性，例如設備的規格書是需求單位提出的，有可能就是他提出的規格就只能由單一廠商提供。</p> <p>鄭萬來獨立董事：適當的輪調是有必要的，有些採購是從研發出來的，有些是製造單位出來，他們是輪調性的。適當的輪調可以讓採購有一些這一部份的專業。</p> <p>林坤禧獨立董事：通常設備類的採購案，使用單位的決定權其實超過七成。</p> <p>獨立董事建議：除前述溝通與建議外，無其他建議事項。</p>

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司依「上市上櫃治理實務守則」訂定公司治理守則，於103年11月5日經第七屆第三次董事會通過，另於104年2月9日第七屆第四次董事會通過增修，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人、財務部門亦設有股務人員處理股東建議及相關問題，並於公司網站開放股東或投資人聯絡窗口蒐集相關建議。若涉及法律問題時，再委請法律顧問處理。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司股務代理機構定期提供股東名簿及相關報表，本公司亦依規定揭露相關資訊，並與主要股東維繫良好的溝通管道。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間之財務業務往來，已依據相關規定制定書面辦法並遵循之。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「防範內線交易管理作業」，規範本公司董事、經理人、員工及其他因身分、職業或控制關係而知悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司「公司治理守則」第20條規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本公司11席董事之學經歷皆具備豐富且為本公司業務所需的專業背景。而於公司章程中規定，獨立董事人數至少4人，且不得少於董事席次1/3，優於證券交易法之規定；另外，一般董事中有1位董事代表人為女性。綜上所述，本公司業已落實執行董事會成員多元化方針，詳細落實情形請詳本表下方說明一、本公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，其餘公司治理之運作係由企業社會責任室及相關部門執行，惟尚未設置其他各類功能性委員會，未來將視運作狀況評估設置。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？		✓	(三)本公司董事會成員皆忠實執行業務及恪盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎的態度行使職權，以維護公司及股東權益；惟尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將視需要評估訂定之。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司於104年初開始，每年定期評估簽證會計師之獨立性。106年評估及呈報之程序及內容如下： 1. 取具並檢視勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰與方蘇立會計師簡歷資料。 2. 取具會計師出具之獨立性聲明書。內容需聲明審計小組成員及其配偶與受撫養親屬未有違反獨立性或未解決利益衝突之情形。 3. 上網搜尋簽證會計師以往是否有違反獨立性行為之紀錄。 4. 參照會計師法第23條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定「會計師獨立性評估表」，請詳本表下方說明二，逐項評估其是否有影響會計師獨立性之行為。 5. 106年2月22日呈報第1屆第13次審計委員會討論通過。 6. 106年2月22日呈報第7屆第18次董事會討論通過。
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司負責公司治理相關事務之單位係由財務會計單位兼任。負責之相關事務如下： 1. 研擬並規劃年度董事會及股東會之時程及初步議案內容。 2. 於各次董事會議前，規劃並擬定各議案之細部內容，於董事會前與公司內部董事確認議案內容，並於會議日七日前通知所有董事出席並提供所有議程相關資料，以利董事有足夠時間瞭解議案內容；若有董事對利害關係議案需迴避之情形，將於事前及會議前提醒。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3.各次董事會議後製作議事錄，依法詳實記載議決之事項，由會議主席及記錄人員蓋章，於會後二十日內分送各董事，並於公司存續期間妥善保存於檔案室。 4.每年依主管機關規定事先登記股東會日期，於公司治理評鑑規定之期限內完成製作及申報開會通知、議事手冊、年報及議事錄等會議相關資料，會議決議內容若涉及公司變更登記事項，將於會議結束後15日內向經濟部商業司申請辦理。 5.負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保內容之適法性、正確性及即時性等符合資訊對等之精神，以保障投資人權益。 6.提供董事進修之課程資訊，並協助安排課程及報名。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司本於尊重利害關係人權益，透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 1.股東／投資人 ◆ 關注議題：營運績效、風險管理、誠信經營與從業道德、法規遵循、技術與服務、公司治理。 ◆ 溝通管道：召開股東會（每年）、公開發佈財務報告（每季）、召開法人說明會（每季）、發言人及投資人關係部門（不定期）、公司網站。 2.員工 ◆ 關注議題：薪資福利、勞資溝通、職場安全、職涯發展、勞工人權政策、公司治理、人才招募與留才、性別平等。 ◆ 溝通管道：職工福利委員會（不定期）、電子平台及公司公告、提案改善制度、勞資會議（每季）、員工信箱、職業安全衛生委員會（每季）、員工心理諮商與輔導、力成園地季刊。 3.客戶 ◆ 關注議題：技術與服務、智慧財產權管理、風險管理、誠信經營與從業道德、供應商管理、公司治理、綠色產品、氣候變遷、客戶服務。 ◆ 溝通管道：業務會議（不定期）、客戶滿意度調查（每年）、客訴管理制度。	符合上市上櫃公司治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>4. 供應商</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 關注議題：供應商管理、風險管理、誠信經營與從業道德、營運績效、衝突金屬、採購政策。 ◆ 溝通管道：供應商會議（不定期）、供應商稽核（每年）、供應商評鑑（每月）、公司網站。 <p>5. 政府機關</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 關注議題：法規遵循、公司治理、誠信經營與從業道德、個人資料保護、勞工人權政策、職場安全、污染防治、水資源管理、溫室氣體排放、氣候變遷。 ◆ 溝通管道：公文／電子郵件及會議、宣導會／公聽會、發佈函令。 <p>6. 社區團體</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 關注議題：污染防治、水資源管理、產學合作、社區參與。 ◆ 溝通管道：公司網站、廠務部門對外窗口（不定期）、課程與參訪（不定期）。 <p>除了上述利害關係人溝通管道外，本公司網站另有設置企業社會責任及利害關係人專區，方便利害關係人及社會大眾閱覽，並設有利害關係人之聯絡管道，有利本公司瞭解利害關係人所關切的議題並能適度回應。</p>	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任康和綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已架設公司網站，定期或不定期揭露公司財務業務及公司治理相關資訊。</p> <p>(二) 本公司設有專責人員負責公司資訊之揭露，除依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務業務資訊外，亦於公司網站於投資人關係專頁中揭露中英文資訊。另設有發言人及代理發言人以落實發言人制度。</p> <p>本公司按季自行召開法人說明會，定期說明公司財務業務狀況，並提供會議過程網路直播和會後置於本公司網站供投資人觀看，相關訊息亦公告於公開資訊觀測站。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		<p>1.本公司業已制定「CSR委員會組織章程」並成立「CSR委員會」，每季召開一次會議，針對CSR執行狀況及相關議題進行改善及討論。</p> <p>2.員工權益及僱員關懷：請詳後第五頁(五)履行企業社會責任之評估項目三、(一)~(五)之內容。</p> <p>3.本公司除落實發言人制度外，亦設置投資人關係部門，除按季自行召開法人說明會，亦不定期受邀參加投資機構舉辦之法人說明會。針對個人投資者來電提出之疑問，亦會在符合法令規定之範圍內，盡力給予解答。</p> <p>4.本公司業已設置「營運持續管理辦法」及「營運持續管理推行委員會」，每年召開風險鑑別會議，審視可能面臨的各種緊急狀況或影響維運之衝擊，以強化風險管理與應變能力。</p> <p>5.供應商關係：請詳後第五頁(五)履行企業社會責任之評估項目三、(八)~(九)之內容。</p> <p>6.本公司每年提醒董事及經理人依規定持續進修。106年進修情形請參考本表下方之說明三。</p> <p>7.本公司自97年起每年皆為董事(含獨立董事)及經理人購買責任保險。最近一期責任險於106年8月26日到期，經評估後決定將保險金額從US\$20,000,000提高為US\$30,000,000，年保費亦從US\$30,000增加為US\$40,000；本次投保以堆疊方式向美商安達產物保險(股)公司(基層保險部分)及富邦產物保險(股)公司(超額保險部分)辦理續保，保險期間106年8月26日至107年8月26日止，相關保險範圍及內容已於106年11月1日第八屆第3次之董事會中報告。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司於第三屆公司治理評鑑(評鑑105年度)之未得分項目，於第四屆公司治理評鑑(評鑑106年度)時之改善情形說明如下：</p>				
指標類別	指標內容		是否改善	尚未改善及加強措施說明
維護股東權益	1.12 受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%？		是	
	1.14 公司年報是否揭露股東常會決議事項之執行情形？		是	
強化董事會結構與運作	3.4 公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任？		否	本公司之董事長兼任執行長，係因尚未能覓得合適之執行長人選。
	3.12 公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上，且委員會成員至少皆出席兩次以上？		是	
	3.14 公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？		否	部分董事或因公務較為繁忙，或為外籍董事而未能完成進修，已提醒未完成進修董事盡力配合。
	3.31 公司是否定期(至少一年一次)執行董事會績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報？		否	尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將視需要訂定評估之。
提升資訊透明度	4.14 公司年報是否自願揭露個別董事及監察人酬金？		否	因涉及董事個人隱私，尚未取得全體董事同意前暫不揭露。
	4.22 公司年報是否揭露具體明確的股利政策？		是	
落實企業社會責任	5.5 公司是否與員工簽訂團體協約？		否	本公司經營階層相當重視員工福利，且每年皆依營運績效給予員工調薪，故目前尚無與員工簽訂團體協約之必要性。
	5.7 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？		否	本公司業已制定左列之管理政策，因未能完整揭露於年報及公司網站故未得分，未來將改善之。
	5.11 公司是否於公司網站設置利害關係人專區，以瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？		是	

說明一：本公司董事會成員多元化之政策及落實情形：

(一)本公司公司治理實務守則第 20 條第 3 項規定：

董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

(二)落實情形

多元化核心項目 董事及姓名		性 別	營 運 判 斷	會 計 及 財 務 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 決 策
董事長	蔡篤恭	男	√		√	√	√	√	√
董 事	洪嘉銓	男	√		√	√	√	√	√
董 事	古口榮男	男	√		√	√	√	√	√
董 事	吳麗卿	女	√	√	√	√			
董 事	呂肇祥	男	√		√	√	√	√	√
董 事	曾炫章	男	√	√	√	√	√		
董 事	吉田透	男	√		√	√	√	√	√
獨立董事	鄭萬來	男	√	√	√	√			√
獨立董事	林坤禧	男	√		√	√			√
獨立董事	魏幸雄	男	√	√	√	√			√
獨立董事	李培瑛	男	√		√	√	√	√	√

說明二：本公司 106 年度勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰與方蘇立會計師獨立性評估表如下：

影響會計師獨立性之可能事項	是	否
1.是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。		√
2.是否與本公司或其董監事間有融資或保證行為。		√
3.是否有取得本公司之融資或保證事項。		√
4.是否與本公司有密切商業關係事項。		√
5.是否與本公司之董監事、經理人間有密切之商業關係事項。		√
6.簽證會計師目前或最近二年內是否有擔任本公司之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響之職務，或職員。		√
7.簽證會計師是否確定於未來期間將擔任本公司之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響。		√
8.是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。		√
9.是否有收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。		√
10.是否連續七年度接受本公司之委任擔任查核簽證會計師。		√

說明三：106 度本公司董事及經理人進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	蔡篤恭	106/10/27	財團法人中華公司治理協會	公司董事與管理階層的法律風險	3
				公司董事與管理階層的责任義務	3
獨立董事	鄭萬來	106/06/20	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說	6
獨立董事	魏幸雄	106/05/23	社團法人中華公司治理協會	資訊揭露與財報不實的董監責任	3
		106/10/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	防制洗錢及打擊資恐專題	3
獨立董事	李培瑛	106/11/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3
		106/11/23	台灣企業永續研訓中心	由 SDGs 發掘我國永續契機	3
財務長暨副總經理	曾炫章	106/09/11 106/09/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	曾淑慧	106/08/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新勞動法令修正重點與企業薪工循環之內稽實務	6
		106/09/13		內稽人員的法律責任與吹哨者制度之剖析	6

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 1)								兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關料 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商務、法 務、財務、會 計或公務司 業務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	鄭萬來			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事	林坤禧			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
其他	李嘉華			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		106.5.25 卸任
獨立董事	魏幸雄			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		106.6.8 新任

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：第二屆委員任期為 103 年 7 月 4 日至 106 年 5 月 25 日。第三屆委員經第八屆第 1 次董事會重新委任，任期為 106 年 6 月 8 日至 109 年 5 月 25 日。

106 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	鄭萬來	2	0	100%	
委員	林坤禧	2	0	100%	
委員	李嘉華	1	0	100%	106.5.25 卸任
委員	魏幸雄	1	0	100%	106.6.8 新任

應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)；無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理；無此情形。

(五)履行社會責任情形：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、落實公司治理			
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	✓		(一)為了有效推動與落實企業社會責任，本公司參酌『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及相關法令規定制定「企業社會責任實務守則」，於102年11月8日經董事會決議通過實施，以管理對經濟、環境及社會之風險與影響。 本公司並定期檢討改進公司所建置之企業社會責任管理系統，於105年11月4日經董事會決議通過「企業社會責任實務守則」第二次修訂，以提升履行企業社會責任成效。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	✓		(二)請參考本表下方說明一。
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		(三)本公司為健全企業社會責任之管理，103年8月1日設置『企業社會責任室』為專職單位，並於104年2月9日經董事會通過，隸屬於董事會，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期向董事會報告。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵及懲戒制度？	✓		(四)本公司訂定合理之薪資報酬政策及明確有效之績效考核制度，每年皆衡量市場的薪資水平，並參考總體經濟指標、物價指數，並依員工之績效考核結果，對員工薪資作出適當的調整。本公司亦訂有季獎金制度；且於公司章程規定，每年按扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥5%~7.5%為員工酬勞，讓同仁與公司營運共同分享，符合企業社會責任政策。 106年度獎金發放及調薪狀況如下： (1)年中獎金及年終獎金各1個月。 (2)每季之獲利狀況皆達成公司設定之季目標，故每季皆有發放季獎金。 (3)發放員工酬勞326,335仟元，該金額佔提撥規定的5.28%，符合上述政策區間。 (4)依獲利狀況並參考個人工作職責、貢獻度與績效評核發放2次激勵獎金。 (5)平均年度調薪為3%~5%。 另外，本公司為對同仁在工作績效、能力及操行方面有具體客觀的評估標準，業已訂定「獎懲管理辦法」，以作為同仁直屬主管或權責單位提報員工獎勵及懲處時有所依循。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	✓		(一)請參考本表下方說明二。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
<p>(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		(二)為善盡環境保護及照顧員工安全健康之企業責任，本公司依所屬產業特性建立相關之環境管理制度，分別於92年通過ISO 14001環境管理系統及93年通過OHSAS 18001職業安全衛生管理系統驗證，並據以實施環境暨安全衛生管理活動，訂定環境安全永續目標及定期檢討之，藉由國際標準管理系統的運作，有效做好廠內生產過程中所衍生之空污、水污及廢棄物等管控。除此之外，於97年通過IECQ QC080000有害物質管理系統驗證，以確保公司的產品不含危害人體及環境重大衝擊之物質，符合國際法令規章及客戶要求，降低產品對環境之衝擊，提昇產品競爭力。	
<p>(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？</p>	✓		(三)請參考本表下方說明三。	
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		(一)「責任商業聯盟(RBA)(106年10月之前名為電子行業公民聯盟(EICC))」致力於保障全球行業供應鏈的從業人員及社群權利福祉，而「責任商業聯盟行為準則」則是符合「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織之「工作基本原則與權利宣言」與「世界人權宣言」等關鍵性國際人權標準，是一套有關全球行業供應鏈的社會、環境與道德相關的行為規範。本公司於98年導入「責任商業聯盟行為準則」(RBA Code of Conduct)，其範圍涵蓋勞工、健康與安全、環境、道德規範及管理系統，並於104年04月20日宣佈正式加入「責任商業聯盟(RBA)」，成為其會員。社會責任國際標準(Social Accountability 8000 International standard, SA8000)，是一種基於國際勞工組織公約(ILO)、聯合國兒童權利公約、世界人權宣言而制定的準則，用以保護勞工人權、職場環境和勞動條件等為主要內容的管理標準體系，	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>本公司積極導入SA8000社會責任管理系統，已於105年通過SA8000驗證，並取得證書。</p> <p>本公司承諾提供員工得以充分發揮才能的工作環境；為落實該項承諾，我們遵守當地法規，並根據「責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)」及SA8000之國際勞工及人權標準，制定相關之管理政策與程序。</p>
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	✓		(二)請參考本表下方說明四。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)請參考本表下方說明五。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	✓		(四)本公司透過勞資會議及全區福委會使員工代表能針對特定或重大議題反映同仁的建議及看法，並藉由議程中的討論，與公司達成共識，確保溝通管道暢通，透過相關會議記錄、公告、網路平台及內部刊物等通知、公告或傳遞對員工可能造成重大影響之營運變動及相關訊息，建置暢通的溝通管道。
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(五)本公司透過教育訓練體系的規劃，促進經營理念與訓練投入的一致性，展開各項訓練機制交互運作，提供員工全面的訓練與職涯發展的藍圖，針對不同職級進行不同的訓練，確保人才培育與發展能符合公司成長營運所需。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		(六)依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，公司就研發、採購、生產、作業及服務流程制定相關政策如：防範產品或服務損害利害關係人、禁止洩露機密資訊、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為等政策。 並建立相關檢舉申訴程序，檢舉申訴管道除公司內部公告外亦揭露於公司網頁。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	✓		(七)本公司主要業務係提供半導體封裝及測試服務，並非最終產品製造者，故不適用。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	✓		(八)本公司將供應商/承攬商視為合作伙伴，致力於共同建立穩定發展及永續經營的供應鏈管理。持續性的針對品質、交期、成本及技術等制定目標與評比，並每年按

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>年度計劃進行拜訪與系統的現場稽核，其稽核系統包含：</p> <p>(1) 品質管理系統</p> <p>(2) 原物料有害物質禁用的綠色產品管理系統</p> <p>(3) 勞工人權、環境、道德等之 RBA 行為準則管理系統</p> <p>(4) 環境安全衛生風險管理</p> <p>此外，依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象，採行適當查核程序，檢視商業往來對象，以瞭解過去有無影響環境與社會之紀錄。</p>
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	✓		(九)本公司與供應商所簽訂之契約，均將企業社會責任政策納入契約條款，於契約中明訂供應商如涉及違反其企業社會責任政策且對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除契約之條款。
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？</p>	✓		<p>(一)本公司除依規定於公開資訊觀測站揭露相關訊息外，自102年起，每年編製企業社會責任報告書，並在本公司網頁揭露企業社會責任之相關資訊，網址如下： (http://www.pti.com.tw/ptiweb/index.aspx)</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司參酌『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及相關法令制定「企業社會責任實務守則」，於102年11月8日經董事會決議通過實施，並於105年11月4日經董事會決議通過第二次修訂，以提升履行企業社會責任成效，落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業社會責任資訊揭露，其運作與所訂守則並無差異情形。本守則適用於本公司及其轄下各子公司之整體營運活動。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：</p> <p>請參考本表下方說明六。</p>			
<p>七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p> <p>本公司106年企業社會責任報告書依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 所出版的GRI準則之「核心」選項撰寫，經獨立第三方公正單位英國標準協會 (BSI) 依據AA1000 AS Type II高度保證等級進行查證，並另由資誠聯合會計師事務所 (PWC) 依ISAE3000標準進行有限確信 (Limited Assurance)</p>			

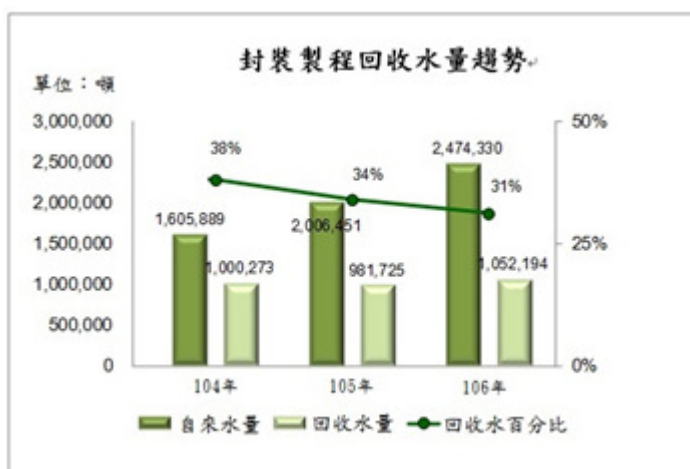
說明：一、本公司每年依據『年度教育訓練計劃』規劃，定期對新進人員及在職員工舉辦企業社會責任相關政策之教育訓練課程，以培訓員工對於社會責任相關知識及法規。106年社會責任教育訓練結果如下：

課程類別	課程名稱	受訓人次
企業經營法規課程	個人資料保護法	3,504
	營業秘密法	3,504
	企業從業道德規範	3,504
	新進員工一般教育訓練（公司資訊保密規定）	1,920
人權課程	RBA條文介紹	146
	SA8000條文介紹	93
	人員管理法令介紹	230
	新進員工一般教育訓練 (RBA行為準則、員工從業道德規範、SA8000)	1,920

二、本公司為提升各項資源之利用率並降低生產活動對於環境所造成之衝擊，針對可回收之能/資源建立績效管理目標，並定期檢視執行成果，此外，在不影響產品品質之前提下，評估並提倡使用對環境負荷衝擊低之再生物料。為因應現今氣候變遷與水資源枯竭的狀況，我們逐年增加製程回收水量來取代自來水使用需求。

項目	104年	105年	106年
廢棄物回收總重量(噸)	695.5	708.6	612.1
節省電力消耗量(kWh)	10,044,526	5,837,329	4,802,805
廢水回收處理量(噸)	1,000,273	981,725	1,052,194

106年封裝製程回收水量佔自來水量比例34%，較104年38%，減少約4%。



三、本公司為善盡企業社會責任，透過內部管理系統運作及多項污染防治設施，推動節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及廢棄物管理等措施，以維護永續環境之目的，詳細內容說明如下：

1. 設置環境保護專責單位

本公司設有工安環保部門，專職負責工安環保事務之管理與推行，以及監督各項污染防治設施之正常運作。此外，亦設有「工安環保委員會」，由高階主管、各廠廠長及勞工代表們參與會議，透過定期召開會議並研議公司安全衛生與環境保護之議案，讓環境永續議題融入經營管理中。

2. 制定環境及安全衛生政策

為厚植人員安全及環境保護觀念於企業營運及每一位人員的意識中，本公司業已制定「環境安全衛生政策」，將環境與安全衛生政策落實於員工、客戶及相關利害團體上，具體政策有：

- (1) 將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
 - (2) 符合環境保護及安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
 - (3) 全體員工參與防止傷害、疾病、事故預防及損失控制。
 - (4) 順應國際環境保護趨勢，積極推動節能減廢活動。
 - (5) 持續檢討與改進，提高安全衛生及環境管理整體績效。
3. 推動節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及廢棄物管理等具體措施
為因應氣候變遷影響，本公司擬定年度目標，用具體數據管理環境保護之成效，包括有：
- (1) 年度目標
 - ▲提升廢棄物回收總重量每月大於 50 噸
(General Waste Recycling Amount \geq 50 ton/month)
 - ▲切割和研磨廢水回收率達 87%
(Dicing & Grinding Wastewater Recovery Rate $>87\%$)
 - ▲溫室氣體減量目標從 2015 年起至 2030 年，減量達 15%
(Reduce CO₂e Emission From 2015 in 2030 target for 15%)
 - (2) 環境管理計劃
為善盡企業社會責任，透過污染防治設施妥善操作，以維護永續環境，長期執行下列環境管理計劃與措施：
 - A. 廢氣處理：設置空氣污染防治設備處理 VOCs，每年依法規之要求定期檢測，並配合環保局委託之檢測公司對空氣污染防治設備排放管道之處理效率進行抽測，其檢測結果皆符合法規要求。
 - B. 製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，用製程回收水量來取代自來水之使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
 - C. 廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物清理，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。對於製程廢棄物之處理模式為收集、分類、減量及回收，主要管理策略是以「資源回收」來取代「掩埋處置」，讓廢棄物變為可用資源，降低環境衝擊，並有效管理以提高資源再利用的價值。
 - D. 協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業環保責任及達成永續供應鏈目標。
 - E. 節能減碳：成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；並揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢，為降低氣候暖化善盡企業責任。
 - F. 自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，以有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。
 - G. 環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更，使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。
 - (3) 溫室氣體盤查及減量
自 96 年起，即每年自發性的實施溫室氣體盤查，並將盤查結果作為減量依據，106 年本公司獲評 CDP 國際組織氣候變遷成績為 A-，該成績目前為國內廠商中最高層級；近三年溫室氣體排放量如下表所示。

溫室氣體排放量 (單位: ton CO ₂ e/year)			
項目	104年	105年	106年
範疇1	4,297	34,466.84	31,794.57
範疇2	258,616	275,043.83	322,940.02
總排放量	262,913	309,510.67	354,734.59

本公司 106 年之溫室氣體排放量，直接溫室氣體排放(範疇 1)約佔總排放量之 8.96%；間接溫室氣體排放(範疇 2)主要為電力耗用，約佔總排放量之 91.04%，故本公司具體的溫室氣體減量策略著重於用電管理及以減少用電量為核心之方針執行。

為落實發展永續環境，本公司亦於「企業社會責任實務守則」中明白制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，以及將碳權取得納入公司之減碳策略規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

(4) 106 年具體成效

本公司積極推動因應全球氣候變遷的行動方案，106 年的顯著成效說明如下：

▲ 榮獲經濟部工業局頒發水足跡認證

本公司湖口廠、大同廠及集團總部等廠區通過台灣檢驗科技公司 (SGS) 之查證程序，取得組織型及產品型(Flash)水足跡查證聲明書(ISO14046)，並榮獲經濟部工業局頒發水足跡認證。

▲ CDP 氣候變遷成績獲評 A-

本公司 CDP 氣候變遷成績獲評 A-，等級列為領導(Leadership)。

▲ 水揭露 (Water Questionnaire, WQ) 成績獲評 B

本公司首次參與的水揭露 (Water Questionnaire, WQ) 成績獲評 B，等級列為管理(Management)。

四、本公司建構全方位、多元、雙向、開放的反映溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，深入了解員工對管理與福利制度之滿意度，透過落實員工溝通、意見的傳達，使員工的心聲得以有效被處理及回覆，也透過公正、保密、迅速的處理過程，解決員工的疑惑，建構良好的勞資關係。不論具名或匿名反應，過程中皆以保密及公正之原則保護員工，員工可放心的在無報復的友善環境中進行溝通。



五、本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，提供一個安全和健康之工作場所。工作環境與員工人身安全保護措施如下：

1. 訂定「環境安全衛生政策」

為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，訂定「環境安全衛生政策」。

- (1) 將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
- (2) 符合環境保護及安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
- (3) 全體員工參與防止傷害、疾病、事故預防及損失控制。
- (4) 順應國際環境保護趨勢，積極推動節能減廢活動。
- (5) 持續檢討改進，提高安全衛生及環境管理整體績效。

2. 依循安全衛生管理系統管控

以 ISO 14001 及 OHSAS 18001 之管理系統展開與管控。

3. 作業環境測定

本公司每半年實施一次作業環境測定來瞭解工作環境危害暴露的實際情況，若測量結果顯示有異常的測值，將針對異常區域實施監測並著手進行改善。

4. 個人防護管理

為維護員工的安全和健康，減少於操作過程中接觸有害因子，本公司建立了個人防護具管理作業規範，並要求員工在進行危害性作業操作時穿戴適當的個人防護具。

5. 健康關懷與照顧

本公司提供完善的員工照顧與健康關懷機制，照顧每位同仁的身心健康，包含全方位的溝通管道、設置心理諮商機制、與專業醫療機構合作進行定期健康檢查、提供醫療諮詢服務、重視母性同仁健康保護及對於同仁因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，並適時對員工宣導疾病預防等，來照護員工之身心健康。

6. 實施教育訓練

為提高員工環境安全衛生意識，除了新進人員的教育訓練外，本公司每年規劃各種教育訓練課程，如廢棄物貯存分類規定、溫室氣體排放盤查、危害鑑別、風險評估暨環境考量面、個人防護具管理實務、自動檢查方式、緊急應變及健康講座等。

六、本公司 105 年企業社會責任運作情形及履行成效之重要資訊如下：

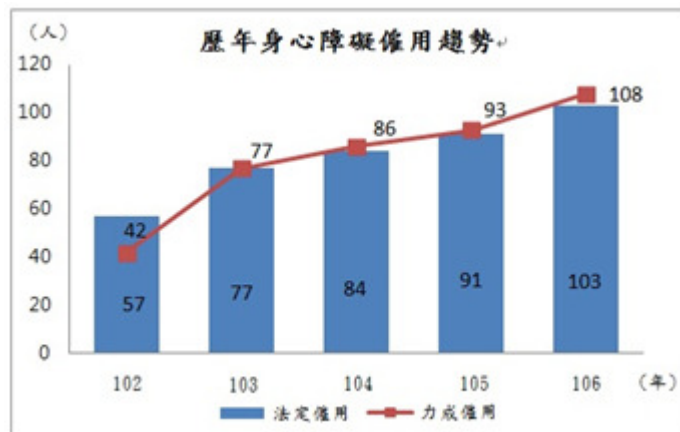
社會面：

1. 提供就業機會

本公司持續提供就業機會，106 年共聘用 2,600 位新進員工，在積極聘用各類人才的同時，亦提供了適合的工作機會給弱勢族群，106 年共聘用 23 名弱勢族群，有助於解決弱勢員工的經濟壓力。

2. 身心障礙就業

本公司為秉持照顧弱勢群體，持續改善工作環境，使更多弱勢朋友能加入我們的大家庭，106 年 12 月份聘用身心障礙員額數為 108 人，優於政府法令規定人數，106 年度統計新聘用 25 名身心障礙員工。



3. 成立「力成科技教育基金會」

▲本公司於 106 年成立「力成科技教育基金會」，秉持教育公益為出發點，以落實推動「科技教育」、「人文教育」及「人才培育」為宗旨，善盡企業社會責任。

▲106 年力成科技教育基金會獎助學金共發放 46 名學子；以及捐助「築心之家」、「綠光種子課輔教室」與「天主教聖方濟兒少中心」、「竹東鎮中山國小」與「尖石鄉錦屏國小」等五個團體教育資源，嘉惠二百多名孩童。

4. 志工活動

本公司成立「志工社」並結合力成科技教育基金會，積極推動社會服務與關懷，善盡回饋社會的企業責任，配合公司活動適時邀請慈善公益團體設攤義賣，增加公益團體募集資金機會、弱勢兒童照護、獨居老人關懷及公益團體捐助等。本公司志工社認養的育幼院有：綠光種子、泰雅學堂、新竹家扶中心、懷德風箏綠地育幼院、築心之家、苗栗幼安教養院...等。

5.產學合作

本公司推行產學接軌制度，積極與鄰近學校攜手合作，兼顧進修及促進成就更多就業機會，確保育才、留才並創造產學雙贏的合作模式。

員工面：

1.育嬰留職停薪政策

本公司配合國家政策，提供完善的育嬰留職停薪方案，鼓勵員工生育。106 年力成寶寶誕生數為 377 人。

▲育嬰留停：106 年度共有 111 名員工申請過育嬰留停，且申請人不侷限於女性同仁，其中更有 17 名男性員工申請育嬰留停，比率達 15%。而生育後選擇回到本公司持續服務的員工高達 77%，更有高達 88%的復職同仁一年後仍持續在職。

▲哺乳室的設置：我們鼓勵產後員工哺集母乳，各廠區均設置集乳室，內備有冰箱及安心舒適之個人專屬空間，以供哺乳的媽咪們使用。

▲孕婦專用車位：為了讓孕婦及產後媽咪享有便利及較佳的工作環境，我們於各廠區均設置孕婦專用車位，以保障孕婦優先停車之權益。

2.托兒服務

力成科技關心員工與其家庭的互動，我們不僅提供許多區域工作的機會，更為員工家庭生活帶來活力與幸福；透過福委會簽訂特約員工居住區域的優良幼兒園、托兒機構，提供員工子女就讀的選擇及學前教育的照料，讓同仁無後顧之憂，兼具職場與家庭的幸福生活。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，並基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關施行細則訂定本公司「誠信經營及從業道德守則」，經董事會於中華民國102年4月30日決議通過後實施，並於104年2月9日經董事會決議通過第一次修訂。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
<p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲處及申訴制度，且落實執行？</p>	✓		(二)本公司「誠信經營及從業道德守則」中針對下列各類型行為制定行為指南、檢舉制度、不誠信之行為處置、獎懲及申訴制度，且落實執行： 1.禁止提供或收受不當利益 2.禁止與處理疏通費之程序 3.利益衝突迴避 4.政治獻金、慈善捐贈或贊助辦理程序 5.建立商業關係程序 6.揭露公司誠信經營政策 7.禁止從事內線交易 8.禁止洩露機密資訊 9.禁止侵害智慧財產權 10.禁止從事不公平競爭之行為 11.防範產品或服務損害利害關係人	
<p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	✓		(三)請參考本表下方說明一。	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	✓		(一)請參考本表下方說明二。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p>	✓		(二)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，於103年8月1日設置『企業社會責任室』為專職單位，並於104年2月9日經董事會通過隸屬於董事會，負責本公司誠信經營政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，每年定期向董事會報告，106年度之執行情形已於106年11月1日第八屆第3次董事會報告事項第7案向各出席董事報告。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司新進人員皆會簽署『聘僱合約書』，合約書內容表明員工應遵守利益規避，且本公司自104年起，每位員工每年須簽署『利益衝突迴避同意書』；自105年起亦將遵循誠信經營制度的線上課程與年度績效考核連結，以徹底落實執行本公司誠信經營及從業道德政策。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司業已建立完備之會計制度及內控機制，並由內部稽核單位依年度稽核計劃執行相關查核，並作成稽核報告提報審計委員會及董事會，必要時亦得委任會計師執行查核。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)請參考本表下方說明三。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司提供暢通溝通管道與多元化申訴機制，除於同仁手冊之服務準則中宣達遵循誠信原則之規範，讓同仁遵守，亦設置有「員工溝通管道作業規範」實踐多元暢通的雙向溝通環境，以及「獎懲管理辦法」可供施行及運作，並有專責人員負責受理檢舉案件，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復，並指派適當人員處理及回覆檢舉案件。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	✓		(二)請參考本表下方說明四。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司對於檢舉人之身分均嚴格保密保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當之處置，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復。
四、加強資訊揭露			
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司「誠信經營及從業道德守則」內容及推動成效，皆揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，網址如下： http://www.pti.com.tw/ptiweb/policy/ 誠信經營及從業道德守則.pdf http://www.pti.com.tw/ptiweb/G0053.aspx?p=G&c=G5

與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符

與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：			
			本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」制訂『誠信經營及從業道德守則』，其之運作與其所訂守則並無差異情形。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			
			(一)本公司定期檢討並改進公司所建置之誠信經營政策，於104年2月9日經董事會決議通過「誠信經營及從業道德守則」第一次修訂，以提升履行成效，並決議通過本公司『企業社會責任室』為專責單位，隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之修定及監督執行，並定期向董事會報告。
			(二)105年底至106年期間本公司接獲檢舉有兩位員工疑涉有不誠信之行為，經受理檢舉事項之調查標準及作業程序確認成案後，由法務單位進行調查，經查屬實，隨即將該兩位員工免職，並主動向新竹地方法院檢察署提告並報請偵辦，檢察署檢察官於107年4月偵查終結，將被告依違反刑法342條背信罪及證交法171條第1項第3款特別背信罪提起公訴；目前仍在司法審判程序中。該案已於106年11月1日第八屆第3次董事會報告事項第7案之誠信經營執行情形，向出席董事說明，另於107年5月4日第二屆第5次審計委員會及第八屆第6次董事會向出席董事報告新竹地方法院檢察署偵查結果。

- 說明：一、本公司對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款具較高不誠信行為風險之營業活動（行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益），採行下列防範措施：
- 1.訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
 - 2.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
 - 3.舉辦公司誠信政策教育訓練與宣導，使員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。
 - 4.規劃檢舉制度及訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序，並確保執行之有效性。
 - 5.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形作成報告。
 - 6.建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。
- 二、依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，避免與涉有不誠信行為者進行交易。本公司於評估商業往來交易對象時，須採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：
- 1.該供應商之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
 - 2.該供應商是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
 - 3.該供應商營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
 - 4.該供應商所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
 - 5.該供應商長期經營狀況及商譽。
 - 6.該供應商是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

本公司人員於從事商業行為過程中，須向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

本公司與他人簽訂契約時，須充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中得明訂下列事項：

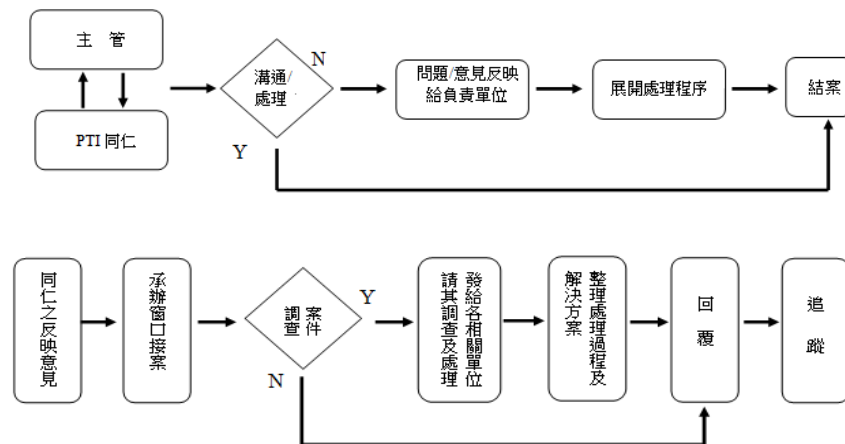
- (1)任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償。
- (2)任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。

三、本公司除指派相關人員參加外部誠信經營相關訓練之外，公司內部每年定期舉辦誠信經營相關教育訓練課程，包括：個人資料保護、企業從業道德、營業秘密法、公司資訊保密規定及員工從業道德規範等。106年誠信經營教育訓練結果如下：

參與課程人員	課程名稱	受訓人次
新進員工	新進員工一般教育訓練 (公司資訊保密規定、員工從業道德規範)	3,000
在職員工	專利權使用的法律基本概念	87
	個人資料保護法	76
	營業秘密法	75
	企業從業道德規範	110

四、本公司訂定受理檢舉事項之調查標準及作業程序如下：

處理程序：



(七)公司治理守則及相關規章查詢方式：

本公司公司治理守則及相關規章查詢網址如下：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.pti.com.tw>

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書

力成科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：107年3月16日

本公司民國106年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國106年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國107年3月16日董事會通過，出席董事10人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

力成科技股份有限公司

董 事 長：

簽章

總 經 理：

簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無此情形。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議事項及執行情形

日期	董事會/股東會	重要決議事項
106/5/26	股東常會	<p>1.通過承認 105 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>2.通過承認 105 年度盈餘分配案。 執行情形：訂定 106 年 8 月 7 日為分配基準日，106 年 9 月 5 日為發放日(每股配發現金股利 3.28 元)，已如期發放完畢。</p> <p>3.通過以資本公積發放現金案。 執行情形：訂定 106 年 8 月 7 日為發放基準日，106 年 9 月 5 日為發放日(每股發放現金 0.72 元)，已如期發放完畢。</p> <p>4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 執行情形：已於 106 年 6 月 16 日獲經濟部准予變更登記，並公告於本公司網站。</p> <p>5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 執行情形：已於 106 年 6 月 7 日公告於本公司網站及公開資訊觀測站，並依修訂後程序辦理。</p> <p>6.第八屆董事及獨立董事選任案。 董事當選名單：蔡篤恭、洪嘉鎰 美商金士頓科技(股)公司投資專戶 代表人：古口榮男、吳麗卿、呂肇祥、曾炫章 台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透 獨立董事當選名單：鄭萬來、林坤禧、魏幸雄、李培瑛 執行情形：已於股東會後當日發布重大訊息，於 106 年 6 月 16 日獲經濟部准予變更登記，並公告於本公司網站。</p> <p>7.通過解除董事競業禁止限制案。 執行情形：已於股東會後當日發布重大訊息。</p>

2.董事會重要決議事項

日期	董事會/股東會	重要決議事項
106/2/22	董事會 (第 7 屆第 18 次)	<p>1.通過 105 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.通過 105 年度盈餘分配案。</p> <p>3.通過以資本公積發放現金案。</p> <p>4.通過分配 105 年度董事酬勞及員工酬勞案。</p>

日期	董事會/股東會	重要決議事項
		5.通過出具 105 年度內控聲明書案。 6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.通過向金融機構申請授信額度案。 8.通過申請買賣遠期外匯額度案。 9.通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。 10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11.通過經理人薪資調整案。 12.通過評估本公司聘僱會計師之獨立性及適任性案。 13.通過董事全面改選案。 14.通過董事競業禁止限制之解除案。 15.通過中華民國 106 年度股東常會召集案。
106/4/14	董事會 (第 7 屆第 19 次)	1.通過審查本公司股東所提董事(含獨立董事)候選人名單案。 2.通過增加對力成科技全資子公司「力成科技日本合同會社」之投資案。 3.通過本公司擬透過日本全資子公司「力成科技日本合同會社」公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc. 股份案。 4.通過本公司擬透過日本全資子公司「力成科技日本合同會社」購買 Micron Akita, Inc 之全部股份案。 5.通過捐贈財團法人力成科技教育基金會案。
106/5/5	董事會 (第 7 屆第 20 次)	1.報告本公司 106 年度第一季財務報表。 2.通過向金融機構申請授信額度案。 3.通過申請買賣遠期外匯額度案。 4.通過提供子公司背書保證案。
106/6/8	董事會 (第 8 屆第 1 次)	1.通過選任董事長案。 2.通過委任第二屆審計委員會委員案。 3.通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案。 4.通過增加國內股權投資案。 5.通過訂定本公司 105 年度盈餘分配之配息基準日暨資本公積發放現金之基準日案。
106/8/8	董事會 (第 8 屆第 2 次)	1.報告本公司 106 年度第二季財務報表。 2.通過訂定本公司董事車馬費案。 3.通過訂定本公司獨立董事報酬案。 4.通過本公司 105 年度經理人員工酬勞分配案。 5.通過經理人聘任案。 6.通過經理人競業禁止之解除案。 7.通過修訂「力成科技股份有限公司指派法人董監事代表人或指定以個人擔任董監席次管理辦法」部分條文案。

日期	董事會/股東會	重要決議事項
		8.通過提供子公司背書保證案。 9.通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。 10.通過向金融機構申請授信額度案。 11.通過申請買賣遠期外匯額度案。
106/11/1	董事會 (第8屆第3次)	1.報告本公司106年度第三季財務報表。 2.通過訂定107年度內部稽核計劃案。 3.通過向金融機構申請授信額度案。 4.通過申請買賣遠期外匯額度案。 5.通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。
107/1/30	董事會 (第8屆第4次)	1.通過本公司107年營運計畫案。 2.通過修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。 3.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
107/3/16	董事會 (第8屆第5次)	1.通過106年度營業報告書及財務報表案。 2.通過106年度盈餘分配案。 3.通過分配106年度董事酬勞及員工酬勞案。 4.通過協助本公司員工成立持股會以辦理員工持股信託案。 5.通過經理人薪資調整案。 6.通過106年度內部控制制度有效性考核暨出具106年度內控聲明書案。 7.通過向金融機構申請授信額度案。 8.通過申請買賣遠期外匯額度案。 9.通過資金貸與子公司案。 10.通過提供子公司背書保證案。 11.通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。 12.通過增加國內股權投資案。 13.通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。 14.通過中華民國107年度股東常會召集案。
107/5/4	董事會 (第8屆第6次)	1.報告本公司106年度第一季財務報表。 2.通過提供子公司背書保證案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：

無此情形。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形：

無此情形。

五、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰	方蘇立	106.01.01~106.12.31	

金額單位：新臺幣千元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元				
2	2,000 千元 (含) ~4,000 千元				
3	4,000 千元 (含) ~6,000 千元				
4	6,000 千元 (含) ~8,000 千元		V	V	
5	8,000 千元 (含) ~10,000 千元				
6	10,000 千元 (含) 以上				V

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰 方蘇立	7,600	0	0	0	6,690	6,690	106.1.1~12.31	其他非審計公費包含： 1.日本投資計劃公費 5,896 仟元。 2.直扣法查核公費及代墊款項 150 仟元。 3.移轉訂價報告公費 350 仟元。 4.事務所代墊之影印費與查帳人員餐費車資等費用 294 仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

六、更換會計師資訊：

本公司於最近兩年度及 107 年截至年報刊印日止，並無更換會計師之情形。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊：無此情形。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	106 年度		107 年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	蔡篤恭	0	—	0	—
董事	KTC-TU Corporation (註) 代表人：吳麗卿、曾炫章	0	0	—	—
董事	KTC-SUN Corporation (註) 代表人：洪嘉鋣、古口榮男	0	0	—	—
董事	美商金士頓科技股份有限公司 投資專戶(註) (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男、吳麗卿 、呂肇祥、曾炫章	0	—	0	—
董事	台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：吉田透	0	—	0	—
獨立董事	林坤禧	0	—	0	—
獨立董事	鄭萬來	(90,000)	—	0	—
獨立董事	魏幸雄	0	—	0	—
獨立董事	李培瑛(註)	0	—	0	—
董事暨總經理	洪嘉鋣(註)	(25,000)	—	0	—
經理人	呂肇祥	(27,000)	—	0	—
經理人	王文忠	(18,000)	—	0	—
經理人	詹焜智	(15,000)	—	0	—
經理人	沈錫文	(75,000)	—	(5,000)	—
經理人	張嘉行	(24,000)	—	0	—
經理人	賴宏洋	(5,000)	—	(2,000)	—
經理人	鄭志明	0	—	—	—
經理人	陳玉欽	0	—	0	—
經理人	吳文維	(67,000)	—	(5,000)	—
經理人	李躬富	0	—	0	—
經理人	紀有章	(60,000)	—	0	—
經理人	巫勤達	(14,000)	—	0	—
經理人	方立志	0	—	(43,000)	—
經理人	林賢鳳	(9,000)	—	0	—
經理人	陳世恭	0	—	0	—
經理人	張吉文	0	—	0	—
經理人	董定鑫	0	—	0	—
財務會計主管	曾炫章	(39,000)	—	0	—

註：本公司於 106 年股東常會全面改選第八屆董事及獨立董事，改選後各新增一位董事及獨立董事。原董事 KTC-TU Corporation 及 KTC-SUN Corporation 於改選後卸任。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊：

107年4月10日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
臺銀保管馬仕投資基金公司投資專戶	33,966,990	4.36%	—	—	—	—	無	—	—
美商金士頓科技(股)公司投資專戶	29,875,000	3.83%	—	—	—	—	美商 KTC-TU 公司、美商 KTC-SUN 公司	該兩公司之代表人與該股東及副總裁為同一人	—
美商 KTC-TU 公司 代表人：杜紀川 (John Tu)	19,977,554 0	2.56% 0.00%	—	—	—	—	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶	該公司之總裁與該股東為同一人	—
新制勞工退休基金	18,879,200	2.42%	—	—	—	—	無	—	—
舊制勞工退休基金	16,321,000	2.09%	—	—	—	—	無	—	—
美商 KTC-SUN 公司 代表人：孫大衛 (David Sun)	15,665,362 0	2.01% 0.00%	—	—	—	—	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶	該公司之副總裁與該股東為同一人	—
富邦人壽保險(股)公司 代表人：蔡明興	15,000,000 0	1.93% 0.00%	—	—	—	—	無	—	—
花旗託管新加坡政府投資專戶	14,888,000	1.91%	—	—	—	—	無	—	—
南山人壽保險(股)公司 代表人：杜英宗	13,717,000 0	1.76% 0.00%	—	—	—	—	無	—	—
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	11,774,000	1.51%	—	—	—	—	無	—	—

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
晶兆成科技(股)公司	65,439,500	49.00%	68,110,500	51%	133,550,000	100.00%
Powertech Holding (BVI) Inc.	50,000	100.00%	0	0%	50,000	100.00%
超豐電子(股)公司	244,064,379	42.91%	0	0%	244,064,379	42.91%
POWERTECH TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	85,000,000	100.00%	0	0%	85,000,000	100.00%
力成科技日本合同會社	—	100.00%	0	0%	—	100.00%

註：係公司採權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
86/5	10	200,000	2,000,000	60,000.0	600,000	創立.現金增資 600,000 仟元	無	無
87/4	12	200,000	2,000,000	120,000.0	1,200,000	現金增資 600,000 仟元	無	註 1
88/5	11	200,000	2,000,000	200,000.0	2,000,000	現金增資 800,000 仟元	無	註 2
90/8	10	280,000	2,800,000	221,800.0	2,218,000	盈餘.資本公積轉增資 218,000 仟元	無	註 3
91/9	10	280,000	2,800,000	235,222.9	2,352,229	盈餘轉增資 134,229 仟元	無	註 4
91/9	11.5	280,000	2,800,000	246,312.9	2,463,129	現金增資 110,900 仟元	無	註 5
92/9	10	280,000	2,800,000	261,250.0	2,612,500	盈餘轉增資 149,371 仟元	無	註 6
93/9	10	440,000	4,400,000	308,000.0	3,080,000	盈餘轉增資 467,500 仟元	無	註 7
93/9	43	440,000	4,400,000	338,000.0	3,380,000	現金增資 300,000 仟元	無	註 8
94/6	10	580,000	5,800,000	400,500.0	4,005,000	盈餘轉增資 625,000 仟元	無	註 9
95/6	10	580,000	5,800,000	471,000.0	4,710,000	盈餘轉增資 705,000 仟元	無	註 10
96/6	10	580,000	5,800,000	556,300.0	5,563,000	盈餘轉增資 853,000 仟元	無	註 11
97/6	10	750,000	7,500,000	630,800.0	6,308,000	盈餘轉增資 745,000 仟元	無	註 12
98/7	10	750,000	7,500,000	669,385.2	6,693,852	盈餘轉增資 385,852 仟元	無	註 13
99/5	60.6	750,000	7,500,000	704,236.7	7,042,367	私募可轉換公司債轉換為普通股 348,515 仟元	無	註 14
99/9	58.4	750,000	7,500,000	715,366.8	7,153,668	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 15
99/12	58.4	750,000	7,500,000	726,496.9	7,264,969	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 16
100/8	10	1,000,000	10,000,000	799,146.6	7,991,466	盈餘轉增資 726,497 仟元	無	註 17
101/8	10	1,000,000	10,000,000	779,146.6	7,791,466	註銷庫藏股減資 200,000 仟元	無	註 18

註 1：87.02.17(87)台財證(一)第 18910 號函
 註 2：88.03.02(88)台財證(一)第 22357 號函
 註 3：90.06.21(90)台財證(一)第 139798 號函
 註 4：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137911 號函
 註 5：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137913 號函
 註 6：92.07.08(92)台財證(一)第 0920130303 號函
 註 7：93.06.25(93)台財證(一)第 0930128233 號函
 註 8：93.07.06(93)證期一字第 0930128234 號函
 註 9：94.06.24 金管證一字第 0940125391 號函

註 10：95.06.27 金管證一字第 0950126720 號函
 註 11：96.06.28 金管證一字第 0960032903 號函
 註 12：97.06.25 金管證一字第 0970031487 號函
 註 13：98.07.02 金管證一字第 0980032960 號函
 註 14：99.05.05 經授商字第 09901091340 號函
 註 15：99.09.21 經授商字第 09901214270 號函
 註 16：99.12.31 經授商字第 09901291530 號函
 註 17：100.8.11 經授商字第 10001183300 號函
 註 18：101.8.27 經授商字第 10101177670 號函

2.股份種類

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名普通股	779,146,634	220,853,366	1,000,000,000	上市公司股票

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

107年4月10日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	5	25	252	30,343	768	31,393
持有股數	45,162,000	57,169,000	37,245,348	89,722,181	549,848,105	779,146,634
持有比例	5.80%	7.34%	4.78%	11.51%	70.57%	100.00%

(三)股權分散情形

107年4月10日；單位：股

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 ~ 999	16,690	1,334,037	0.17%
1,000 ~ 5,000	10,860	21,926,453	2.81%
5,001 ~ 10,000	1,664	12,596,090	1.62%
10,001 ~ 15,000	540	6,748,195	0.87%
15,001 ~ 20,000	297	5,381,139	0.69%
20,001 ~ 30,000	306	7,716,799	0.99%
30,001 ~ 50,000	276	10,876,664	1.40%
50,001 ~ 100,000	230	16,518,677	2.12%
100,001 ~ 200,000	176	25,412,693	3.26%
200,001 ~ 400,000	108	30,734,776	3.95%
400,001 ~ 600,000	61	29,238,934	3.75%
600,001 ~ 800,000	26	17,690,656	2.27%
800,001 ~ 1,000,000	29	25,876,458	3.32%
1,000,001 以上	130	567,095,063	72.78%
合計	31,393	779,146,634	100%

(四)主要股東名單

107年4月10日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
臺銀保管馬仕投資基金公司投資專戶		33,966,990	4.36%
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶		29,875,000	3.83%
美商 KTC-TU 公司		19,977,554	2.56%
新制勞工退休基金		18,879,200	2.42%
舊制勞工退休基金		16,321,000	2.09%
美商 KTC-SUN 公司		15,665,362	2.01%
富邦人壽保險股份有限公司		15,000,000	1.93%
花旗託管新加坡政府投資專戶		14,888,000	1.91%
南山人壽保險股份有限公司		13,717,000	1.76%
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		11,774,000	1.51%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股/元

項目		年度		107 年度截至 4 月 30 日 (註8)	
		105 年	106 年		
每股市價	最高	92.50	105.50	97.30	
	最低	62.50	82.90	84.80	
	平均	75.91	91.31	91.27	
每股淨值 (註2)	分配前	45.97	48.85	-	
	分配後	41.97	-	-	
每股盈餘	加權平均股數	779,147	779,147	-	
	每股盈餘(註3)	6.20	7.51	-	
每股股利	現金股利(註)	4	(註1) 4.5	-	
	無償配股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利(註4)	-	-	-	
投資報酬分析	本益比(註5)	12.24	12.16	-	
	本利比(註6)	18.98	(註1) 20.29	-	
	現金股利殖利率(註7)	5.27%	(註1) 4.93%	-	

註：105年則以盈餘分配方式配發3.28元，以資本公積配發0.72元。106年則全數以盈餘分配方式配發。

註1：俟股東會決議後定案。

註2：以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註5：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註6：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註7：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註8：截至年報刊印日止，除每股市價之資訊外，其餘欄位因無最近一季經會計師查核（核閱）之財務報告，故無相關資料可揭露。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司章程第21條之1第3項規定，本公司屬資本密集之產業，股利政策須考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、市場競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，本公司股東紅利之發放分為現金股利及股票股利，其中現金股利以不低於股利總額之20%。

本公司為維持穩定且可持續性的股利政策，係依據近年度實際營運狀況、考量投資機會及資金需求規劃而擬定股東股利。

2.股利政策之執行狀況說明如下：

(1)本公司於民國92年至99年間處於營運成長期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約50%分派股東股利，而分派之股利中，現金股利約佔80%，股票股利則約佔20%。

(2)自民國100年起，本公司開始進入獲利穩定期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約66%分派股東股利，而分派之股利中，100%以現金股

利發放。期間雖然於 102 年度因權利金和解賠償而導致虧損外，本公司仍以資本公積配發的方式，每股發放現金 2 元。

(3)本公司為延續民國 100 年後之股利政策，於 107 年 3 月 16 日第八屆第 5 次董事會決議擬每股發放現金股利 4.5 元，預計發放金額合計約占 106 年度所產生保留盈餘之 60%，尚符合現階段本公司之股利政策。倘若未來本公司之營運狀況未發生重大變化時，亦將延續目前之股利政策。

3.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 107 年度擬自 106 年度盈餘中分派現金股利計新台幣 3,506,159,853 元，依目前流通在外股數每股發放現金股利 4.5 元，實際股利分配情形將待 107 年股東會決議後執行之。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議分派 106 年度之盈餘並無無償配股之情形。

(八)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司於 105 年 1 月 15 日經 105 年第一次股東臨時會決議通過修訂公司章程，其中有關員工及董事酬勞之分派原則規定如下：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~7.5% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。本公司獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞分配。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

106 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎係依上述公司章程之規定予以估列，若實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列入實際分派年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

本公司於民國 107 年 3 月 16 日經第八屆第 5 次董事會決議通過分派 106 年度之員工及董事酬勞如下：

(1)員工酬勞新台幣 394,825,197 元及董事酬勞新台幣 78,965,039 元，分別佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利的 5.39% 及 1.08%，均以現金方式發放。上述金額與 106 年財報帳列數比較並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期並無以股票分派員工酬勞之情形，故不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司於106年5月26日由股東常會通過105年度盈餘分配案中，有關員工紅利及董事酬勞之分派情形如下：

	金額(元)
員工紅利—以現金方式發放	326,335,828
董事酬勞—以現金方式發放	65,267,166
合 計	<u>\$ 325,281,076</u>

上述實際分派情形與原董事會決議相較並無差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：

107年4月30日

項目		發行(辦理)日期	
		95年1月23日	95年2月10日
發行及交易地點		盧森堡交易所	
發行總金額		美金 103,650,000 元	美金 12,092,500 元
單位發行價格		每單位美金 6.91 元	
發行單位總數		第一次發行 15,000,000 單位	追加發行 1,750,000 單位
表彰有價證券之來源		由出售股東以其持有不超過 33,500,000 股之力成科技普通股作為參與海外存託憑證所表彰之原有價證券	
表彰有價證券之數額		30,000,000 股	3,500,000 股
存託憑證持有人的權利與義務		海外存託憑證持有人的權利義務，如表決權、股利分配、新股優先認購權及其他權益等，依中華民國相關法令及存託契約有關規定辦理	
受託人		無	
存託機構		摩根大通銀行	
保管機構		摩根大通銀行台北分行	
未兌回餘額		104,041 DR units	
發行及存續期間相關費用之分攤方式		<p>發行：包括但不限於承銷費用、法律費用、上市掛牌費用、會計師費用、財務顧問費用及其他任何相關費用等，除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及出售股東及存託機構另有規定外，均由出售股東負擔。</p> <p>存續期間：除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及出售股東及存託機構另有規定外，包括各年度上市費用、資訊揭露及其他支出皆由本公司負擔。</p>	
存託契約及保管契約之重要約定事項		<p>存託契約：</p> <p>(1)轉讓/交割(2)資訊提供(3)存託憑證之原始發行、兌回與再發行(4)股利、其他分配與認股權 (5)登記基準日(6)表決權(7)轉讓(8)原有價證券之變更(9)稅捐(10)修改與終止</p> <p>保管契約：</p> <p>(1)交付原有價證券以發行海外存託憑證(2)通知存託機構發行存託憑證(3)海外存託憑證兌回時原有價證券之交付(4)每月結算之股數確認(5)登記基準日之股數確認</p>	
每單位市價	106年	最高	US \$ 6.926
		最低	US \$ 5.250
		平均	US \$ 6.018
	107年度截至4月30日	最高	US \$ 6.650
		最低	US \$ 5.750
		平均	US \$ 6.236

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

無此情形。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司截至 107 年 3 月 31 日止，尚無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容:

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (4) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (5) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (6) F119010 電子材料批發業。
- (7) F219010 電子材料零售業。
- (8) H201010 一般投資業。
- (9) I301010 資訊軟體服務業。
- (10) I501010 產品設計業。
- (11) JE01010 租賃業。

2.營業比重：

本公司成立於民國 86 年 5 月，以積體電路 IC 封裝測試業務為主，106 年度合併營業比重如下：

單位：新台幣仟元

項 目	106 年度營收淨額	營業比重
封裝服務	38,748,327	64.98%
測試服務	12,409,184	20.81%
晶圓級封裝服務	3,979,172	6.67%
晶圓測試服務	4,211,170	7.06%
其他	284,230	0.48%
合 計	59,632,083	100.00%

3.目前之商品(服務)項目：

- (1)高腳數超薄小型晶粒承載積體電路(TSOP)封裝及測試服務。
- (2)四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務。
- (3)多晶片(堆疊)封裝(MCP、S-MCP)封裝及測試服務。
- (4)球型陣列承載積體電路(wBGA、FBGA)封裝及測試服務。
- (5)記憶卡(SD、microSD)、USB 封裝及測試服務。
- (6)固態硬碟(SSD)、內嵌式記憶體(eMMC、eMCP、UFS) 封裝及測試服務。
- (7)DRAM 晶片堆疊封裝及測試服務。
- (8)行動記憶體封裝及測試服務。
- (9)晶圓測試服務。
- (10)晶圓凸塊(Bumping)封裝服務。
- (11)CPB 晶圓測試服務。
- (12)系統級(SiP)封裝服務。

- (13)重佈線(RDL)服務。
- (14)晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務。
- (15)封裝體疊層(PoP、PiP)封裝及測試服務。
- (16)微機電系統(MEMS)封裝服務。
- (17)CIS 封裝及測試服務。
- (18)FC CSP 封裝型態。
- (19)環氧樹脂基板作為封裝載板的封裝服務。
- (20)樹脂成型穿孔導通技術開發(TMV)，以提供封裝產品堆疊需求服務。
- (21)銅柱凸塊覆晶(Cu Pillar Bump Flip Chip)封裝服務。
- (22)影像感測器(CIS)封裝服務。
- (23)EMI shield package 封裝服務。
- (24)晶圓級扇外型(Wafer level Fan-Out)封裝及測試服務。
- (25)面板級扇外型 (Panel level Fan-Out) 封裝及測試服務。
- (26)LPDDR3 KGD 測試服務。

4. 計劃開發之新商品(服務)：

- (1)開發超薄型鉅線型與覆晶封裝技術，以進一步提供更輕薄短小的封裝方案。
- (2)開發多晶片堆疊的高容量記憶體封裝，以提供高容量儲存產品應用的需求。
- (3)開發高整合性 SiP 封裝產品，達到輕薄短小且兼具高電性表現的封裝。
- (4)開發超細線路(2um)的面板型扇出封裝技術，可提供高效能、高 I/O、高頻寬互聯與高度異質晶片封裝的應用需求。
- (5)開發 Fan out on Substrate 技術，以細線路的 fan out 技術取代 2.5D 的 Si interposer，將能同時兼顧高效能與合理的成本。
- (6)開發 Antenna in Package (AiP)封裝技術，以提供 5G 通訊最佳化技術。
- (7)開發應用 low Dk, Df 材料封裝，應用於高頻封裝所需，可以提升訊號傳遞時的品質與完整性。
- (8)開發高頻寬，高密度的 3DIC TSV 封裝技術，以提供人工智慧 AI 時代的高速運算封裝需求。
- (9)開發應用矽穿孔(TSV)堆疊技術於八顆高速記憶體晶片封裝。
- (10)新型記憶體晶片的封裝製程技術及產品開發，可達成低功耗、高可靠性與耐用性之應用需求。
- (11)持續開發新型態的先進封裝技術，以提供高效能的系統晶片(SoC)與多晶片整合系統封裝(SiP)的應用需求。
- (12) B6700D Burn-In Oven BI 測試服務與軟/硬體開發。
- (13) T5503HS 4.5 Gbps 軟/硬體開發。
- (14) T5383 晶圓測試服務。
- (15) SSD PCIe Gen 4 / UFS 3.0 系統級測試服務。
- (16) Automotive IC 測試服務。
- (17) Thin package 測試開發。
- (18)測試 Socket (Mold-Type)開發。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

根據國際貨幣基金(IMF)2018年1月公佈世界經濟展望報告，2017年全球GDP成長率為3.7%，與2016年比較持續擴張。另外對於2018年全球經濟成長率預測則為成長3.9%，惟須注意先進國家貨幣政策緊縮、貿易保護主義增溫與金融市場波動等風險。IMF預測美國今年成長率由2.3%調升至2.7%，歐元區今年成長率由1.9%上修為2.2%，日本今年成長率由0.7%上修為1.2%，中國成長率由6.5%上修為6.6%。

在全球總體經濟平穩成長走勢下，國際市調機構Gartner對於全球半導體市場的成長趨勢分析，2017年10月Gartner上修2017年全球半導體市場規模，從原先預估2017年將成長16.9%，上修至成長19.7%，到最終結果成長22.2%，2017年全球半導體市場規模來到4,197億美元。對於未來全球半導體市場的成長態勢，Gartner預估2018年將有7.5%的年成長動能，接下來三年的成長漸趨緩和，預測在2019年的年成長率為-1.6%；2020年為1.1%；2021年為6.4%，而2021年全球半導體市場屆時將達到4,777億美元規模。

台灣自從積體電路晶圓代工起，便逐步發展成目前上下游垂直分工之產業結構。上游至下依序為IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試。其中IC製造主要以晶圓代工與DRAM製造為主。垂直分工與產業群聚使得台灣以製造為主，並使得台灣IC產業擁有彈性、速度、低成本之競爭優勢。2017年台灣晶圓代工與封測產值市佔率預估皆為全球排名第一名，而2017年台灣IC設計產值市佔率全球排名則預估為第二，僅次於美國。

工研院IEK統計2017年第四季(17Q4)台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新台幣6,755億元(USD\$22.2B)，較上季(17Q3)成長5.1%，較去年同期(16Q4)成長4.9%。其中IC設計業產值為新台幣1,608億元(USD\$5.3B)，較上季(17Q3)衰退3.1%，較去年同期(16Q4)成長0.6%；IC製造業為新台幣3,890億元(USD\$12.8B)，較上季(17Q3)成長10.4%，較去年同期(16Q4)成長7.9%，其中晶圓代工為新台幣3,430億元(USD\$11.3B)，較上季(17Q3)成長10.5%，較去年同期(16Q4)成長9.3%，記憶體與其他製造為新台幣460億元(USD\$1.5B)，較上季(17Q3)成長9.5%，較去年同期(16Q4)衰退1.7%；IC封裝業為新台幣870億元(USD\$2.9B)，較上季(17Q3)成長0.6%，較去年同期(16Q4)成長1.4%；IC測試業為新台幣387億元(USD\$1.3B)，較上季(17Q3)成長1.8%，較去年同期(16Q4)成長1.8%。新台幣對美元匯率以30.4計算。

單位：新台幣億元

	17Q1	季 成長	年 成長	17Q2	季 成長	年 成長	17Q3	季 成長	年 成長	17Q4	季 成長	年 成長	2017 年	年 成長
IC 產業產值	5,714	-11.3%	5.0%	5,726	0.2%	-4.8%	6,428	12.3%	-2.5%	6,755	5.1%	4.9%	24,623	0.5%
IC 設計業	1,398	-12.5%	-3.7%	1,506	7.7%	-11.3%	1,659	10.2%	-7.0%	1,608	-3.1%	0.6%	6,171	-5.5%
IC 製造業	3,208	-11.0%	8.6%	3,060	-4.6%	-3.7%	3,524	15.2%	-1.8%	3,890	10.4%	7.9%	13,682	2.7%
晶圓代工	2,849	-9.2%	14.4%	2,678	-6.0%	-2.1%	3,104	15.9%	-0.6%	3,430	10.5%	9.3%	12,061	5.0%
記憶體製造	359	-23.3%	-22.5%	382	6.4%	-13.4%	420	9.9%	-9.7%	460	9.5%	-1.7%	1,621	-11.8%
IC 封裝業	770	-10.3%	5.5%	825	7.1%	3.1%	865	4.8%	1.8%	870	0.6%	1.4%	3,330	2.8%
IC 測試業	338	-11.1%	10.8%	335	-0.9%	-1.5%	380	13.4%	1.3%	387	1.8%	1.8%	1,440	2.9%
IC 產品產值	1,757	-15.0%	-8.3%	1,888	7.5%	-11.7%	2,079	10.1%	-7.6%	2,068	-0.5%	0.1%	7,792	-6.9%
全球半導體成長率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6%

資料來源：TSIA；工研院 IEK (2018/02)

工研院 IEK 統計 2017 年台灣 IC 產業產值達新台幣 24,623 億元 (USD\$81.0B)，較 2016 年成長 0.5%。其中 IC 設計業產值為新台幣 6,171 億元 (USD\$20.3B)，較 2016 年衰退 5.5%；IC 製造業為新台幣 13,682 億元 (USD\$45.0B)，較 2016 年成長 2.7%，其中晶圓代工為新台幣 12,061 億元 (USD\$39.7)，較 2016 年成長 5.0%，記憶體與其他製造為新台幣 1,621 億元 (USD\$5.3B)，較 2016 年衰退 11.8%；IC 封裝業為新台幣 3,330 元 (USD\$11.0B)，較 2016 年成長 2.8%；IC 測試業為新台幣 1,440 億元 (USD\$4.7B)，較 2016 年成長 2.9%。新台幣對美元匯率以 30.4 計算。

2014 年~2018 年台灣 IC 產業產值

單位：新台幣億元

	2014 年	2014 年 成長率	2015 年	2015 年 成長率	2016 年	2016 年 成長率	2017 年	2017 年 成長率	2018 年 (e)	2018 年 成長率(e)
IC 產業產值	22,033	16.7%	22,640	2.8%	24,493	8.2%	24,623	0.5%	26,050	5.8%
IC 設計業	5,763	19.8%	5,927	2.8%	6,531	10.2%	6,171	-5.5%	6,578	6.6%
IC 製造業	11,731	17.7%	12,300	4.9%	13,324	8.3%	13,682	2.7%	14,492	5.9%
晶圓代工	9,140	20.4%	10,093	20.4%	11,487	13.8%	12,061	5.0%	12,672	5.1%
記憶體與其他製造	2,591	9.2%	2,207	-14.8%	1,837	-16.8%	1,621	-11.8%	1,820	12.3%
IC 封裝業	3,160	11.1%	3,099	-1.9%	3,238	4.5%	3,330	2.8%	3,480	4.5%
IC 測試業	1,379	8.9%	1,314	-4.7%	1,400	6.5%	1,440	2.9%	1,500	4.2%
IC 產品產值	8,354	16.3%	8,134	-2.6%	8,368	2.9%	7,792	-6.9%	8,398	7.8%
全球半導體成長率	-	9.9%	-	-0.2%	-	1.1%	-	21.6%	-	6.1%

資料來源：TSIA；工研院 IEK (2018/02)

註:(e)表示預估值(estimate)

2. 產業上、中、下游之關聯性

我國 IC 產業依製造流程區分，可依次分為上游的 IC 設計(IC Design)、中游的 IC 晶圓製造(IC Manufacturing and Foundry) 及下游的 IC 封裝及測試 (IC Assembly & Testing)。

(1)上游：

IC 設計公司為積體電路產品設計公司，屬於知識密集產業，該行業進入障礙高投資報酬率亦高，吸引國內不少廠商投入，其主要業務為自行設計產品銷售，或接受客戶委託設計。

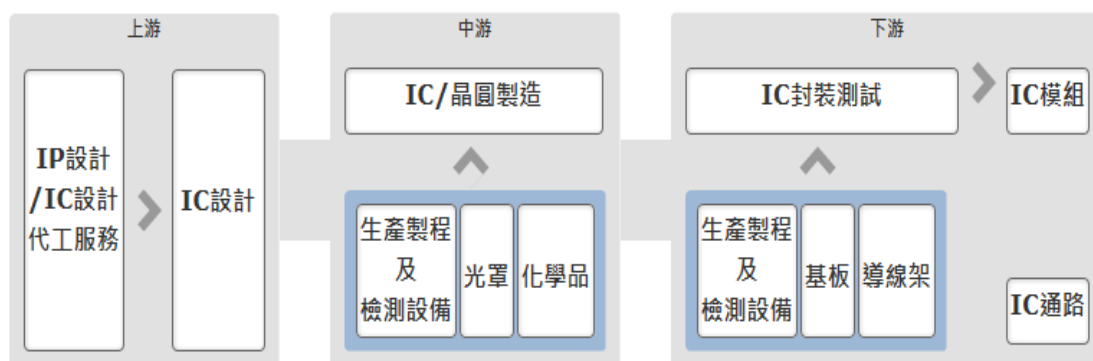
(2)中游：

為 IC 製造業與化學品工業，其主要業務是將自行設計的 IC 電路或客戶委託加工的 IC 設計，以精密的設備從事 IC 晶圓生產，屬資本密集且技術密集的行業，進入障礙高。

(3)下游：

封裝測試業是將製造完成之 IC 晶圓進一步切割後予以封裝及測試，以便能應用在最終產品。

所屬半導體產業上、中、下游之關聯性，如下圖所示：



近年來市場對 IC 的質和量要求越來越高，IC 除了要功能強大和面積小外，同時也要求多功能整合，使得 IC 製造和封測的界線越來越模糊，除了晶圓代工廠的產品服務開始延伸 IC 封測領域，大多數的晶圓廠則是與合作緊密的封測廠共同開發，或封測廠與系統廠共同設計開發解決方案。

3. 總體經濟與產業發展趨勢及產品競爭情形

(1) 總體經濟與產業發展趨勢

IC 封裝測試是 IC 製造的後段作業，包括封裝與測試二項作業程序，主要提供 IC 保護、散熱、電路導通等功能。封裝技術的演進可分為使用導線架的導線封裝與使用載板的無導線封裝。最初是導線封裝階段，以打線接合的方式，將晶片連接至外引腳上，而接腳的位置則位在晶片四周；然後則是載板封裝，使用上以載板取代導線架，對外電路的連通則改用錫球，而錫球(對外的接腳)則為位在晶片的下方；目前則進展至不再使用導線架或錫球，而是直接將晶片置放於母板上，藉由金屬凸塊與載板接合的覆晶封裝技術。

現今封裝技術二大發展區塊，一是單晶片系統設計 SoC(System on Chip)，是將系統電路整個設計在晶片中，包括中央運算處理單元(CPU)、暫存

記憶體(Flash memory 或 SRAM)、數位訊號處理器(DSP)、輸出入介面電路(I/O interface)...等。另一為系統封裝 SiP(System in Package)，它可將不同數位或類比功能的裸晶，以凸塊(bump)或打線(wire bond)方式連結於晶片載板上，該載板中已有部分內埋被動元件或電路設計，此具有電性功能的載板，稱為整合性基板(Integrated Substrate)或功能性基板(Functional Substrate)，系統封裝方式也視應用需求而有所差異，例如一般平面型的 MCM(Multi-chip Module)封裝法，或是節省面積將不同功能晶片堆疊起來的 3D 堆疊封裝法，這些都屬於系統封裝(SiP)技術的發展範疇。

雖說環顧系統單晶片(SoC)與系統封裝(SiP)，是目前半導體封裝發展二大方向，不過系統單晶片發展至今卻面臨技術瓶頸，如生產不良率過高、研發時間過長、成本太昂貴...等問題，因此後者強調小面積、支援高頻、高速、低成本、生產週期短...等優點的多晶片模組封裝技術，便成為目前極受重視的解決方案。由於半導體先進製程微縮技術及晶片成本逐漸遇到瓶頸，宣告摩爾定律已逐漸走到瓶頸，加以物聯網終端產品強調異質整合(如 Sensor、Logic/DRAM 與 GPU、IoT 產品等)，使得以封裝方式達到異質整合(特別是與感測器的整合是 SoC 難達到的)解決方案成為熱門議題，而此解決方案就是系統級封裝(System in package)；晶圓廠台積電以其製程布局晶圓級 SiP 封測技術(如 CoWoS、InFO 技術)，在基於輕薄省電部份已帶領手機 AP 的硬體規格上，走向扇外型封裝發展，因扇外型封裝用在手機 AP 可較原本覆晶封裝薄 20%以上，符合手機朝薄型化的發展趨勢，另外在散熱、省電、及效能方面亦較覆晶封裝有優勢，價格上較 3DIC 便宜，亦符合消費者對電子產品在價格上的需求，而這些都意味著扇外型封裝技術將成為智慧型手機 AP 發展主流。除了台積電之外，大多數的晶圓廠則是與合作緊密的封測廠共同開發，或封測廠與系統廠共同設計開發，這便造就了封測廠與晶圓廠或系統廠更緊密結合。

本公司為因應產業及技術發展態勢及上游客戶對記憶體、邏輯及先進封裝測試產能日益增加的需求，適時購置新設備以提高產能，以持續提供且盡力滿足現有客戶封裝及測試服務，並以此為基礎更積極朝向低成本高效能封裝技術前進，本著未來封測產業會走向更多元化及高技術的趨勢，認為有能力研發出自家技術及培養穩定客戶訂單來源的廠商，將會是未來最大的贏家。

(2) 競爭情形：

產業研究機構 Gartner 表示，全球無論是在 GDP、半導體亦或專業封測代工領域，其成長率谷底已出現在 2015 年，從 2016 年至 2018 年都有較為良好的成長表現，預估 2018 年全球半導體成長 7.5%，而全球半導體專業封測業亦成長 4.6%，顯示全球未來半導體專業封測代工景氣成長性佳。2014 年~2017

年 IC 封測代工市場市占率，台灣佔 5 成以上，台灣穩居 IC 封測代工龍頭寶座，中國則靠併購快速成長拉近差距，美國亦從 12% 成長至 14%，新加坡與日本則呈下滑狀況；2017 年全球 IC 封測代工產業產值加總約 281 億美元，市佔排名區域別：台灣(56%)，中國(20%)，美國(14%)，日本(4%)，新加坡(4%)，韓國(2%)，歐洲(0%)。以封測廠狀況而言，根據拓璞產業研究所報告 2017 年全球前 10 大專業封測代工廠商營收排名，前 3 名依次為日月光、艾克爾、長電科技。但在營收成長上，台灣僅力成成長幅度較大，其他入榜的日月光、頡邦僅個位數成長，京元電、矽品、南茂甚至來到負成長。

近三年全球半導體封測整併不斷，自 2015 年中國大陸三大本土封測廠江蘇長電、華天科技及通富微電各自併購國際封測廠或 IDM 後段封測廠開始，中國大陸三大本土封測廠全球市佔提升至十名內，另外，全球封測亦進入整併階段，過去除全球前十大封測廠彼此整併，2017 年 Amkor 亦併購葡萄牙專作晶圓級扇外型封裝的公司 Nanium，擴展 Amkor 之扇外型封測的技術能量，而力成亦與美光達成協議，收購美光日本秋田廠及美光手中 Tera Probe 39.6% 股權，充實力成在日本封測能量。而台灣測試廠矽格亦收購新加坡 Bloomeria，間接入股台星科 51.88% 股權，正式由測試業務轉型至封測之統包服務。

台灣 IC 封測廠商之年成長率狀況，依照主要營收產品別為邏輯、記憶體、驅動 IC、類比 IC、感測器、測試等來做各封測廠商分類，在 2016 年 Q2 起因全球總經好轉帶動手機、PC 等電子終端消費性產品止跌回升，故 2016Q2 年成長達 4%，隨後至 Q4 都有雙位數的成長表現，而 2017 年第一季仍有 5.5% 成長表現，至第二季起便成長逐季降低，除反應 2016 年下半年基期較高外，亦代表封測產業景氣成長放緩。在邏輯 IC 部份可以看到日月光與矽品在 2015Q2 起即步入營收年增率衰退狀態，至 2016Q2 亦都轉為正成長，並在 2016Q3 或 Q4 達成長高峰，2017 年起便成長逐漸消失，甚至衰退，代表邏輯 IC 封測存在成長瓶頸，而記憶體部份則是力成自 2015Q4 的年成長最為驚人 (23.7%)，且到 2017Q4 都呈現雙位數成長狀態，其次為華泰亦有兩位數的成長，反應記憶體報價上漲所帶動記憶體封測成長。

本公司自 2012 年 PC 業萎縮導致標準型 DRAM 需求大幅下滑後，公司便積極分散記憶體封測比重，於同年收購超豐公司股權，並取得經營權，因此，2012 年之合併營收仍得以成長，公司亦開始跨入邏輯封測領域。2013 年由於記憶體 DRAM 供應成長疲弱，PC 需求萎縮及高階智慧型手機市場出現飽和徵等因素，加上原主要客戶日商爾必達公司於同年 7 月被美光科技收購，上游客戶趨於寡佔，使得同業之價格競爭亦趨於激烈，導致 2013 合併營收衰退。2014 年因全球總體經濟持續穩健成長條件，雖然一般型 DRAM 需求下滑，但行動

DRAM 和消費型 DRAM 需求仍強勁；SSD 則帶動高密度 flash 的強勁需求，所以 2014 年合併營收仍有成長。2015 與 2016 年則是以行動 DRAM、消費型 DRAM、顯示卡用記憶體、SSD、高密度 MCP/MMC Flash 強勁需求、以及力成西安廠營收的助益之下，雖然全球半導體整體營收持續衰退，但力成仍然出現了 6.2% 與 13.7% 的成長率。2017 年除了記憶體報價上漲所帶動記憶體封測成長外，在 Tera Probe、Tera power 與日本秋田廠營收助益，與布局邏輯晶片封測開花結果，成長率來到了 23.4%，未來將以秋田廠為日本的生產基地，同時配合 Tera Probe，將在日本擁有完整封測供應鏈。

2017 年全球前十大封測廠中台灣廠商排名及 2012 年~2017 年成長態勢

單位：新台幣百萬元

公司名稱	2017年 營收	17/16 成長率	2016年 營收	16/15 成長率	2015年 營收	15/14 成長率	2014年 營收	14/13 成長率	2013年 營收	13/12 成長率	2012年 營收
日月光	290,441	5.7%	274,884	-3.0%	283,302	10.0%	256,591	16.7%	219,862	13.3%	193,972
矽品	83,554	-1.8%	85,112	2.7%	82,840	-0.3%	83,071	19.8%	69,356	7.3%	64,654
力成	59,632	23.4%	48,344	13.7%	42,524	6.2%	40,039	6.5%	37,605	-10.9%	41,611
南茂	17,941	-7.5%	19,392	-2.4%	19,869	-9.7%	22,005	13.7%	19,362	0.7%	19,221
頌邦	18,428	6.8%	17,256	2.3%	16,863	-4.6%	17,683	11.8%	15,811	5.3%	15,013

資料來源：公開資訊觀測站/各公司財報，力成公司整理

對於半導體後段廠而言，策略性夥伴在技術上或製造成本擁有絕對優勢的領導地位，將形成供應鏈的聯盟關係與長期訂單的確保，在 DRAM 與 Flash 的寡佔市場的型態下，亦有機會取得長期的合理利潤。本公司力求與客戶建立良好聯盟關係，並專注於市場區隔，目前主要客戶群皆為從事記憶體製造之國際知名半導體公司。但又鑑於近年來記憶體市場充斥著過度投資導致產能過剩價格起伏劇烈之疑慮，本公司亦於 2008 年起擴展營運範圍，投入整合型先進封裝服務 (SiP, MCP, 3D IC, Bumping, Flip Chip, MEMS, Fan out, TSV CMOS...)，提供一個短小輕薄的解決方案，在以既有的記憶體封測之優勢，整合如邏輯、無線、有線、微處理器等等功能於一封裝產品內；並將重點放在 UPH 與提升生產效率、降低營業費用。

(三) 技術及研發概況

1. 研發費用

本公司最近年度研發費用支出情形詳如下表：

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年度
研發費用		1,723,215

2.開發成功之技術或產品：

(1) 封裝產品方面的成果：

① 面板級扇外型封裝技術開發：

- A.開發完成細線寬 5um/5um 技術，應用於扇外型(Fan-out)封裝產品，可提供高密度、高效能、低耗電及系統整合封裝的產品應用。
- B.開發完成CHIEFS®封裝，以 chip first 技術進行，適用於APU、BB、ASIC、PMIC、Memory等各類元件封裝。
- C.開發完成CLIP®封裝，以 chip last 技術，適用於CPU、GPU、FPGA、thermal sensitive等元件封裝。
- D.開發完成 PiFO® 封裝，以 chip middle 技術，tall Cu pillar連結封裝兩側的RDL線路，適用於RF module、Sensor、APU、晶片堆疊，封裝體堆疊或Fan-out SiP的應用。
- E.開發完成BF2O® 封裝技術，提供深具成本競爭力的扇外型封裝產品應用，適用於PMIC、Audio、PA等元件封裝。

② 成功開發矽穿孔(TSV)封裝技術之生物晶片(Bio-chip)並導入量產；此晶片可提供快速基因檢測功能。

③ 開發高散熱能力的BGA封裝，可提供高功率產品的散熱解決技術。

④ 開發TMV (Through Mold Via)封裝，可提供封裝體堆疊應用。

⑤ 成功開發出使用 80um 厚度基板之超薄型mobile DRAM封裝，順利導入量產，可有效達成封裝輕薄之需求，並應用於超薄型行動裝置，且進一步開發成功70um的基板應用於超薄封裝。

⑥ 成功開發量產超細球距0.27mm BGA封裝，提供高球數封裝技術的解決方案。

(2) 測試產品方面的成果：

- ① T5832 2.8Gbps測試服務與軟/硬體開發。
- ② Magnum V 1.6Gbps測試服務與硬體開發。
- ③ B6700 Burn-In Oven BI 測試服務與軟/硬體開發。
- ④ T5503HS 4.5Gbps測試服務。
- ⑤ One Package SSD 測試服務。
- ⑥ IoT測試服務。
- ⑦ FO-PLP測試開發。
- ⑧ 測試 Socket (CNC-Type)開發。

(四)長、短期業務發展計劃

茲就本公司有關經營、生產、行銷、研發等策略領域之短期及長期發展計劃之內容說明如下：

1.短期發展計劃

(1)積極擴充產能並開發新製程及技術

為因應半導體景氣持續成長及客戶需求之增加，擬積極擴充產能。另外，配合產品發展趨勢，將加強開發新製程及技術之能力，如 WLP、FC、SiP/Modules、2.5D/3D IC 以及 Fan Out 等先進技術開發，以提昇公司競爭優勢。

(2)持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務

本公司之生產利基為彈性之製程，機動性高，未來將持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務。

(3)持續提供整合性服務(Turn-Key Service)

由於上游晶圓廠基於成本考量，多將 IC 之封裝及測試業務外移至專業封裝及測試廠，本公司為國內少數能同時提供封裝及測試之專業廠，為提供客戶較多的選擇、較佳的服務，以增加公司競爭力，未來將持續提供整合性服務予客戶。

(4)擴展國內外市場，擴大市場佔有率

藉因本公司之彈性製程機動性高及可提供整合性服務之優勢，除與現有國內外客戶維持良好關係之外，將積極爭取國內外新客戶，擴大市場佔有率。

2.長期發展計劃

(1)注重客戶與供應商長期合作發展關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝測試加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

(2)提高自動化設備之投資，加速生產線自動化，提高產品良率，增進生產效率，降低人力之依賴。

(3)持續開發新型封裝測試技術與新客戶

半導體技術日益精進，已從微米時代進入奈米時代，基於 IC 體積愈漸縮小且多樣化，使得高階 IC 封裝測試之技術需求日漸殷切，本公司 95 年初成立研發技術中心，全力投入封裝技術之研發，藉以滿足新舊客戶之需求及持續強化公司之競爭力。

(4)增加邏輯、模組(SSD)、微機電產品營收

藉由增加邏輯、模組(SSD)、微機電產品之客戶及營收，以擴大公司規模及分散風險。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為提供 IC 封裝及測試服務，銷售地區包含國內外市場，106 年度內銷比重約 20.41%；外銷比重為 79.59%，以日本、新加坡及美洲地區為主。

單位：新台幣仟元

銷售地 \ 年度	105 年度	%	106 年度	%
內銷	10,534,354	21.79	12,170,505	20.41
外銷	37,809,188	78.21	47,461,578	79.59
日本	17,451,060		20,422,543	
新加坡	7,668,692		12,857,749	
美洲	6,939,707		10,618,829	
歐洲	4,043,557		1,842,106	
中國大陸及香港	1,542,807		1,404,213	
其他	163,365		316,138	
合計	48,343,542	100	59,632,083	100

2.市場占有率

根據研究機構 Gartner 研究資料顯示，本公司為全球第五大封測廠，若以台灣廠商而言，則位居台灣封測廠商營收排名的第三名；而目前國內約各有 30 家以上的封裝及測試業者(其中 20 家同時提供封裝與測試服務)。根據台灣半導體產業協會(TSIA)於 2018 年 2 月發佈 2017 年台灣 IC 產業營運成果中指出，2017 年台灣封裝產值約為新台幣 3,330 億元，測試業產值則為新台幣 1,440 億元，而本公司 2017 年封裝營業額約為新台幣 429 億元，占台灣封裝業產值 12.8%，測試業產值約為新台幣 167 億元，約占台灣測試業產值 11.6%，尤其本公司在記憶體 IC 之封裝測試方面居於領導地位。2016 年，與美光共同簽定半導體封裝投資合約於大陸西安設立的子公司，開始生產，擴大了力成科技在記憶體封測市場的佔有率。2017 年力成亦與美光達成協議，收購美光日本秋田廠及美光手中 Tera Probe 39.6% 股權，充實力成在日本封測能量。

3.市場未來之供需狀況與成長性

根據 Gartner 2018 年 3 月預測，2018 年全球半導體市場銷售將較 2017 年成長 7.5%。另外，Gartner 預估 2019 年將衰退 1.6%，2020 年成長 1.1%，2021 年成長 6.4%。

全球半導體市場預測

億美元	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
全球半導體市場	2,998	3,154	3,424	3,349	3,435	4,197	4,510	4,440	4,489	4,777
成長率	-2.6%	5.2%	8.6%	-2.2%	2.6%	22.2%	7.5%	-1.6%	1.1%	6.4%

資料來源：Gartner；工研院(2018/03)

本公司營收主要來自於記憶體 IC 之封裝測試，陸續將提高邏輯 IC、感測元件等其它封裝測試營收。記憶體市場有兩大主流，分別為 DRAM 及 Flash 記憶體產品。而半導體產品項目，大致可區分為 ASIC (特殊應用積體電路)、ASSP (特殊應用標準元件)、Analog、分離式元件、GP Logic、記憶體、微元件、感測器以及光電元件。在 2017 年其中又以記憶體 (31.4%)、ASSP(24.2%)與微元件(15.8%)為最大宗產品項目，(1)記憶體方面，2017 年在供不應求和寡頭壟斷格局明顯之下，銷售值成長率超過 60%，預計 2018 年銷售年成長率仍可維持在雙位數字成長；(2) ASSP，2017 年約成長 11%，2018 年預估成長 4.8%；(3) 2021 年半導體產品還是以記憶體、ASSP 以及微元件為大宗，而記憶體、光電元件與感測器為成長驅動力，2016~2021 CAGR 分別為 10%、8.7%與 7.3%。

2017~2021 年半導體產品銷售主要類別成長預估

單位：億美元

	2017			2018			2021		
	規模	比重	成長率	規模	比重	成長率	規模	比重	2016~2021 CAGR
ASIC	256	6.1%	10.3%	275	6.1%	8.5%	306	6.4%	6.0%
ASSP	1,016	24.2%	11.0%	1,064	23.6%	4.8%	1,275	26.7%	6.8%
Analog	231	5.5%	11.9%	239	5.3%	3.5%	268	5.6%	5.4%
Discrete	201	4.8%	9.7%	207	4.6%	3.6%	239	5.0%	5.5%
GP Logic	122	2.9%	4.5%	126	2.8%	3.6%	148	3.1%	4.6%
Memory	1,318	31.4%	64.3%	1,497	33.2%	13.7%	1,290	27.0%	10.0%
Micro	663	15.8%	6.2%	672	14.9%	1.3%	717	15.0%	2.8%
NOS	105	2.5%	9.9%	113	2.5%	2.5%	396	8.3%	8.7%
Opto	290	6.9%	10.3%	316	7.0%	9.3%	139	2.9%	7.3%
Total	4,197	100.0%	22.2%	4,510	100.0%	7.5%	4,777	100.0%	6.8%

資料來源: Gartner；力成科技整理

展望 2018 年半導體產業，全球經濟持續回溫，然而半導體產業已邁向成熟，PC 出貨大衰退，手機成長趨緩，電視機也僅個位數成長，傳統 3C 對半導體需求力道不如從前，記憶體供需不確定性因素增加(如大廠及中國大幅投產)等影響之下，未來幾年成長率僅個位數。但在物聯網與人工智慧效應持續發酵，在結合多方技術加速產業前進之下，未來的人機介面/聲控/語音助理，電動車/車聯網/自駕車的交通工具轉型，人工智慧將從雲端運算落下至邊緣運算，帶動半導體業研發各種 AI 運算專用晶片，5G/智慧家庭/機器人/穿戴裝置的互聯與邊緣運算興起，終端應用產品銷售逐漸擴增，將成未來發展的新動能。

展望 2018 全年 IC 封測業，全球封測產業景氣亦延續 2017 年成長趨勢，在手機及物聯網穿戴裝置等終端應用產品銷售逐漸回溫下，應用在高階晶片的覆晶封裝和晶圓凸塊的產能利用率仍高；而扇外型封裝持續受到市場觀注，特別是在扇外型封裝之同/異質晶片或與被動元件整合製程技術開發方面，更是被視為明日之星般的技術，未來終端產品高效能低耗電需求將持續帶動扇外型封裝成長。2018 年封測產業維持持續成長趨勢，智慧型手機和物聯網相關應用仍是 2018 年推升 IC 封測業主要成長動能，5G 應用晶片及物聯網以及人工智慧趨勢下更多元的感測元件需求、更高畫素 CMOS 影像感測器、蘋果及非蘋陣營健康照護裝置等 SiP 封測需求和對物聯網新產品的期待將逐季發酵。2018 年同樣是受惠於人工智慧、物聯網、智慧汽車、高速運算等應用擴張，DRAM 成為不可或缺的零組件，使需求仍強勁，而 NAND Flash 則因下游智慧型手機、PC 與伺服器客戶需求顯著，也持續帶動價格與產出上揚，價量齊揚。預估 2018 全年台灣封裝及測試業產值分別達新台幣 3,480 億元和 1,500 億元，較 2017 年成長 4.5% 和 4.2%。本公司除了在深耕已久的記憶體的封裝測試業務上達成穩健中求成長的目標，亦在邏輯 IC 及先進封

裝市場上做好產能、技術、客戶服務佈局，並善用策略性結盟模式及永不止於現狀的積極改善態度，朝向發展更先進技術，期許成為全方位的世界級封裝測試領導廠商。

4. 競爭利基

本公司自成立以來，以優良的品質，用心的服務，及創新的技術服務客戶，與客戶維持良好與密切之合作關係，已成為國內主要封裝測試廠。本公司具備之競爭利基如下：

(1) 堅強的策略聯盟/走向全球化：

IC 封裝業及測試業與上游晶圓製造廠之互動程度高，因此，封裝及測試之獲利因素在於穩定之客戶來源，而 IC 製造廠鑑於其產品技術、產品品質、生產程序之保密性，亦會選擇與 IC 封裝及測試業之長期合作，因而形成策略聯盟，並與之有長期穩定之合作關係，有利於未來公司之長期發展。

(2) 一元化服務(Turn-key Service)：

在 IC 價格快速下滑壓力下，本公司同時提供 IC 封裝及 IC 測試之一元化服務，以降低產品來回運送之成本與風險，以符合客戶需求，提高公司競爭利基。

(3) 優秀的研發與製程能力：

本公司成立以來，即致力於新技術研發，且對技術研究及製程改良不遺餘力，至今已取得國內外多項專利，此外，並取得多家國際大廠的技術授權，這些皆是本公司優於同業之顯著能力，因此奠定力成之競爭利基。

(4) 自動化及高精密度機台引進：

本公司因應積體電路 IC 產品朝高功能、高腳數及高積度發展，及為提昇為客戶服務品質，引進美、日知名設備大廠自動化及高精密度設備，以符合客戶需求。

(5) 網路自動化客戶服務系統：

本公司利用網際網路系統資訊傳遞，客戶可以隨時掌握產品問題及目前進度，瞭解產品狀況，有助於產品之改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

【產業環境】

① 台灣半導體產業的競爭優勢

台灣半導體產業擁有完整的半導體產業結構，從上游的 IC 設計、晶圓製造至下游的封裝測試，垂直整合的產業鏈符合產業趨勢需求，造就台灣半導體產業在國際市場之競爭地位。IC 工業的榮景隨著全球電子、資訊、通信及光電工業蓬勃發展，將使 IC 封裝、測試業持續穩定成長。

②IDM 大廠委外趨勢有利於封測市場

因先進製程需高額資本支出，使得全球 IDM 廠陸續擴大晶圓代工與封測委外業務於生產成本較低的亞洲地區，因此，具有 IC 產業完整與動態垂直分工體系的台灣，成為國際 IDM 與 IC 設計公司委外代工的首選，台灣封測廠亦獲益於 IDM 委外訂單。

【公司利基】

①穩健的策略聯盟及經營團隊—

本公司之股東組成包含國際知名之金士頓集團(Kingston Group)、台灣東芝先進半導體等，此有助於公司知名度之建立及訂單來源之穩定；隨著公司營業額穩定成長，及上述公司大力支持下，將來營運發展所需之資金亦不匱乏。另外，本公司之經營團隊皆具備半導體領域之完整資歷，並能洞悉市場趨勢，做出與時俱進的決策；即使在 2008 年金融風暴的重創下，仍能帶領公司力抗不景氣，穩健成長。

②持續的研發及創新—

因應市場的快速變遷，本公司致力於技術深耕，除了研發新產品外，更透過技術合作引進新穎技術。研發團隊具備開發測試軟、硬體程式之設計能力及先進封裝技術；目前除了在 IC 測試方面持續開發測試程式、改良測試機台外，亦因應未來 IC 主流市場之需求，發展最先進的技術及服務，從記憶體的封裝測試，跨入邏輯市場，並由記憶體 IC 封測之優勢連結邏輯 IC，邁入 3D IC 之領域。封裝技術方面，已完成堆疊式 IC 技術的開發、具有調整路徑之導線架技術開發等並取得多項專利，並持續致力於材料、製程的改良。

③一元化的服務及彈性的產能—

本公司提供客戶 IC 產品封裝、測試、包裝等週邊服務，使客戶一次下單，可獲得整體性服務，並能縮短運送時間與節省運輸成本。此外，因應市場及客戶需求，迅速的進行產能擴充與調整，適時投資最先進設備，滿足客戶對產能的需求，提供客戶最具競爭力之解決方案。

(2)不利因素及因應措施：

①IC 產業隨景氣波動

因應對策：

A.產品多角化佈局

本公司除了持續強化在記憶體 IC 封裝測試技術及品質之外，入主超豐公司，亦對於公司於邏輯業務之拓展有極大的助益，另外，銅柱凸塊(copper pillar bump)、金屬線路鐳墊重分配製程(Re-distribution；RDL)、晶圓級封裝(Wafer Level CSP)、微機電(MEMS)、固態硬碟(SSD)等新製程技術已陸續通過驗證。公司藉由多角化的產品降低景氣循環的風險，提供客戶更多元化之封測服務。

B.強化與客戶的合作模式

與現有客戶建立長期夥伴關係，如成立力成半導體(西安)有限公司；並積極開發新客戶，使產能得到充分而穩定的利用。

C.擴大市場服務範圍

未來將以子公司力成科技秋田株式會社為日本的生產基地，同時配合另一子公司 Tera Probe Inc.，将在日本擁有完整供應鏈。

②原物料上漲，侵蝕毛利

因應對策：

A.降低生產之成本

改變產品結構、改善良率、提出可替代材料之解決方案，並持續改良製程能力，降低成本上漲之影響。

B.強調附加價值

持續站在客戶立場，提供品質好、交期短、快速應變客戶需求的服務，致力研發新的封裝測試技術，使客戶在市場上推出具有時效性及競爭優勢之產品。

③基層勞工短缺

因應對策：

A.提高員工福利並適時給予激勵獎金以吸引優秀人才加入，凝聚員工向心力。本公司依未來之發展計劃需要，擬定員工教育訓練，使員工與企業共同成長。

B.本公司引進先進之自動化機器設備，積極投入工業 4.0 開發，減低對基層員工之需求，有效提昇員工生產力。

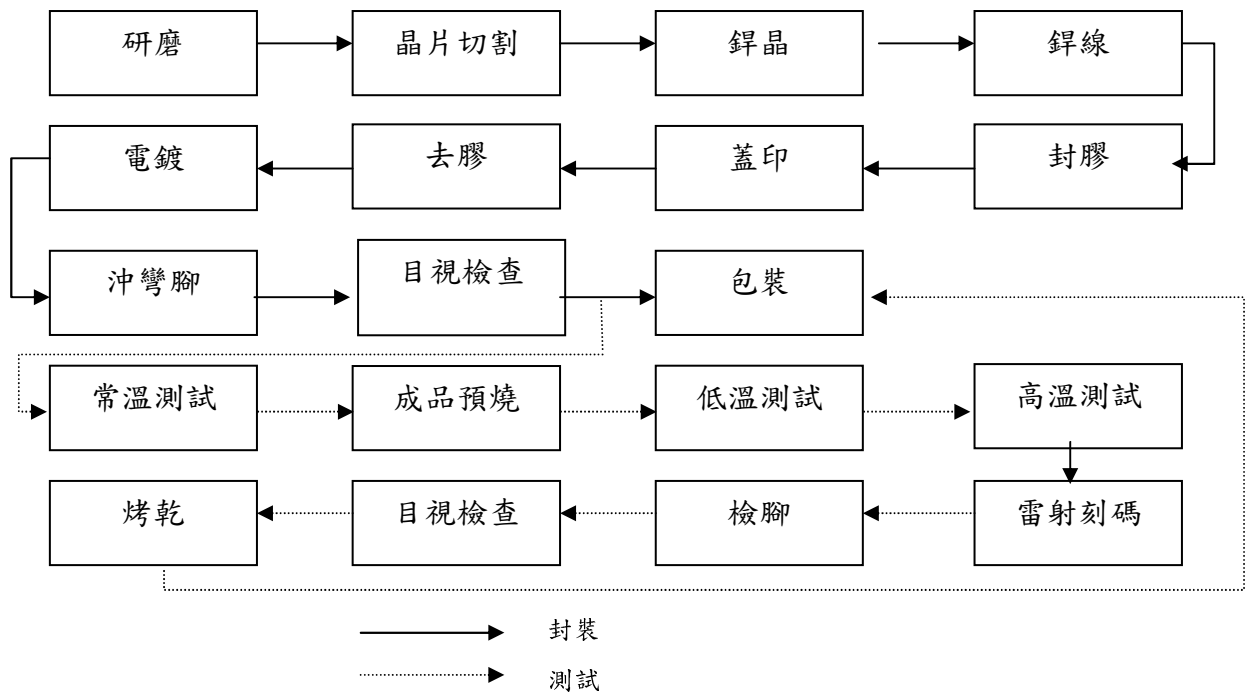
C.透過行政院勞工委員會之核准引進外勞，以解決勞工短缺之困擾。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.產品用途：

主要產品或服務項目	重要用途或功能
積體電路(IC)封裝(Assembly)	將積體電路(IC)由晶圓產品經由切割、黏合、接線、封膠、切腳、成型等製程完成單顆成品。
環境分類測試 (Final Test)	依客戶所指定之測試條件，將產品 (IC) 置於不同的環境如常溫、高溫或低溫中測試並分類，確保客戶所提供的產品符合其所要求的品質及穩定性。
成品預燒 (Burn-In)	運用預燒 (Burn-In) 製程，讓產品 (IC) 處於極端的環境中運作，加速產品的老化並予以篩選，以確保產品的可靠性。
雷射刻碼 (Laser Mark)	於產品 (IC) 封裝上刻印廠商名稱及產品類別。

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要是為客戶提供之 IC 予以加工，其中封裝作業需使用主要原料之供應狀況如下：

主要原料	主要供應商
導線架(LEAD FRAME)	Shinko Electric、NICHIDEN SEIMITU KOGYO CO., LTD.、Samsung
基板(Substrate)	欣興、南亞、SIMMTECH、EASTERN COMPANY LIMITED.、Japan Circuit Industrial、Shinko、景碩、Daisho
黏晶膠(Die attach Film)	HITACHI CHEMICAL Co.(H.K.) LTD.、台灣日東電工、琳得科先進科技、Henkel
金線(GOLD WIRE)	日茂新、Tanaka
樹脂(COMPOUND)	HITACHI CHEMICAL Co.(H.K.) LTD.、台灣日立化成、Kyocera、長華電材

(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.本公司最近二年度並無佔進貨總額百分之十以上之供應商。

2.本公司主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	105 年				106 年				107 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲	12,610,336	26.08	無	甲	17,981,516	30.15	無	甲	4,556,019	28.64	無
2	乙	11,572,017	23.94	關係人	乙	12,226,172	20.50	關係人	乙	3,375,636	21.22	關係人
3	丙	3,581,519	7.41	無	丙	6,647,619	11.15	無	丙	1,701,477	10.69	無
	其他	20,579,670	42.57		其他	22,776,776	38.20		其他	6,276,429	39.45	
	銷貨淨額	48,343,542	100		銷貨淨額	59,632,083	100		銷貨淨額	15,909,571	100	

增減變動原因：因應產業及客戶需求的增加，本公司隨之擴增新產能，及 106 年下半年併購其他公司等因素，使得銷貨金額增加。

(五)最近二年度生產量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

年度	105 年度			106 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
封裝	9,720,041	8,367,380	24,690,705	11,424,846	10,445,569	28,323,774
測試	7,369,434	5,809,508	7,927,659	8,204,195	6,701,693	8,913,694
晶圓級封裝	719	574	2,254,130	1,021	776	2,853,803
晶圓測試	562	514	540,052	2,642	2,384	3,561,420
合計	17,090,756	14,177,976	35,412,546	19,632,704	17,150,421	43,652,691

(六)最近二年度銷售量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

年度	105 年度				106 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
封裝	4,692,858	7,518,651	3,601,285	25,870,437	5,542,656	8,133,596	4,800,362	30,614,731
測試	3,237,228	1,442,704	2,507,501	9,105,952	3,892,549	1,756,951	2,764,875	10,652,233
晶圓級封裝	142	1,086,474	426	2,186,923	135	847,725	646	3,131,447
晶圓測試	417	458,491	97	243,959	910	1,395,396	1,489	2,815,774
其他	—	28,034	—	401,917	—	36,837	—	247,393
合計	7,930,645	10,534,354	6,109,309	37,809,188	9,436,250	12,170,505	7,567,372	47,461,578

三、從業員工資訊

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率一覽表

年 度		105 年度	106 年度	107 年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	行政管理人員	1,179	1,251	1,261
	研發工程人員	2,177	2,318	2,300
	作業員	6,009	6,733	6,711
	合 計	9,365	10,302	10,272
平均年歲		33.3	33.7	33.8
平均服務年資		4.35	4.66	4.83
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	0.13	0.14	0.13
	碩 士	7.20	7.28	7.28
	大 專	71.32	72.09	72.47
	高 中	20.76	19.95	19.59
	高中以下	0.60	0.54	0.53

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受之損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：

	106 年度	107 年度截至 3 月 31 日止
污染狀況	水污染防治法	無
處分單位	環保局	無
處分情形	罰款新台幣 10,000 元	無
其他損失	無	無

(二)因應對策：

1.異常原因與改善措施

本次異常原因：湖口廠廢水專責人員離職，未於規定時間內向當地環保局完成報備。

改善措施：

- (1)防治設備專責人員異動或離職前，權責單位必須於法定時間內完成專責人員異動報備申請。
- (2)確實執行專責人員代理人制度，持續提供外部訓練資源，維持證照人數優於法規要求。

2.環境維持措施

(1)環境管理計劃：

為善盡企業社會責任，本公司取得 ISO14000 環境管理系統認證，並透過污染防治設施系統妥善操作，維護永續環境，長期執行下列環境管理措施：

- A.廢氣處理：針對生產過程產生之揮發性有機化合物(VOCs)，力成科技亦嚴格控管製程使用之化學品來預防空氣污染，並透過完善的防制設備(如活性碳、洗滌塔等處理設備)，有效抑制空污發生。並每年依法規之要求定期檢測並配合環保局委託之檢測公司對空氣污染防制設排放管道之處理效率抽測，其檢測結果皆符合法規要求。
- B.製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，將製程回收水量來取代自來水使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
- C.廢水處理：力成科技各廠區遵循環保署相關規定，廢水排放皆先經過污水處理系統才排放，且透過即時監控處理設備進行廢水管制，處理設備亦定期進行流量計與偵測器校正，確保數據的準確性與處理設備的穩定度，務必將水質處理至放流或納管標準才准許排放，此外，亦接受主管機關不定期廢水水質抽檢作業，皆符合規定作業。
- D.廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物清理，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。對於製程廢棄物之處理模式為收集、分類、減量及回收，主要管理策略是以「資源回收」來取代「掩埋處置」，讓廢棄物變為資源，降低環境衝擊，並有效管理以提高資源再利用的價值。
- E.輔導協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業環保責任。
- F.節能減碳與溫室氣體：成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；遵循 ISO14064-1 標準建立溫室氣體盤查管理流程，並委託專業機構進行輔導與查證，揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢，為降低氣候暖化善盡企業責任。
- G. 自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，以有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。
- H. 環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更；使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。

(2)未來三年預計環保資本支出：

擬購置之防治污染設備或支出內容如下：

	單位：新台幣 仟元		
	107 年度	108 年度	109 年度
溫室氣體盤查輔導與查證費	350	350	350
繳交污水處理及排放費	23,681	23,681	30,785
廢水處理費用	43,942	43,942	57,125
環保監測檢驗費	675	675	966
事業廢棄物清除處理費用	17,569	17,569	22,840
擴充廢水處理設施	1,690	1,690	2,197
空氣汙染測檢驗費	117	117	152
設置空氣汙染處理設施	0	0	24,722
空氣汙染防制費用	487	487	633
支出金額合計	88,511	88,511	139,770

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練及其實施情形

力成科技重視人員的待遇與福利，依據各類獎金發放規範，提供合乎適用法律的員工福利，於每年度結算後之盈餘，扣除相關稅捐、公積及股息後，以固定比例撥予員工分紅。員工也享有福委會提供員工的多項福利項目，藉由不定期舉辦家庭日活動、藝文活動、電影欣賞、年終晚會活動等，充分連絡員工之間的情感，促進員工對組織的向心力，提升工作士氣。

1.保險方面：

除法定勞健保外，本公司員工均享有免費的團體綜合保險(包括壽險、意外險、醫療險、癌症險...等，員工不需負擔任何費用)。秉持照顧同仁及眷屬的角度，除了員工本人受惠外，亦加惠員工之配偶與子女，同樣享有免費團險。

2.健康與安全方面：

- (1)廠區內備有保健室、哺乳室及醫師駐廠，透過專業醫療人員及健康管理，進行健康促進與管理員工的健康，公司也設有新進員工體檢補助及優於法規的定期員工免費健康檢查，以追蹤員工健康狀況。
- (2)針對健康異常之高風險族群進行風險管控及復工評估，且不定期公佈健康資訊、進行職災防範宣導與安排健康講座。
- (3)對於員工因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，預防發生對象為自覺有異常工作負荷主動通報之同仁，實施健康風險評估、過勞風險評估及佛明罕心血管疾病等評估，駐廠醫師依據綜合評估結果，進行諮詢及紀錄以維護同仁健康。
- (4)力成科技於2004年通過OHSAS 18001職業安全衛生管理系統認證，為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，我們訂定「環境安全衛生政策」，以維護員工的安全和健康。



【環境安全衛生政策】

3.員工協助方面：

本公司提供員工在多變生活及不同角色的責任下，聆聽自己內心的聲音，藉由「心理諮商機制」的運作，讓員工卸下生活負擔。透過心理諮詢的過程，有效紓解生活的疲憊與療癒內在的心結，營造溫馨且健康正向的工作環境。我們設置心理諮詢室，聘請專業心理諮詢師定期在廠內協助諮詢，在充分隱私保護下與諮詢師面對面溝通，提供個人化的諮商服務，以達紓解工作壓力及促進心理健康的目的。

4.旅遊方面：

福委會不定期舉辦旅遊活動，充分連絡員工之間的情感，促進員工對組織的向心力，提升工作士氣。於 106 年度發放給每位同仁 1,500 元面額之娛樂券，並與知名旅行社簽約，讓同仁向旅行社購買旅遊行程或美食餐券，在辛勤工作之餘仍可以與家人朋友一起享受生活。

5.家庭日/大型活動/休閒活動方面：

福委會定期規劃家庭日及其他大型休閒活動，聯繫同仁間的情誼，也讓眷屬間相互認識，這是我們持續往前邁進的動能。透過這些活動，讓夥伴們盡情樂活，保持身心健康。106 年適逢力成科技 20 週年，我們也舉辦了歡慶 20 週年的系列活動，感謝所有力成的夥伴一路以來共同合作、齊心打拚，逐步累積出豐碩的成果。電影票的發放也為員工福利的一環，透由每年定期的票券免費發放，讓同仁能與朋友家人共同欣賞，達到聯誼互動之功效。106 年度更規劃了樂園一日遊活動，每位同仁皆發放樂園票券兩張供使用。

6.社團方面：

我們重視員工身心的平衡發展，打造工作與休閒並重的樂活島，藉由辦理動態與靜態的社團活動，紓解同仁們平日工作壓力，養成生活中的運動習慣，維護身體健康；促進員工親子與各家庭的感情，凝聚對力成大家庭的認同及歸屬感。配合各社團不同屬性，規劃出親子同樂之活動與競賽，讓員工及眷屬們了解力成科技對每位員工的重視與照顧。我們成立了 9 個員工社團，社員數達近 822 人，聯繫同仁間的情誼。

7.休假方面：

本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假，並定期提供統計報表供主管瞭解關懷同仁休假狀況，以協助同仁達成工作與生活之均衡。

8.生日婚喪及其他福利項目：

- (1)每月發予壽星 500 元祝賀禮券，並針對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害等，提供 1,000 至 10,000 元不等的補助金。
- (2)每年勞動節提供 1,000 元等值的現金/禮券/禮品。
- (3)每年端午節及中秋節等節慶，提供各 1,000 元等值的禮券/禮品。
- (4)每年針對年資滿 3、5、10、20 年同仁，給予禮品或禮券一份。

9.生育補助及相關服務：

針對員工本人或配偶生育，提供每胎 2,000 元的補助金，並提供勞保生育給付的相關申請服務。同時我們也關心員工與其家庭的互動，透過福委會簽訂特約員工居住區域的優良幼兒園、托兒機構，提供員工子女就讀的選擇及學前教育的照料，讓同仁無後顧之憂，兼具職場與家庭的幸福生活。

10.食宿方面：

- (1)本公司設有餐廳，提供自助餐，用餐皆有公司補助，同仁僅須支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。
- (2)為使遠道員工就近解決住的問題，公司備有員工宿舍，提供舒適之生活環境。

11.進修及訓練：

我們以「傾聽需求」來考量公司內部環境與外部環境議題，致力滿足「同仁學習的需求」、「組織成長的需求」、「公司政策的需求」，架構「需求解決導向」的運作模式與訓練體系，培養各級主管經營管理能力及發展員工職能，確保企業

的永續經營。針對同仁之需求，開辦新進人員訓練、專業技術訓練等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長啟發。

(二)退休制度與其實施情形

力成科技遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，並設立勞工退休準備金監督委員會，按月足額提撥勞工退休金，讓勞工符合退休條件時可請領退休金，保障員工的權益。依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額2%提撥員工退休準備金，專戶存入台灣銀行(原中央信託局)，並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。自94年7月1日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。106年會計帳列提撥之退休金費用總額為新台幣290,347仟元。

(三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.勞資溝通：

力成科技重視同仁聲音，提供各種溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，持續良好之勞資關係。我們自成立至今，勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，預估未來因勞資糾紛而導致損失的可能性極低。此外，透過每季召開的勞資會議及全區福委會，員工代表能針對特定議題反映同仁的建議及看法，並藉由議程中的討論，與公司達成共識，確保溝通管道暢通。我們同仁具有充分的結社自由，勞資會議乃由廠內同仁們票選出來的勞方代表與公司的資方代表進行集體協商。

2.全方位溝通管道：

我們建構全方位的溝通管道，多元、雙向、開放的反映機制，透過落實員工溝通、意見的傳達，使同仁的心聲得以有效被處理及回覆，也透過公正、保密、迅速的處理過程，解決同仁的疑惑，建構良好的勞資關係。同仁有工作上的事務或是流程改善的建議，及攸關員工食、衣、住、行、育、樂等議題，除可與直屬主管或各承辦單位直接溝通外，同仁亦可以透過溝通管道直接向公司闡述心中的問題及建議。公司將政策或預期執行事項傳達給同仁時，同仁亦可透過溝通管道回饋與參與。

此外，我們也設有性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法、員工心理諮商輔導辦法及獎懲管理辦法，我們隨時關心及傾聽同仁的各種聲音，不論具名或匿名反應，過程中皆以保密、公正之原則協助同仁，事件相關者皆不得用任何形式之報復行為不利於另一方，讓同仁可放心的在無報復的友善環境中表達自己的困擾。



(四)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
3D 廠營建工程合約	建銘營造(股)公司	105.11~106.09	3D 廠新建廠房營建工程，訂定雙方權利及義務	無
工程合約書	建銘營造(股)公司	106.09~106.12	P10 廠土建整改工程	無
銀行借款合同	中國信託商業銀行	106.08~109.08	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值
	兆豐國際商業銀行	103.02~108.02	機器設備貸款	無
		103.12~108.12		
		105.04~110.04		
		105.12~110.12		
	大眾銀行新竹分行	105.01~109.01	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值
	凱基銀行	105.12~109.12	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值
	玉山銀行	106.09~121.09	建造廠辦大樓	無
		106.09~113.09	建造廠辦大樓	
		106.05~109.05	中期信用貸款	
	華南銀行	106.03~109.03	中期信用貸款	無
		105.07~108.07		
		106.09~109.09		
		106.06~109.06		
	第一銀行	106.03~110.03	中期信用貸款	無
	台灣銀行	101.11~116.11	建造廠辦大樓	無
		105.11~110.11	機器設備貸款	
		106.09~111.09	機器設備貸款	
	合作金庫	103.09~108.09	機器設備貸款	無
		106.09~111.09	機器設備貸款	
106.04~121.04		建造廠辦大樓		
106.04~113.04		中期信用貸款		
新光銀行	105.11~108.11	中期信用貸款	無	
彰化銀行	106.01~109.02	中期信用貸款	無	
	106.03~112.03	機器設備貸款		
台新銀行	106.02~109.02	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值	
王道商業銀行	106.11~109.11	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值	
土地銀行	106.12~109.12	中期信用貸款	無	

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、會計師及其查核意見

(一)簡明資產負債表資料

1.簡明資產負債表－合併

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料					107 年度截至 3 月 31 日 財務資料
		102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
流 動 資 產		\$31,484,275	\$28,592,427	\$32,538,444	\$31,686,234	\$37,077,396	\$37,837,729
不動產、廠房及設備		35,873,672	37,660,879	35,168,436	44,173,985	58,663,021	59,631,352
無 形 資 產		1,401,549	1,330,726	1,225,706	1,125,149	1,249,649	1,220,639
其 他 資 產		3,184,527	1,869,117	2,770,106	3,222,178	2,668,362	2,585,228
資 產 總 額		71,944,023	69,453,149	71,702,692	80,207,546	99,658,428	101,274,948
流 動 負 債	分 配 前	13,823,919	10,632,016	11,291,105	16,735,143	21,788,688	22,369,837
	分 配 後	15,352,212	12,950,412	14,018,118	19,851,730	註二	—
非 流 動 負 債		21,058,828	19,279,167	18,455,533	19,151,983	28,186,311	27,364,302
負 債 總 額	分 配 前	34,882,747	29,911,183	29,746,638	35,887,126	49,974,999	49,734,139
	分 配 後	36,411,040	32,229,579	32,473,651	39,003,713	註二	—
歸屬於母公司業主之權益		29,571,452	31,517,902	33,830,784	35,814,959	38,060,810	39,452,965
股 本		7,791,466	7,791,466	7,791,466	7,791,466	7,791,466	7,791,466
資 本 公 積		2,914,524	1,423,925	1,457,194	678,047	119,593	119,593
保 留 盈 餘	分 配 前	19,542,364	22,768,770	24,419,993	27,291,846	30,555,478	31,932,488
	分 配 後	19,542,364	20,450,374	22,472,127	24,736,245	註二	—
其 他 權 益		14,599	76,662	162,131	53,600	(337,628)	(322,483)
庫 藏 股 票		(691,501)	(542,921)	0	0	(68,099)	(68,099)
非 控 制 權 益		7,489,824	8,024,064	8,125,270	8,505,461	11,622,619	12,087,844
權 益 總 額	分 配 前	37,061,276	39,541,966	41,956,054	44,320,420	49,683,429	51,540,809
	分 配 後	35,532,983	37,223,570	39,229,041	41,203,833	註二	—

註一：上列財務資料係經會計師查核簽證或核閱。

註二：106 年度之盈餘分配發放現金股利案尚待 107 年股東常會決議。

2.簡明資產負債表一個體

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註二)					107 年度截至 3 月 31 日 財務資料
		102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
流 動 資 產		\$20,174,004	\$20,199,784	\$22,583,480	\$23,773,297	\$19,289,640	註一
不動產、廠房及設備		22,781,511	27,902,222	25,282,123	31,339,124	36,344,220	
無 形 資 產		4,485	28,471	19,793	11,831	4,359	
其 他 資 產		13,537,891	9,666,197	12,261,080	11,920,199	16,532,424	
資 產 總 額		56,497,891	57,796,674	60,146,476	67,044,451	72,170,643	
流 動 負 債	分 配 前	9,372,782	7,129,326	8,215,112	12,407,510	10,800,669	
	分 配 後	10,901,075	9,447,722	10,942,125	15,524,097	註三	
非 流 動 負 債		17,553,657	19,149,446	18,100,580	18,821,982	23,309,164	
負 債 總 額	分 配 前	26,926,439	26,278,772	26,315,692	31,229,492	34,109,833	
	分 配 後	28,454,732	28,597,168	29,042,705	34,346,079	註三	
股 本		7,791,466	7,791,466	7,791,466	7,791,466	7,791,466	
資 本 公 積		2,914,524	1,423,925	1,457,194	678,047	119,593	
保 留 盈 餘	分 配 前	19,542,364	22,768,770	24,419,993	27,291,846	30,555,478	
	分 配 後	19,542,364	20,450,374	22,472,127	24,736,245	註三	
其 他 權 益		14,599	76,662	162,131	53,600	(337,628)	
庫 藏 股 票		(691,501)	(542,921)	0	0	(68,099)	
權 益 總 額	分 配 前	29,571,452	31,517,902	33,830,784	35,814,959	38,060,810	
	分 配 後	28,043,159	29,199,506	31,103,771	32,698,372	註三	

註一：國際財務報導準則無需出具季度之個體財務報告，故無資料。

註二：上列財務資料係經會計師查核簽證。

註三：106 年度之盈餘分配發放現金股利案尚待 107 年股東常會決議。

(二)簡明損益表資料

1.簡明綜合損益表－合併

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料					107 年度截至 3 月 31 日 財務資料
	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
營業收入	\$37,604,981	\$40,039,445	\$42,523,512	\$48,343,542	\$59,632,083	\$15,909,571
營業毛利	5,259,268	6,658,164	8,219,542	10,462,026	12,698,512	3,249,410
營業損益	2,887,101	4,232,071	5,643,828	7,632,373	9,074,024	2,341,624
營業外收入及支出	(5,673,198)	523,747	163,770	(369,297)	(186,746)	(218,634)
稅前淨利	(2,786,097)	4,755,818	5,807,598	7,263,076	8,887,278	2,112,990
繼續營業單位本期淨利	(3,205,160)	4,426,684	5,040,004	6,008,868	7,291,275	1,666,706
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	(3,205,160)	4,426,684	5,040,004	6,008,868	7,291,275	1,666,706
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	161,356	45,588	25,678	(138,013)	(497,749)	51,331
本期綜合損益總額	(3,043,804)	4,472,272	5,065,682	5,870,855	6,793,526	1,718,037
淨利歸屬於母公司業主	(4,005,195)	3,239,521	4,015,813	4,834,605	5,849,262	1,291,380
淨利歸屬於非控制權益	800,035	1,187,163	1,024,191	1,174,263	1,442,013	375,326
綜合損益總額歸屬於 母 公 司 業 主	(3,845,686)	3,288,469	4,055,088	4,711,188	5,428,005	1,306,525
綜合損益總額歸屬於 非 控 制 權 益	801,882	1,183,803	1,010,594	1,159,667	1,365,521	411,512
每股盈餘(元)	(5.24)	4.24	5.20	6.20	7.51	1.66

註：上列財務資料係經會計師查核簽證或核閱。

2.簡明綜合損益表－個體

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料					107 年度截至 3 月 31 日 財務資料
	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
營業收入	\$21,532,399	\$24,953,654	\$32,568,461	\$35,348,214	\$37,771,046	註一
營業毛利	2,034,913	3,798,605	6,116,415	7,609,120	8,008,406	
營業損益	596,982	2,356,631	4,340,438	5,515,633	5,509,933	
營業外收入及支出	(4,381,255)	898,096	170,482	270,378	1,341,740	
稅前淨利	(3,784,273)	3,254,727	4,510,920	5,786,011	6,851,673	
繼續營業單位本期淨利	(4,005,195)	3,239,521	4,015,813	4,834,605	5,849,262	
停業單位損失	-	-	-	-	-	
本期淨利(損)	(4,005,195)	3,239,521	4,015,813	4,834,605	5,849,262	
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	159,509	48,948	39,275	(123,417)	(421,257)	
本期綜合損益總額	(3,845,686)	3,288,469	4,055,088	4,711,188	5,428,005	
每股盈餘(元)	(5.24)	4.24	5.20	6.20	7.51	

註一：國際財務報導準則下無需出具季度之個體財務報告，故無資料。

註二：上列財務資料係經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年 度	簽證會計師姓名	意 見
102 年度	林鴻鵬、方蘇立	修正式無保留意見
103 年度	林鴻鵬、方蘇立	無保留意見
104 年度	黃裕峰、方蘇立	無保留意見
105 年度	黃裕峰、方蘇立	無保留意見
106 年度	黃裕峰、方蘇立	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)合併報告財務分析

年 度		最近五年度財務分析					107 年度截至 3 月 31 日
		102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
財務結構 (%)	負債佔資產比率	48.49	43.07	41.49	44.74	50.15	49.12
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	162.01	156.19	171.78	143.69	132.74	132.06
償債能力 (%)	流動比率	227.75	268.93	288.18	189.34	170.17	168.43
	速動比率	209.34	243.67	262.76	168.37	150.26	154.62
	利息保障倍數	-14.87	25.68	30.13	54.66	38.62	25.24
經營能力	應收款項週轉率(次)	4.86	5.23	5.05	4.72	5.04	5.34
	平均收現日數	75.10	69.78	72.26	77.33	72.42	68.41
	存貨週轉率(次)	13.35	13.25	12.90	12.42	12.61	14.75
	應付款項週轉率(次)	10.12	10.76	10.93	9.92	10.09	12.76
	平均銷貨日數	27.34	27.54	28.29	29.39	28.94	24.74
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.05	1.06	1.21	1.09	1.02	1.06
獲利能力	總資產週轉率(次)	0.52	0.58	0.59	0.60	0.60	0.63
	資產報酬率(%)	-4.24	6.49	7.38	8.06	8.34	6.18
	權益報酬率(%)	-7.99	11.56	12.37	13.93	15.51	11.70
	稅前純益占實收資本額比率(%)	-35.76	61.04	74.54	93.22	114.06	108.99
	純益率(%)	-8.52	8.09	9.44	10.00	9.81	8.12
現金流量	每股盈餘(元)(註二)	-5.24	4.24	5.20	6.20	7.51	1.66
	現金流量比率(%)	91.52	93.98	112.83	77.23	81.13	98.17
	現金流量允當比率(%)	124.08	104.87	113.72	110.78	86.70	110.46
槓桿度	現金再投資比率(%)	11.47	8.39	9.66	9.02	10.08	14.82
	營業槓桿度	6.95	4.96	4.01	3.43	3.74	6.79
	財務槓桿度	1.06	1.05	1.04	1.02	1.03	1.04

最近兩年度各項財務比率變動原因說明如下：(增減變動未達 20%者免予分析)

1. 利息保障倍數減少主要係利息支出增加。
2. 稅前純益占實收資本額比率增加主要係稅前淨利增加所致。
3. 每股盈餘增加主要係稅後淨利增加所致。
4. 現金流量允當比率減少主要係資本支出、存貨、現金股利增加所致。

註一：本公司上列財務資料係經會計師查核簽證或核閱。

(二)個體報告財務分析

分析項目		最近五年度財務分析(註一)					107 年度截至 3 月 31 日
		102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	
財務結構 (%)	負債佔資產比率	47.66	45.47	43.75	46.58	47.26	註二
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	206.86	181.59	205.41	174.34	168.86	
償債能力 (%)	流動比率	215.24	283.33	274.90	191.60	178.60	
	速動比率	201.63	258.11	250.99	173.97	155.26	
	利息保障倍數	-27.70	25.86	26.67	47.90	42.55	
經營能力	應收款項週轉率(次)	4.95	5.04	5.42	4.96	5.33	
	平均收現日數	73.66	72.40	67.31	73.59	68.43	
	存貨週轉率(次)	15.88	13.99	14.29	13.53	12.79	
	應付款項週轉率(次)	9.46	9.64	10.78	9.70	9.52	
	平均銷貨日數	22.99	26.09	25.55	26.98	28.54	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	0.95	0.89	1.29	1.13	1.04	
	總資產週轉率(次)	0.38	0.43	0.54	0.53	0.52	
獲利能力	資產報酬率(%)	-6.82	5.86	7.06	7.76	8.60	
	權益報酬率(%)	-12.16	10.61	12.29	13.88	15.84	
	稅前純益占實收資本額比率(%)	-48.57	41.77	57.90	74.26	87.94	
	純益率(%)	-18.60	12.98	12.33	13.68	15.49	
	每股盈餘(元)	-5.24	4.24	5.20	6.20	7.51	
現金流量	現金流量比率(%)	81.03	73.34	113.70	57.65	118.57	
	現金流量允當比率(%)	130.14	107.80	108.67	101.10	80.92	
	現金再投資比率(%)	8.21	4.57	8.20	4.95	9.86	
槓桿度	營運槓桿度	19.10	5.37	3.78	3.28	3.28	
	財務槓桿度	1.27	1.06	1.04	1.02	1.02	
最近兩年度各項財務比率變動原因說明如下：(增減變動未達 20%者免予分析)							
1. 每股盈餘增加主要係稅後淨利增加所致。							
2. 現金流量比率增加主要係營運資金增加所致。							
3. 現金再投資比率增加主要係營運資金增加所致。							

註一：本公司上列財務資料係經會計師查核簽證。

註二：國際財務報導準則下無需出具季度之個體財務報告，故無資料。

計算公式如下所列：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

力成科技股份有限公司一〇七年股東常會

力成科技股份有限公司

審計委員會召集人：鄭 萬 來

中 華 民 國 一 〇 七 年 五 月 四 日

四、最近年度財務報告：

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	106 年度	105 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		\$ 37,077,396	\$ 31,686,234	\$ 5,391,162	17.01
投 資		2,300,786	2,904,010	(603,224)	(20.77)
不動產、廠房及設備		58,663,021	44,173,985	14,489,036	32.80
無形資產		1,249,649	1,125,149	124,500	11.07
其他資產		367,576	318,168	49,408	15.53
資產總額		99,658,428	80,207,546	19,450,882	24.25
流動負債		21,788,688	16,735,143	5,053,545	30.20
非流動負債		28,186,311	19,151,983	9,034,328	47.17
負債總額		49,974,999	35,887,126	14,087,873	39.26
股 本		7,791,466	7,791,466	0	0.00
資本公積		119,593	678,047	(558,454)	(82.)
保留盈餘		30,555,478	27,291,846	3,263,632	11.96
其他權益及庫藏股票		(405,727)	53,600	(459,327)	(856.95)
母公司業主之權益		38,060,810	35,814,959	2,245,851	6.27
非控制權益		11,622,619	8,505,461	3,117,158	36.65
股東權益總額		49,683,429	44,320,420	5,363,009	12.10

重大變動項目分析說明如下：

- 1.投資減少：主要係因部分轉投資公司於106年度成為子公司，開始列入合併財務報告之編製主體所致。
- 2.不動產、廠房及設備增加：主要係106年度新增不動產、廠房及設備所致。
- 3.流動負債增加：主要係短期借款及一年內到期之長期借款增加所致。
- 4.非流動負債增加：主要係長期借款增加、遞延所得稅負債增加所致。
- 5.資本公積減少：主要係106年度資本公積配發現金股利所致。
- 6.其他權益及庫藏股票減少：主要係106年度國外營運機構財務報表換算兌換損失及子公司購買母公司股票所致所致。
- 7.非控制權益增加：主要係106年度增加非100%持股之子公司所致。

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

年 度	106 年度	105 年度	增 (減) 金 額	變 動 比 例 (%)	變 動 分 析
營業收入淨額	\$ 59,632,083	\$ 48,343,542	\$ 11,288,541	23.35	1
營業成本	46,933,571	37,881,516	9,052,056	23.90	1
營業毛利	12,698,512	10,462,026	2,236,486	21.38	1
營業費用	3,624,488	2,829,653	794,835	28.09	1
營業淨利	9,074,024	7,632,373	1,441,651	18.89	
營業外收入及支出	(186,746)	(369,297)	182,551	49.43	2
稅前淨利(損)	8,887,278	7,263,076	1,624,202	22.36	3
所得稅費用	1,596,003	1,254,208	341,795	27.25	4
本期淨利	\$ 7,291,275	\$ 6,008,868	\$ 1,282,407	21.34	
增減變動分析：					
1.營業收入、成本、毛利及費用增加：主要係業績成長及部分轉投資公司於106年度成為子公司，開始列入合併財務報告之編製主體所致。					
2.營業外收入及支出減少：主要係收購 Tera Probe 認列處分投資收益所致。					
3.稅前淨利增加：主要係營業淨利增加所致。					
4.所得稅費用增加：主要係稅前淨利所致。					

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

由於 AI 智慧系統與 IoT 物聯網科技時代來臨，將引領數據處理應用比重高度成長。中國是半導體最大市場，積極在地化發展為半導體工廠，109 年之前中國的在地化產值就會超過 3 兆元新台幣；而被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

預期 107 年半導體在全球手機出貨部分之出貨量將成長 5.9%；PC 部份，在歷經 106 年庫存調整，預估銷售相對回穩，出貨將小幅下跌 2.8%；液晶電視部分，預估將成長 1.8%。3C 產品中除智慧手機出貨仍持續成長外，其餘 3C 產品均面臨出貨持平、成長趨緩甚至衰退的局面。

根據研究機構顧能公司(Gartner)最新預估，107 年全球半導體市場銷售值將達 4,274 億美元，與 106 年相比，成長 4%。WSTS 預估 107 年台灣半導體產業產值成長 7.1%，而封裝測試產業有 4.4%的成長。成長力道將來自於智慧手機、固態硬碟(SSD)、車用電子、超輕薄筆電、產業應用、穿戴裝置、人工智慧應用以及 IoT 等相關應用。

本公司在 DRAM、NAND Flash、Logic 及先進產品元件將會有顯著的成長。

訂定 107 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 115 億顆
測試	約 75 億顆
凸塊(Bumping)	約 90 萬片
晶圓測試	約 245 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 6,100 萬個

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 初 現金 餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年來自 投資活動 淨現金流量	全年來自 籌資活動 淨現金流量	匯率變動對 現金及約當 現金之影響	現金剩 餘 數
15,835,221	17,677,440	(18,840,391)	3,448,709	(404,397)	17,716,582
106 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 106 年度折舊及獲利增加。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係 106 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)融資活動：融資活動現金淨流入量主要係 106 年度舉借銀行借款之現金流入。					

(二)流動性不足之改善計畫：

106 年度現金流量無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現金 餘額	預計全年 來自營業 活動淨現 金流量	預計全年 現金 流出量	現金剩 餘 額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
17,716,582	19,000,000	18,000,000	18,716,582	—	—
1.107 年度現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 107 年度預計獲利加計折舊等。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係預計 107 年度取得不動產、廠房及設備與長期投資之現金流出。					
(3)融資活動：融資活動現金流出量主要係預計 107 年度支付股東股利及償還銀行借款之現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 106 年度重大資本支出主要為取得不動產、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於本公司所處半導體產業之產品及技術世代交替迅速，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能，以配合產品市場的變化及客戶的需求，以維持公司之競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策主要係為配合公司深耕本業，並以強化與主要客戶間之策略聯盟關係及延伸相關產業之營業觸角為方向，期以投資收益增進股東權益。106 年度本公司依權益法認列之投資淨益為 108,792 仟元。

為配合業務發展，本公司與主要客戶美光科技股份有限公司共同合作，透過第三地子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 於中國設立子公司，從事半導體封裝業務，雙方於 103 年 12 月共同簽訂半導體封裝投資合約，力成於中國大陸西安設立子公司。本公司初期預計投資美金 7,000 萬元之資本額設立子公司，視未來發展狀況，將陸續增加設備等相關資產投資，總投資金額連同投入資本額預計為美金 2.1 億元。104 年 5 月該子公司力成半導體（西安）有限公司正式成立，已匯入之投資金額為美金 4,500 萬元。本公司又於 106 年 1 月直接投資該子公司美金 2,500 萬元，投資金額合計為美金 7,000 萬元，增資完成後力成公司對力成半導體（西安）有限公司之持股為 36%，Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 對該子公司之持股則為 64%。

本公司考量未來營運之成長，積極規劃拓展日本市場，以提升公司全球競爭優勢，於 106 年 1 月投資設立力成科技日本合同會社，並於 106 年 4 月董事會通過授權董事長在不超過日幣 145.2 億元(約折合美金 1.32 億元)之額度內，分次增加對力成科技日本合同會社之投資，以透過其取得日本上市公司 Tera Probe Inc. 至少 39.6% 股份及 Micron Akita, Inc. 之全部股份。後續執行情形如下：

(一) 第一次增資預計於 106 年 5 月底前完成，增資總金額以不超過日幣 90.2 億元(約折合美金 8,200 萬元)的範圍內，公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc. 之股份，以取得 Micron Memory Japan Inc. 其所持有之 Tera Probe Inc. 39.6% 股份及其他參與應賣股東之持股。

本次公開收購已於 106 年 6 月初完成，收購價格為每股日幣 1,100 元，收購總金額日幣 4,884,330 仟元。收購股數佔被收購公司 Tera Probe Inc 普通股總股數的 47.84%，加計母公司力成科技原持有之 11.6%，合計持有 59.44%。由於本公司對該公司已有絕對控制權，故該公司及其子公司 Tera Probe Aizu, Inc 與晶兆成科技(股)公司皆成為本公司之子公司。

(二) 第二次增資預計於 106 年 6 月底前完成，增資總金額以不超過美金 5,000 萬元(約折合日幣 55 億元)的範圍內，購買 Micron Akita, Inc. 之全部股份。該股權交易已於 106 年 8 月初完成，實際成交金額為美金 48,917 仟元，交易完成後，隨即更名為 Powertech Technology Akita Inc. (力成科技秋田株式會社)。為支應該子公司未來營

運之資金需求，同年 10 月，力成科技日本合同會社參與該子公司之現金增資，金額為日幣 980,000 仟元，完成後累計持有股數為 6,202 股，投資金額為日幣 5,736,994 仟元。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，在鞏固策略聯盟合作關係與延伸相關產業營業觸角的方向下，經審慎評估後提報董事會核議。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動之影響及因應措施

本公司所處半導體封裝測試業屬資本密集產業，機器設備的投資金額較大，資金來源除自有資金外，以銀行借款為主，故本公司損益受到利率變動之影響。對此風險本公司除定期評估銀行借款利率與市場平均利率之水準外，並適時向往來銀行洽商取得較優惠之借款利率。

2.匯率變動之影響及因應措施

(1)匯率變動之影響

本公司 106 年度外銷比重約為 79.59%，此為外幣收入之主要來源，幣別則以美元為主。而本公司部分機器設備及原物料亦從國外進口，大部份以美元或日幣計價，因此，不論收入或支出均受匯率波動之影響。本公司 106 年度匯兌損失為 457,141 仟元。

(2)因應匯率變動之具體措施：

- 進貨與收入產生相互沖抵之結果，使匯率之變動產生自然避險之效果。
- 財務人員蒐集有關匯率變化之訊息，參酌往來銀行銀根鬆緊狀況，匯率走勢分析及市場外匯需求狀況，以作為因應匯率變動之參考。
- 依據未來外幣需求情況下，適時買入外幣，以確定成本並降低匯率變動所造成之影響。
- 運用銀行額度適當時機將外幣貸款轉換為新臺幣之借款。
- 運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

3.通貨膨脹情形：

本公司 106 年度損益並無明顯受通貨膨脹之影響，未來將視變動情形因應調整。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司並無從事高風險、高槓桿之投資交易。
- 2.依本公司背書保證處理程序規定，本公司得以公司名義對持股 50%以上子公司在一定限額內對其背書保證。為因應新加坡子公司 Powertech Technology

(Singapore) Pte. Ltd.辦理短期借款所需，本公司於103年度提請董事會同意授權董事長在美金五千萬元之額度內，以公司名義對前述借款辦理背書保證。104年度期間本公司已完成對該子公司之增減資，降低了該公司對銀行借款之需求額度，故於105年3月經董事會通過將背書保證限額調整為美金三千萬元。截至年報刊印日止，本公司對子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.之背書保證最高限額仍為美金三千萬元，實際動用額度為美金17,925仟元(約新台幣530,670仟元)。另外，同上述理由，本公司亦於106年5月5日第七屆第20次董事會決議通過對子公司力成科技(蘇州)有限公司之背書保證限額為美金二千萬元，截至年報刊印日止，該子公司實際動用額度為美金7,218仟元(約新台幣215,559仟元)。依本公司背書保證處理程序規定，本公司及子公司整體對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額，分別以不超過本公司淨值的10%及50%為限，本公司106年12月31日之淨值為38,060,810仟元，故本公司對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額分別為3,806,081仟元及19,030,405仟元，符合本公司背書保證處理程序及相關法令之規定。

3.為因應子公司擴充產能之資金需求，本公司於107年3月16日第八屆第5次董事會決議通過資金貸與力成科技(蘇州)有限公司及 Powertech Technology (Singapore) Pte Ltd.，金額分別為美金2,400萬元及美金3,000萬元為上限，並得分次貸與；貸款期間為一年，借款利率依借款當日銀行短期貸放利率計算，預計年利率約2.2%。截至年報刊印日止，上述兩家子公司皆尚未申請動支資金。

依本公司資金貸與他人作業程序之規定，有短期融通資金之必要之公司或行號，對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額，分別以不超過本公司淨值的5%及10%為限。本公司106年12月31日之淨值為38,060,810仟元，故本公司對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為1,903,041仟元及3,806,081仟元，符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

另外，本公司於106年6月初完成公開收購 Tera Probe Inc.成為子公司時，該公司原已資金貸與其100%子公司 Tera Probe Aizu, Inc.，額度為日幣8億元，106年10月經董事會決議降低額度為日幣7億元，截至年報刊印日止，實際動用金額為日幣6.7億元(約新台幣181,570仟元)。同上述資金貸與他人作業程序之規定，Tera Probe, Inc.106年12月31日之淨值為5,966,294仟元(日幣22,522,815仟元)，故 Tera Probe, Inc.對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為298,315仟元(日幣1,126,141仟元)及596,629仟元(日幣2,252,282仟元)，亦符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

4.本公司106年度及截至年報刊印日止，僅為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率波動所產生之風險而進行短期外匯交易，未從事投機性交易，因屬避險性質，故對本公司不會造成重大之獲利或虧損。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司自成立以來即致力於封裝測試人才的培訓，於 87 年即成立研發部門，持續進行封裝測試新製程、新技術之研發及引進；並於 95 年成立研發技術中心，未來將配合半導體記憶體主件朝多功能、高速化、高信賴度及高密度化方向發展及配合客戶新產品之開發情形，積極發展及引進新技術。未來研發計畫請詳伍、營運概況之一、(一)、4.計劃開發之新商品(服務)之說明。預計 107 年度投入之研發費用為新台幣 1,388,729 仟元，由於本公司編列研發費用之預算較為保守，實際執行預算結果應將與 106 年相當。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所處半導體產業，產品及技術之世代交替迅速，為配合產品市場的變化及客戶的需求，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能。為降低產能過度擴充之風險、有效運用資金掌握產品發展趨勢，本公司與主要客戶建立策略聯盟之合作關係，以共同提升先進技術之能力。另外，利用轉投資相關企業，佈建完整的產品線，藉以分散產業變化帶來的風險，並加強成本控制、現金管理來維持公司的競爭力，以控制對公司財務業務的影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，近年並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 106 年 4 月 14 日第七屆第 19 次董事會通過將透過日本子公司「力成科技日本合同會社」於 4 月 17 日開始對日本東京證券交易所創業板(Mothers)之上市公司 Tera Probe (股票代號: 6627)進行公開收購，以每股日幣 1,100 元收購美光科技所持有 Tera Probe 之 39.6%股份及其他有意願參賣股東之持股，該收購案已於 106 年 6 月初完成，包括本公司現有對 Tera Probe 的持股 11.6%，合計持股達 59.44%；Tera Probe 亦於 106 年 6 月份召開股東會，本公司取得過半董事席位。此外，本公司亦與美光簽訂 Micron Akita Inc.(美光秋田)股份購買合約並於 8 月份完成交易，併購美光位於日本秋田的封裝測試廠之全部股權，同時與美光簽訂相關的封裝及測試服務合約，進一步加深雙方長期策略合作的關係。此外，本公司希望透過前述之併購案於日本當地建立產能，以就近提供現有及新客戶優質的封裝及測試服務，並期望可以進一步開發日本車用電子及物聯網(IoT)半導體產品的客戶，為力成增加營收成長的動能。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司為配合業務的擴展，以及持續先進封裝測試產品製程與技術開發的策略，105年11月於湖口工業區總公司所在旁，興建地下一層、地上五層之聯合辦公大樓，該大樓已於106年9月開始啟用，並將行政單位、研發單位及倉儲設施移往於此，而前述單位空出之空間將設置新生產線以擴充產能，預期對未來營運之擴展將有所助益。本公司已於投資前持續評估各項擴建廠房可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施以降低各項風險對公司營運之不利影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於所處之產業特性，上游記憶體IC之市場集中度高，使得下游封測產業出現銷貨及進貨較為集中之現象，為分散此風險，本公司積極開發新客戶，與原有客戶建立友好的策略聯盟合作關係，並持續積極跨足非記憶體IC之封裝測試業務，效益已開始顯現，目前在DRAM、NAND FLASH及邏輯IC之封測代工已呈現約各占1/3之態勢。進貨方面，則積極尋找替代料及新合格供應商，以期使公司穩健成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

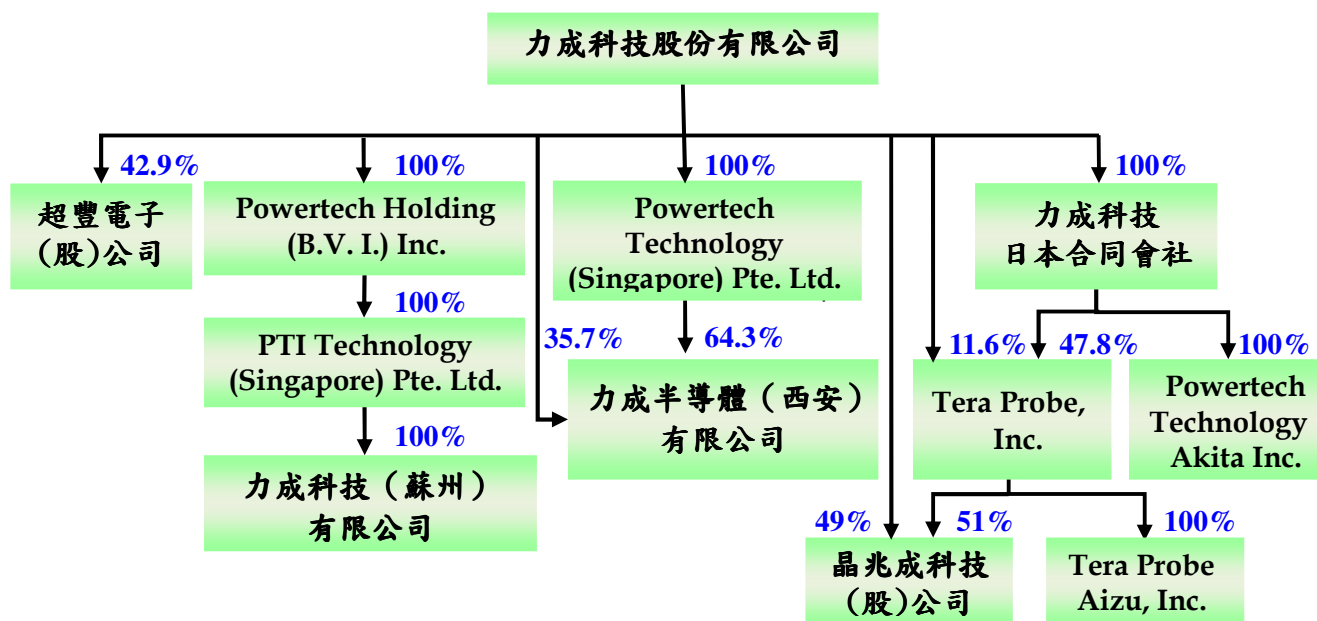
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業概況

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：

106年12月31日；單位：仟元

企業名稱	原始設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	98.08	P.O. Box 3444 Road Town, Tortola, B.V.I.	US\$ 52,000	投資業務
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	83.11	8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore 018981	US\$ 72,102	投資業務
力成科技(蘇州)有限公司	84.08	蘇州工業園區星海街33號	US\$ 72,000	封裝測試業務
超豐電子(股)公司	72.03	苗栗縣竹南鎮公義路136號	NT\$5,688,459	封裝測試業務
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	94.12	12 Ang Mo Kio Street 65, Level 3 Singapore 509060	US\$ 85,000	晶圓凸塊業務
力成半導體(西安)有限公司	104.05	陝西省西安市信息大道28號 西安出口區B區綜合樓辦公室322室	US\$ 70,000	封裝測試業務
力成科技日本合同會社	106.01	3F, Shiodome Building, #180-181, 1-2-20 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-0022, Japan	JPY 120,000	投資業務 封裝測試業務
Tera Probe, Inc.	94.08	KAKiYA Bldg., 2-7-17 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa	JPY 11,823,312	晶圓測試業務
Tera Probe Aizu, Inc.	104.10	No.4 Kogyo Danchi, Monden-Machi, Aizu Wakamatsu City, Fukushima Prefecture, Japan	JPY 45,000	晶圓測試業務
晶兆成科技(股)公司	97.08	新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路26號	NT\$1,335,500	晶圓測試業務
Powertech Technology Akita Inc.	58.04	89-2 Yamada, Yuwaishida, Akita-shi Akita 010-1222, Japan	JPY 495,000	封裝測試業務

3.推定為有控制與從屬關係者：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋行業：

本公司及整體關係企業經營業務涵蓋電子製造、銷售及投資等。

5.各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

107年4月30日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭	US\$ 52,000,000	100%
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	董事	Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 代表人：蔡篤恭、洪嘉銓、 Jeswant Singh S/O Darshan Singh	US\$ 51,000,000	100%
力成科技(蘇州)有限公司	董事長	PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：呂肇祥	US\$ 50,900,000	100%
	董事	PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：蔡篤恭、洪嘉銓		
	監察人	PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：曾炫章		
	總經理	吉紅斌		
超豐電子(股)公司	董事長	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭	244,064,379	42.91%
	董事	力成科技(股)公司 代表人：詹焜智、謝永達、呂肇祥、 甯鑑超		
	獨立董事	馮竹健	0	0%
	獨立董事	吳宗亮	0	0%
	監察人	鴻威創業投資(股)公司 代表人：張智能	5,823,602	1.02%
	監察人	偉詮電子(股)公司 代表人：林錫銘	10,650,000	1.87%
	監察人	啟盛投資(股)公司 代表人：王仁宗	1,118,512	0.20%
	總經理	甯鑑超	2,293,224	0.40%
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭、洪嘉銓、曾炫章、 Lim Tiong Beng	US\$ 85,000,000	100%
	總經理	鄭志明	-	-
力成半導體(西安)有限公司	董事長	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：呂肇祥	US\$ 45,000,000	64%
	董事	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：洪嘉銓		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例
	監察人	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：林宥翰	US\$ 45,000,000	64%
	董事	力成科技(股)公司 代表人：曾炫章	US\$ 25,000,000	36%
	總經理	陳玉欽	-	-
力成科技日本合同會社	業務執行代表	蔡篤恭	JPY 100,000	100%
	總經理	浦崎直彦		
Tera Probe, Inc.	董事長	浦崎直彦(力成科技日本合同會社)	4,440,300	47.8%
	董事	蔡篤恭、李躬富、曾炫章、岩間耕二 (力成科技(股)公司)	1,077,100	11.6%
	董事	渡辺雄一郎	5,800	0.06%
	董事	横山毅	500	0.00%
	獨立董事	森直樹	-	-
	監察人	林宥翰、增子尚之、打越佑介	-	-
Tera Probe Aizu, Inc.	董事長 兼總經理	原田啓明(Tera Probe, Inc.)	180,000	100%
	董事	神戸一仁、地主尚和、八重樫郁雄		
	監察人	增子尚之		
晶兆成科技(股)公司	董事長	Tera Probe, Inc. 代表人：渡辺雄一郎	68,110,500	51.0%
	董事	Tera Probe, Inc. 代表人：池田実成、池内貴之		
	董事	力成科技(股)公司 代表人：曾炫章、林育全	65,439,500	49.0%
	監察人	增子尚之、姜宜君	-	-
Powertech Technology Akita Inc.	董事長 兼總經理	加賀谷晉司(力成科技日本合同會社)	6,202	100%
	董事	蔡篤恭、曾炫章、浦崎直彦		
	監察人	林宥翰		

6.關係企業營運概況：

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期(損)益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)註
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	1,679,370	1,082,574	0	1,082,574	0	0	(146,205)	不適用
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	2,327,365	1,045,984	0	1,045,984	0	0	(146,289)	不適用
力成科技(蘇州)有限公司	2,149,056	1,770,263	725,116	1,045,147	1,098,621	(120,358)	(138,630)	不適用
超豐電子(股)公司	5,688,459	18,139,886	2,615,947	15,523,939	11,951,769	2,983,650	2,508,628	4.41
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	2,537,080	2,660,874	575,756	2,085,118	326,871	(237,727)	(134,346)	不適用
力成半導體(西安)有限公司	2,089,360	4,269,688	2,736,317	1,533,371	4,729,288	143,046	110,312	不適用
力成科技日本合同會社					0			
Powertech Technology Akita Inc.					652,232			
Tera Probe, Inc.								
晶兆成科技股份有限公司					1,785,598			
Tera Probe Aizu, Inc.								

註：有限公司無須計算 EPS

(二) 關係企業概況

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 106 年度（自 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：力成科技股份有限公司

負責人：蔡 篤 恭

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 6 日

(三) 關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

本公司於民國（下同）105年1月15日股東臨時會決議通過，以私募方式發行不超過259,715,545股普通股，並授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理；未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。嗣本公司105年1月25日董事會依股東會授權，洽定西藏拓展創芯投資有限公司（下稱「西藏拓展公司」）為應募人。

上述私募案截至106年1月14日將屆滿一年，因西藏拓展公司未能及時取得主管機關許可，本次私募已無法於一年期限內完成，衡酌客觀環境變化，經本公司106年1月13日第七屆第17次董事會決議不繼續辦理本次私募普通股案。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

單位：新臺幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止	
								持有股數	金額
超豐電子(股)公司	5,688,459	自有資金	42.91%	106年	1,800,000股 158,719仟元	-	-	1,800,000	158,709

註1：上列子公司未有將持有之本公司股票設定質權之情形。

註2：本公司未有為上列子公司背書保證之情形。

註3：本公司未有資金貸與上列子公司之情形。

四、其他必要補充說明：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。

力成科技股份有限公司

董事長：蔡 篤 恭